

本报告依据中国资产评估准则编制

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及  
支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股  
东全部权益价值评估项目  
资 产 评 估 报 告

浙联评报字[2026]第 64 号

浙江中联资产评估有限公司

二〇二六年三月二十七日

# 中国资产评估协会

## 资产评估业务报告备案回执

报告编码：	3333040015202600150
合同编号：	评2026088A
报告类型：	法定评估业务资产评估报告
报告文号：	浙联评报字[2026]第64号
报告名称：	中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目
评估结论：	2,501,400,000.00元
评估报告日：	2026年03月27日
评估机构名称：	浙江中联资产评估有限公司
签名人员：	李洪柱（资产评估师） 正式会员 编号：33190025 周承起（资产评估师） 正式会员 编号：33230240
李洪柱、周承起已实名认证	
	
(可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2026年03月30日

ICP备案号京ICP备2020034749号

# 目 录

声 明 .....	4
摘 要 .....	6
一、委托人及其他资产评估报告使用人 .....	8
二、评估目的 .....	46
三、评估对象和评估范围 .....	46
四、价值类型 .....	69
五、评估基准日 .....	69
六、评估依据 .....	70
七、评估方法 .....	73
八、评估程序实施过程和情况 .....	88
九、评估假设 .....	89
十、评估结论 .....	91
十一、特别事项说明 .....	96
十二、评估报告使用限制说明 .....	98
十三、评估报告日 .....	99
附 件 .....	101

## 声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

四、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。

五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

六、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

# 中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告

浙联评报字[2026]第 64 号

## 摘 要

浙江中联资产评估有限公司接受中微半导体设备（上海）股份有限公司的委托，就中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%股权之经济行为，对所涉及的杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。

评估对象为杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益，评估范围为杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及相关负债。

评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和市场法两种方法对杭州众硅电子科技有限公司进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提及满足评估目的，本次选用市场法评估结果作为最终评估结论。

经实施资产核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，得出

杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的评估结论如下：

合并报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益账面值 75,280.39 万元，评估值 250,140.00 万元，评估增值 174,859.61 万元，增值率 232.28%。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

本报告中所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成，提请报告使用者注意。

根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 30 日使用有效。超过一年，需重新进行评估。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

# 中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告

浙联评报字[2026]第 64 号

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

浙江中联资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法、市场法，按照必要的评估程序，就中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金收购杭州众硅电子科技有限公司 64.69% 股权之经济行为，对所涉及的杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

## 一、委托人及其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为中微半导体设备（上海）股份有限公司，被评估单位为杭州众硅电子科技有限公司。委托人为被评估单位的股东及股权拟收购方。

### （一）委托人概况

公司名称：中微半导体设备（上海）股份有限公司

法定代表人：尹志尧

统一社会信用代码：913101157626272806

股票代码：688012

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册资本：62,614.5307 万元

成立日期：2004 年 5 月 31 日

公司地址：上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号

经营范围：研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

## （二）被评估单位概况

### 1、企业基本情况

公司名称：杭州众硅电子科技有限公司

法定代表人：GU HAIYANG

统一社会信用代码：91330185MA2CC0D69L

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11,562.0108 万元

成立日期：2018 年 5 月 23 日

公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 88 号 1 幢一层

经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2、历史沿革及股东结构

### （1）2018年5月，杭州众硅设立

2018年5月21日，杭州众芯硅和朱琳签订《杭州众硅电子科技有限公司章程》，约定标的公司注册资本为3,000.00万元，朱琳以货币方式认缴出资30.00万元，占注册资本的1.00%。杭州众芯硅以货币方式认缴出资2,970.00万元，占注册资本的99.00%。

2018年5月23日，杭州众硅取得了杭州市临安区市场监督管理局核发的《营业执照》。

杭州众硅设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	99.00%	货币
2	朱琳	30.00	1.00%	货币
合计		3,000.00	100.00%	--

### （2）2019年2月，杭州众硅第一次增资

2018年5月28日，杭州众硅与朱力昂及相关方签署增资协议，约定朱力昂对标的公司增资500.00万元，认缴标的公司116.13万元注册资本。

2019年1月，杭州众硅与临安创投及相关方签署增资协议，约定临安创投以1.00元/注册资本的价格对标的公司增资600.00万元，认缴标的公司600.00万元注册资本。

2019年2月21日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至3,716.13万元，新增注册资本716.13万元由朱力昂认缴116.13万元，由临安创投认缴600.00万元，并相应修改公司章程。

2019年2月22日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	79.92%	货币

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
2	临安创投	600.00	16.15%	货币
3	朱力昂	116.13	3.13%	货币
4	朱琳	30.00	0.81%	货币
合 计		<b>3,716.13</b>	<b>100.00%</b>	--

### （3）2019年12月，杭州众硅第二次增资

2019年6月17日，杭州众硅与淮堃创投及相关方签署增资协议，约定淮堃创投将以5,000.00万元的价格认购标的公司663.59万元注册资本。

2019年12月11日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,379.72万元，新增注册资本663.59万元由淮堃创投认缴。

2019年12月11日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	67.81%	货币
2	淮堃创投	663.59	15.15%	货币
3	临安创投	600.00	13.70%	货币
4	朱力昂	116.13	2.65%	货币
5	朱琳	30.00	0.69%	货币
合 计		<b>4,379.72</b>	<b>100.00%</b>	--

### （4）2020年5月，杭州众硅第三次增资

2020年4月，杭州众硅与临安创投及相关方签署增资协议，约定临安创投将以1,000.00万元的价格认购标的公司132.72万元注册资本。

2020年5月5日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,512.44万元，新增注册资本132.72万元由临安创投认

缴。

2020年5月22日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	65.82%	货币
2	临安创投	732.72	16.24%	货币
3	淮堃创投	663.59	14.71%	货币
4	朱力昂	116.13	2.57%	货币
5	朱琳	30.00	0.66%	货币
合 计		<b>4,512.44</b>	<b>100.00%</b>	--

#### （5）2021年1月，杭州众硅第一次股权转让

2021年1月12日，经杭州众硅股东会同意，杭州众芯硅与临安众芯硅（曾用名：宁波众硅企业管理合伙企业（有限合伙）（2021-01至2021-12））签订《股权转让协议》，约定将杭州众芯硅所持标的公司8.20%的股权（对应注册资本370.02万元，实缴0.00元）转让给临安众芯硅，转让价格为0.00元。后续由受让方履行实缴义务。标的公司现有股东均放弃优先购买权。

2021年2月，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,599.98	57.62%	货币
2	临安创投	732.72	16.24%	货币
3	淮堃创投	663.59	14.71%	货币
4	宁波众硅	370.02	8.20%	货币
5	朱力昂	116.13	2.57%	货币
6	朱琳	30.00	0.66%	货币
合 计		<b>4,512.44</b>	<b>100.00%</b>	--

#### （6）2021年2月，杭州众硅第四次增资

2020年12月，杭州众硅与宁波领芯及相关方签署增资协议，约定宁波领芯将以2,000.00万元的价格认购标的公司265.44万元注册资本。

2021年2月22日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,777.88万元，新增注册资本265.44万元由宁波领芯认缴，并同意通过新的公司章程。

2021年2月22日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,599.98	54.42%	货币
2	临安创投	732.72	15.34%	货币
3	淮堃创投	663.59	13.89%	货币
4	宁波众硅	370.02	7.74%	货币
5	宁波领芯	265.44	5.56%	货币
6	朱力昂	116.13	2.43%	货币
7	朱琳	30.00	0.63%	货币
合 计		4,777.88	100.00%	--

#### （7）2021年3月，杭州众硅第五次增资

2021年2月，杭州众硅与炬华联昕、好奇号、寓鑫创投、吴仁德及相关方签署增资协议，约定炬华联昕、好奇号、寓鑫创投、吴仁德以5,000.00万元认购标的公司597.24万元注册资本。

2021年3月4日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至5,375.12万元，新增注册资本597.24万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
炬华联昕	1,000.00	119.45
好奇号	500.00	59.72
寓鑫创投	1,000.00	119.45

吴仁德	2,500.00	298.62
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>597.24</b>

2021年3月4日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,599.98	48.37%
2	临安创投	732.72	13.63%
3	淮堃创投	663.59	12.35%
4	宁波众硅	370.02	6.88%
5	吴仁德	298.62	5.56%
6	宁波领芯	265.44	4.94%
7	炬华联昕	119.45	2.22%
8	寓鑫创投	119.45	2.22%
9	朱力昂	116.13	2.16%
10	好奇号	59.72	1.11%
11	朱琳	30.00	0.56%
<b>合 计</b>		<b>5,375.12</b>	<b>100.00%</b>

#### （8）2021年8月，杭州众硅第二次股权转让

2021年6月，杭州众芯硅与长兴青鸟签订投资协议，约定杭州众芯硅将其所持标的公司2.79%的股权（对应出资额150.00万元）转让给长兴青鸟，转让价格为1,320.00万元。

2021年7月21日，杭州众硅召开股东会，全体股东均同意前述股权转让。

2021年8月2日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	45.58%
2	临安创投	732.72	13.63%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
3	淮堃创投	663.59	12.35%
4	宁波众硅	370.02	6.88%
5	吴仁德	298.62	5.56%
6	宁波领芯	265.44	4.94%
7	长兴青鸟	150.00	2.79%
8	炬华联昕	119.45	2.22%
9	寓鑫创投	119.45	2.22%
10	朱力昂	116.13	2.16%
11	好奇号	59.72	1.11%
12	朱琳	30.00	0.56%
合 计		<b>5,375.12</b>	<b>100.00%</b>

#### （9）2021年10月，杭州众硅第六次增资

2021年8月，杭州众硅分别与江苏中小基金、毅达太湖、宁波毅达、嘉兴芯通、小满投资、宁波和丰、江苏**建**泉、浙江容腾、苏州国发、朗玛四十二号及相关方签署增资协议，约定江苏中小基金、毅达太湖、宁波毅达、嘉兴芯通、小满投资、宁波和丰、江苏**建**泉、浙江容腾、苏州国发、朗玛四十二号以17,000.00万元认购标的公司1,405.80万元注册资本。

2021年8月31日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至6,780.92万元，新增注册资本1,405.80万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
江苏中小基金	3,000.00	248.08
毅达太湖	1,500.00	124.04
宁波毅达	1,500.00	124.04
嘉兴芯通	3,000.00	248.08

小满投资	2,000.00	165.39
宁波和丰	3,000.00	248.08
江苏昶泉	1,000.00	82.69
浙江容腾	1,000.00	82.69
苏州国发	500.00	41.35
朗玛四十二号	500.00	41.35
<b>合计</b>	<b>17,000.00</b>	<b>1,405.80</b>

2021年10月11日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	36.13%
2	临安创投	732.72	10.81%
3	淮堃创投	663.59	9.79%
4	宁波众硅	370.02	5.46%
5	吴仁德	298.62	4.40%
6	宁波领芯	265.44	3.91%
7	江苏中小基金	248.08	3.66%
8	嘉兴芯通	248.08	3.66%
9	宁波和丰	248.08	3.66%
10	小满投资	165.39	2.44%
11	长兴青鸟	150.00	2.21%
12	毅达太湖	124.04	1.83%
13	宁波毅达	124.04	1.83%
14	炬华联昕	119.45	1.76%
15	寓鑫创投	119.45	1.76%
16	朱力昂	116.13	1.71%
17	江苏昶泉	82.69	1.22%
18	浙江容腾	82.69	1.22%
19	好奇号	59.72	0.88%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
20	苏州国发	41.35	0.61%
21	朗玛四十二号	41.35	0.61%
22	朱琳	30.00	0.44%
合计		<b>6,780.92</b>	<b>100.00%</b>

### （10）2022年7月，第三次股权转让

2022年6月27日，公司召开股东会，同意临安创投将其持有的公司股权分别向杭州众诚芯、临安众硅、杭州芯匠进行转让：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）
临安创投	杭州众诚芯	100.00	100.00
	临安众硅	289.00	289.00
	杭州芯匠	211.00	211.00

2022年6月，临安创投与杭州众诚芯、临安众硅、杭州芯匠签署《股权转让协议》，本次转让系执行回购。

2022年7月1日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	36.13%
2	淮堃创投	663.59	9.79%
3	临安众芯硅	370.02	5.46%
4	吴仁德	298.62	4.40%
5	临安众硅	289.00	4.26%
6	宁波领芯	265.44	3.91%
7	江苏中小基金	248.08	3.66%
8	嘉兴芯通	248.08	3.66%
9	宁波和丰	248.08	3.66%
10	杭州芯匠	211.00	3.11%
11	小满投资	165.39	2.44%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
12	长兴青鸟	150.00	2.21%
13	临安创投	132.72	1.96%
14	毅达太湖	124.04	1.83%
15	宁波毅达	124.04	1.83%
16	炬华联昕	119.45	1.76%
17	寓鑫创投	119.45	1.76%
18	朱力昂	116.13	1.71%
19	杭州众诚芯	100.00	1.47%
20	江苏聿泉	82.69	1.22%
21	浙江容腾	82.69	1.22%
22	好奇号	59.72	0.88%
23	苏州国发	41.35	0.61%
24	朗玛四十二号	41.35	0.61%
25	朱琳	30.00	0.44%
合 计		<b>6,780.92</b>	<b>100.00%</b>

（11）2022年10月，第七次增资

2022年8月14日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至7,460.92万元，新增注册资本680.00万元由宁容海川认缴。针对本次增资，标的公司现有股东均放弃优先认购权和反稀释权。

2022年8月25日，杭州众硅与宁容海川及相关方签署增资协议，约定宁容海川以680.00万元认购标的公司680.00万元注册资本。标的公司为引进拥有丰富行业经验的MICHAEL XIAOXUAN YANG先生，经全体股东一致同意，由MICHAEL XIAOXUAN YANG先生控制的企业宁容海川以1.00元/单位注册资本的价格向标的公司增资，并聘任MICHAEL XIAOXUAN YANG为标的公司董事长。

2022年10月31日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	32.84%
2	宁容海川	680.00	9.11%
3	淮堃创投	663.59	8.89%
4	临安众芯硅	370.02	4.96%
5	吴仁德	298.62	4.00%
6	临安众硅	289.00	3.87%
7	宁波领芯	265.44	3.56%
8	江苏中小基金	248.08	3.33%
9	嘉兴芯通	248.08	3.33%
10	宁波和丰	248.08	3.33%
11	杭州芯匠	211.00	2.83%
12	小满投资	165.39	2.22%
13	长兴青鸟	150.00	2.01%
14	临安创投	132.72	1.78%
15	毅达太湖	124.04	1.66%
16	宁波毅达	124.04	1.66%
17	炬华联昕	119.45	1.60%
18	寓鑫创投	119.45	1.60%
19	朱力昂	116.13	1.56%
20	杭州众诚芯	100.00	1.34%
21	江苏聿泉	82.69	1.11%
22	浙江容腾	82.69	1.11%
23	好奇号	59.72	0.80%
24	苏州国发	41.35	0.55%
25	朗玛四十二号	41.35	0.55%
26	朱琳	30.00	0.40%
合 计		7,460.92	100.00%

**（12）2022年12月，第八次增资、第四次股权转让**

2022年11月6日，淮堃创投与南京星堃签订股权转让协议，约定淮堃创投将其所持标的公司248.14万元注册资本转让给南京星堃，转让价格为3,000.00万元。

2022年11月20日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

(1) 增资

标的公司注册资本增加至7,800.05万元，新增注册资本339.13万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
衢州瑞唐	4,000.00	271.31
海澳芯科	500.00	33.91
杰正投资	500.00	33.91
合计	5,000.00	339.13

(2) 股权转让

淮堃创投将其所持标的公司248.14万元注册资本转让给南京星堃，转让价格为3,000.00万元。

2022年11月23日，杭州众硅与海澳芯科、杰正投资及相关方签署增资协议，约定海澳芯科以500.00万元认购标的公司33.91万元注册资本；杰正投资以500.00万元认购标的公司33.91万元注册资本。

2022年11月25日，杭州众硅与衢州瑞唐及相关方签署增资协议，约定衢州瑞唐以4,000.00万元认购标的公司271.31万元注册资本。

2022年12月7日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	31.41%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
2	宁容海川	680.00	8.72%
3	淮堃创投	415.46	5.33%
4	临安众芯硅	370.02	4.74%
5	吴仁德	298.62	3.83%
6	临安众硅	289.00	3.71%
7	衢州瑞唐	271.31	3.48%
8	宁波领芯	265.44	3.40%
9	南京星堃	248.14	3.18%
10	江苏中小基金	248.08	3.18%
11	嘉兴芯通	248.08	3.18%
12	宁波和丰	248.08	3.18%
13	杭州芯匠	211.00	2.71%
14	小满投资	165.39	2.12%
15	长兴青鸟	150.00	1.92%
16	临安创投	132.72	1.70%
17	毅达太湖	124.04	1.59%
18	宁波毅达	124.04	1.59%
19	炬华联昕	119.45	1.53%
20	寓鑫创投	119.45	1.53%
21	朱力昂	116.13	1.49%
22	杭州众诚芯	100.00	1.28%
23	江苏聿泉	82.69	1.06%
24	浙江容腾	82.69	1.06%
25	好奇号	59.72	0.77%
26	苏州国发	41.35	0.53%
27	朗玛四十二号	41.35	0.53%
28	海澳芯科	33.91	0.43%
29	杰正投资	33.91	0.43%
30	朱琳	30.00	0.38%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
	合 计	7,800.05	100.00%

### （13）2023年2月，第九次增资

2022年12月，杭州众硅分别与朗玛五十九号、朗玛六十号、朗玛六十三号、星成联芯、吴仁德、毅达鼎祺、嘉兴邦拓、朱力昂及相关方签署增资协议，约定朗玛五十九号、朗玛六十号、朗玛六十三号、星成联芯、吴仁德、毅达鼎祺、嘉兴邦拓、朱力昂以12,000.00万元认购标的公司624.00万元注册资本。

2022年12月25日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至8,424.05万元，新增注册资本624.00万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
朗玛五十九号	1,500.00	78.00
朗玛六十号	1,500.00	78.00
朗玛六十三号	2,000.00	104.00
星成联芯	2,000.00	104.00
吴仁德	2,000.00	104.00
毅达鼎祺	1,500.00	78.00
嘉兴邦拓	1,000.00	52.00
朱力昂	500.00	26.00
合 计	12,000.00	624.00

2023年2月17日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	29.08%
2	宁容海川	680.00	8.07%
3	淮堃创投	415.46	4.93%
4	吴仁德	402.62	4.78%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
5	临安众芯硅	370.02	4.39%
6	临安众硅	289.00	3.43%
7	衢州瑞唐	271.31	3.22%
8	宁波领芯	265.44	3.15%
9	南京星堃	248.14	2.95%
10	江苏中小基金	248.08	2.94%
11	嘉兴芯通	248.08	2.94%
12	宁波和丰	248.08	2.94%
13	杭州芯匠	211.00	2.50%
14	小满投资	165.39	1.96%
15	长兴青鸟	150.00	1.78%
16	朱力昂	142.13	1.69%
17	临安创投	132.72	1.58%
18	毅达太湖	124.04	1.47%
19	宁波毅达	124.04	1.47%
20	炬华联昕	119.45	1.42%
21	寓鑫创投	119.45	1.42%
22	朗玛六十三号	104.00	1.23%
23	星成联芯	104.00	1.23%
24	杭州众诚芯	100.00	1.19%
25	江苏聿泉	82.69	0.98%
26	浙江容腾	82.69	0.98%
27	朗玛五十九号	78.00	0.93%
28	朗玛六十号	78.00	0.93%
29	毅达鼎祺	78.00	0.93%
30	好奇号	59.72	0.71%
31	嘉兴邦拓	52.00	0.62%
32	苏州国发	41.35	0.49%
33	朗玛四十二号	41.35	0.49%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
34	海澳芯科	33.91	0.40%
35	杰正投资	33.91	0.40%
36	朱琳	30.00	0.36%
合 计		<b>8,424.05</b>	<b>100.00%</b>

#### （14）2023年6月，第十次增资、第五次股权转让

2023年4月25日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

##### （1）增资

标的公司注册资本增加至 9,603.42 万元，新增注册资本 1,179.37 万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
杭州富浙	10,000.00	421.20
浙江富浙	10,000.00	421.20
宁波蓝郡	4,000.00	168.48
杭州北峰	2,000.00	84.24
温润贰号	1,975.00	83.19
温润叁号	25.00	1.05
合 计	<b>28,000.00</b>	<b>1,179.37</b>

##### （2）股权转让

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
临安创投	杭州赋芯	109.0913	821.9700
	朱力昂	3.5190	26.5150
	淮堃创投	20.109	151.5150

2023年4月，杭州众硅分别与温润贰号、温润叁号、杭州富浙、宁波蓝郡、杭州北峰及相关方签署增资协议，约定温润贰号、温润叁号、杭州富浙、宁波蓝郡、杭州北峰以 18,000.00 万元认购标的公司 758.17 万元注册资本。

2023年5月30日，临安创投与杭州赋芯、朱力昂、淮堃创投签订《股权转让协议》，本次转让系执行回购。

2023年6月，杭州众硅分别与浙江富浙及相关方签署增资协议，约定浙江富浙以10,000.00万元认购标的公司421.20万元注册资本。

2023年6月27日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	25.51%
2	宁容海川	680.00	7.08%
3	淮堃创投	435.56	4.54%
4	杭州富浙	421.20	4.39%
5	浙江富浙	421.20	4.39%
6	吴仁德	402.62	4.19%
7	临安众芯硅	370.02	3.85%
8	临安众硅	289.00	3.01%
9	衢州瑞唐	271.31	2.83%
10	宁波领芯	265.44	2.76%
11	南京星堃	248.14	2.58%
12	江苏中小基金	248.08	2.58%
13	嘉兴芯通	248.08	2.58%
14	宁波和丰	248.08	2.58%
15	杭州芯匠	211.00	2.20%
16	宁波蓝郡	168.48	1.75%
17	小满投资	165.39	1.72%
18	长兴青鸟	150.00	1.56%
19	朱力昂	145.65	1.52%
20	毅达太湖	124.04	1.29%
21	宁波毅达	124.04	1.29%
22	炬华联昕	119.45	1.24%
23	寓鑫创投	119.45	1.24%
24	杭州赋芯	109.09	1.14%

25	朗玛六十三号	104.00	1.08%
26	星成联芯	104.00	1.08%
27	杭州众诚芯	100.00	1.04%
28	杭州北峰	84.24	0.88%
29	温润贰号	83.19	0.87%
30	江苏聿泉	82.69	0.86%
31	浙江容腾	82.69	0.86%
32	朗玛五十九号	78.00	0.81%
33	朗玛六十号	78.00	0.81%
34	毅达鼎祺	78.00	0.81%
35	好奇号	59.72	0.62%
36	嘉兴邦拓	52.00	0.54%
37	苏州国发	41.35	0.43%
38	朗玛四十二号	41.35	0.43%
39	海澳芯科	33.91	0.35%
40	杰正投资	33.91	0.35%
41	朱琳	30.00	0.31%
42	温润叁号	1.05	0.01%
<b>合 计</b>		<b>9,603.42</b>	<b>100.00%</b>

### （15）2024年12月，第十一次增资、第六次股权转让

2024年11月28日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

#### （1）增资

同意标的公司注册资本增加至 10,487.95 万元，新增注册资本 884.53 万元，由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
中微临港	2,000.00	84.24
台州金石投资	16,000.00	673.92
中信投资	2,000.00	84.24
石溪投资	1,000.00	42.12
<b>合计</b>	<b>21,000.00</b>	<b>884.53</b>

## 2) 股权转让

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
杭州赋芯	中微临港	11.44	178.66
浙江容腾		82.69	1,291.64
海澳芯科		33.91	529.71
好奇号	石溪投资	59.72	932.85
杭州众芯硅		4.30	67.15
杭州赋芯	台州金石投资	97.65	1,525.29
杭州众芯硅		30.39	474.71
温润叁号	温润安享	1.05	25.00

本次股权转让价格对应标的公司的整体估值约为 16.38 亿元。

2024 年 12 月 31 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,415.29	23.03%
2	台州金石投资	801.97	7.65%
3	宁容海川	680.00	6.48%
4	淮堃创投	435.56	4.15%
5	杭州富浙	421.20	4.02%
6	浙江富浙	421.20	4.02%
7	吴仁德	402.62	3.84%
8	临安众芯硅	370.02	3.53%
9	临安众硅	289.00	2.76%
10	衢州瑞唐	271.31	2.59%
11	宁波领芯	265.44	2.53%
12	南京星堃	248.14	2.37%
13	江苏中小基金	248.08	2.37%
14	嘉兴芯通	248.08	2.37%
15	宁波和丰	248.08	2.37%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
16	中微临港	212.29	2.02%
17	杭州芯匠	211.00	2.01%
18	宁波蓝郡	168.48	1.61%
19	小满投资	165.39	1.58%
20	长兴青鸟	150.00	1.43%
21	朱力昂	145.65	1.39%
22	毅达太湖	124.04	1.18%
23	宁波毅达	124.04	1.18%
24	炬华联昕	119.45	1.14%
25	寓鑫创投	119.45	1.14%
26	石溪投资	106.14	1.01%
27	朗玛六十三号	104.00	0.99%
28	星成联芯	104.00	0.99%
29	杭州众诚芯	100.00	0.95%
30	杭州北峰	84.24	0.80%
31	中信投资	84.24	0.80%
32	温润贰号	83.19	0.79%
33	江苏隼泉	82.69	0.79%
34	朗玛五十九号	78.00	0.74%
35	朗玛六十号	78.00	0.74%
36	毅达鼎祺	78.00	0.74%
37	嘉兴邦拓	52.00	0.50%
38	苏州国发	41.35	0.39%
39	朗玛四十二号	41.35	0.39%
40	杰正投资	33.91	0.32%
41	朱琳	30.00	0.29%
42	温润安享	1.05	0.01%
合 计		10,487.9441	100.0000%

**（16）2025年2月，第十二次增资、第七次股权转让**

2024年12月31日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

(1) 增资

同意标的公司注册资本增加至 11,562.01 万元，新增注册资本 1,074.07 万元，由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
江苏毅达	2,500.00	105.30
安徽丰禾	5,000.00	210.60
青岛东证	3,000.00	126.36
杭州达晨	5,250.00	221.13
深圳达晨	8,750.00	368.55
达晨财智	1,000.00	42.12
合计	25,500.00	1,074.07

2) 股权转让

因标的公司 2024 年 12 月增资及股权转让事宜触发反稀释条款。经各方协商一致，杭州众芯硅同意向 2023 年 6 月入股的投资人给予股权补偿，具体如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（元）
杭州众芯硅	杭州富浙	21.16	1.00
	浙江富浙	21.16	1.00
	宁波蓝郡	8.46	1.00
	杭州北峰	4.23	1.00
	温润贰号	4.18	1.00
	温润安享	0.05	1.00

2025 年 2 月 28 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,356.04	20.38%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
2	台州金石投资	801.97	6.94%
3	宁容海川	680.00	5.88%
4	杭州富浙	442.36	3.83%
5	浙江富浙	442.36	3.83%
6	淮堃创投	435.56	3.77%
7	吴仁德	402.62	3.48%
8	临安众芯硅	370.02	3.20%
9	深圳达晨	368.55	3.19%
10	临安众硅	289.00	2.50%
11	衢州瑞唐	271.31	2.35%
12	宁波领芯	265.44	2.30%
13	南京星堃	248.14	2.15%
14	江苏中小基金	248.08	2.15%
15	嘉兴芯通	248.08	2.15%
16	宁波和丰	248.08	2.15%
17	杭州达晨	221.13	1.91%
18	中微临港	212.29	1.84%
19	杭州芯匠	211.00	1.82%
20	安徽丰禾	210.60	1.82%
21	宁波蓝郡	176.95	1.53%
22	小满投资	165.39	1.43%
23	长兴青鸟	150.00	1.30%
24	朱力昂	145.65	1.26%
25	青岛东证	126.36	1.09%
26	毅达太湖	124.04	1.07%
27	宁波毅达	124.04	1.07%
28	炬华联昕	119.45	1.03%
29	寓鑫创投	119.45	1.03%
30	石溪投资	106.14	0.92%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
31	江苏毅达	105.30	0.91%
32	朗玛六十三号	104.00	0.90%
33	星成联芯	104.00	0.90%
34	杭州众诚芯	100.00	0.86%
35	杭州北峰	88.47	0.77%
36	温润贰号	87.37	0.76%
37	中信投资	84.24	0.73%
38	江苏惠泉	82.69	0.72%
39	朗玛五十九号	78.00	0.67%
40	朗玛六十号	78.00	0.67%
41	毅达鼎祺	78.00	0.67%
42	嘉兴邦拓	52.00	0.45%
43	达晨财智	42.12	0.36%
44	苏州国发	41.35	0.36%
45	朗玛四十二号	41.35	0.36%
46	杰正投资	33.91	0.29%
47	朱琳	30.00	0.26%
48	温润安享	1.11	0.01%
合 计		<b>11,562.01</b>	<b>100.00%</b>

### (17) 2025年8月，第八次股权转让

2025年8月11日，经杭州众硅股东会同意，以下各方分别签订股权转让协议，就股权转让事宜约定如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
衢州瑞唐	王敏文	135.99	2,005.00
	张久海	135.31	1,995.00
朱力昂	蔡刚波	55.16	1,100.00
宁波领芯		95.27	1,900.00
炬华联昕	扬州朗智	119.45	2,382.12

宁波和丰		248.08	4,947.48
苏州国发		41.35	824.58
淮堃创投		158.04	3,151.80
淮堃创投	中微临港	156.81	3,127.30
嘉兴芯通		248.08	4,947.48
寓鑫创投		119.45	2,382.12
吴仁德		402.62	8,029.37
南京星堃		248.14	4,948.61
宁波领芯		5.01	100.00
淮堃创投		国孚领航	120.71
星成联芯	104.00		2,074.07
朗玛四十二号	41.35		824.58
江苏中小基金	150.43		3,000.00
毅达太湖	75.21		1,500.00
宁波毅达	75.21		1,500.00

注 1：衢州瑞唐的主要合伙人为王敏文、张久海，本次转让中，衢州瑞唐将其所持标的公司股权按其初始投资成本转让给王敏文、张久海。

2025 年 9 月 10 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,356.04	20.38%
2	中微临港	1,392.40	12.04%
3	台州金石投资	801.97	6.94%
4	宁容海川	680.00	5.88%
5	扬州朗智	566.92	4.90%
6	国孚领航	566.92	4.90%
7	杭州富浙	442.36	3.83%
8	浙江富浙	442.36	3.83%
9	临安众芯硅	370.02	3.20%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
10	深圳达晨	368.55	3.19%
11	临安众硅	289.00	2.50%
12	杭州达晨	221.13	1.91%
13	杭州芯匠	211.00	1.82%
14	安徽丰禾	210.60	1.82%
15	宁波蓝郡	176.95	1.53%
16	小满投资	165.39	1.43%
17	宁波领芯	165.15	1.43%
18	蔡刚波	150.43	1.30%
19	长兴青鸟	150.00	1.30%
20	王敏文	135.99	1.18%
21	张久海	135.31	1.17%
22	青岛东证	126.36	1.09%
23	石溪投资	106.14	0.92%
24	江苏毅达	105.30	0.91%
25	朗玛六十三号	104.00	0.90%
26	杭州众诚芯	100.00	0.86%
27	江苏中小基金	97.65	0.84%
28	朱力昂	90.49	0.78%
29	杭州北峰	88.47	0.77%
30	温润贰号	87.37	0.76%
31	中信投资	84.24	0.73%
32	江苏隼泉	82.69	0.72%
33	朗玛五十九号	78.00	0.67%
34	朗玛六十号	78.00	0.67%
35	毅达鼎祺	78.00	0.67%
36	嘉兴邦拓	52.00	0.45%
37	毅达太湖	48.83	0.42%
38	宁波毅达	48.83	0.42%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
39	达晨财智	42.12	0.36%
40	杰正投资	33.91	0.29%
41	朱琳	30.00	0.26%
42	温润安享	1.11	0.01%
合 计		<b>11,562.01</b>	<b>100.00%</b>

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，杭州众硅电子科技有限公司股东及股权比例未发生变动。

### 3、资产、财务及经营状况

#### (1) 合并报表情况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 102,212.56 万元，负债总额为 26,932.17 万元，净资产 75,280.39 万元；2025 年营业收入 24,411.88 万元，净利润-9,250.00 万元。公司近二年资产、财务状况如下表：

#### 公司资产、负债及财务状况

金额单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	90,728.47	102,212.56
负债	27,063.65	26,932.17
净资产	63,664.82	75,280.39
	<b>2024 年度</b>	<b>2025 年度</b>
营业收入	5,288.65	24,411.88
利润总额	-15,346.30	-9,250.00
净利润	-15,346.30	-9,250.00
审计机构	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

#### (2) 母公司报表情况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 104,275.53 万元，负债总额为 26,755.27 万元，净资产为 77,520.26 万元；2025 年营业收入 24,411.88 万元，净利润-8,531.79 万元。公司近二年资产、财务状况如下表：

公司资产、负债及财务状况

金额单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
总资产	92,230.58	104,275.53
负债	26,852.48	26,755.27
净资产	65,378.09	77,520.26
	<b>2024年度</b>	<b>2025年度</b>
营业收入	5,288.65	24,411.88
利润总额	-14,426.64	-8,531.79
净利润	-14,426.64	-8,531.79
审计机构	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 4、经营情况介绍

杭州众硅主营业务为高端化学机械抛光和化学机械平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案。杭州众硅目前已推出多款自主创新研发的 12 英寸 CMP 设备，应用在晶圆制造、大硅片、先进封装及先进存储等领域，已发展成为半导体高端装备领域重要的厂商。


在晶圆制造抛光领域，目前国际主要设备供应商为应用材料、日本荏原。标的公司自主研发的 12 英寸化学机械平坦化设备（TTAIS®300 CMP）突破技术壁垒，已在国内主要先进存储和逻辑芯片制造厂商陆续进行认证并实现应用。该设备深度适配客户工艺需求，工艺覆盖金属、非金属等全品类抛光场景，可精准应用于先进逻辑、先进封装等核心制程环节，成为国内少数能为先进集成电路制造提供整套 CMP 设备技术解决方案的企业之一。标的公司自主创新研发的紧凑、高效 6 抛光盘设备平台设计，在单位设备产能、设备占地面积、设备性价比等核心大规模量产设备指标等方面表现突出，能有效降低客户设备综合运营成本。同时，其工艺适配性和灵活性可以匹配不同先进集成电路制造客户的工艺制程需求和不同工艺节点的工艺迭代/产能规划需求，减少工艺切换损耗，显著提升客户的生产效率和经济效益，助力客户提升在先进集成电路制造领域的竞争优势。

在大硅片抛光领域,对于 CMP 设备的金属和颗粒污染等工艺结果要求极高。目前全球大硅片衬底抛光 CMP 设备市场处于高度垄断状态,主要由冈本工作机械株式会社(即 Okamoto Machine Tool Works, Ltd)和应用材料两家国际设备制造商占据,设备国产化率低。标的公司针对大硅片抛光专门开发了 12 英寸硅片化学机械抛光设备(TTAIS®300 Si CMP)突破了高端硅片产品加工的技术瓶颈,同时实现了核心产品自主研发与制造。与同类产品相比,抛光平坦化和清洗效果均达到国际先进水平,能够适配先进制程工艺对高端硅片的要求。同时,单位设备产能、设备占地面积、设备性价比等指标达到行业领先水平。

在第三代半导体碳化硅衬底抛光领域,标的公司以原创性技术研发并首创了碳化硅衬底用电化学机械抛光技术和设备(TNTAS®ECMP),解决了碳化硅抛光效率低、良率低、生产成本低及化学品对环境影响大等难题。与传统化学机械抛光和强氧化性抛光设备相比,具有去除率高、单片抛光综合运营成本低、工艺条件温和、晶片加工质量高、安全环保等优点,填补了量产型碳化硅衬底电化学机械抛光设备领域的空白,为碳化硅功率器件、射频器件等规模化应用提供了关键装备保障。

### (1) 主营产品

公司主要产品如下:

序号	产品类别	产品型号	产品特征/应用领域	产品图示
1	CMP 装备	TTAIS®300 CMP	面向行业前沿需求开发的集先进平坦化工艺、高效率、高兼容性于一体的12英寸CMP装备。该装备采用6个独立研磨模组和2个独立清洗模组的全新紧凑架构,配置先进的终点检测技术与独特的耗材成本降低技术解决方式,具有高灵活性、高兼容性、低运营成本等特点,满足芯片制造的加工需求。主要应用于集成电路前道制造和先进封装。	

2	CMP 装备	TTAIS <sup>®</sup> 300 Si CMP	根据行业前沿应用技术要求开发的12英寸硅片CMP装备。该装备配备性能优越的硅片化学机械抛光和化学机械平坦化单元及清洗单元，卓越的工艺稳定性、高生产效率，可实现硅片表面的高平坦度和均匀性。主要应用于大硅片抛光。	
3	CMP 装备	TNTA S <sup>®</sup> EC MP	针对快速增长的新兴市场需求开发的第三代半导体材料碳化硅专用CMP装备。该装备配备了独特的碳化硅衬底电化学机械抛光解决方案，集成先进的单片自动传输设备，具有高去除率、高产能、高效率等优点，满足第三代半导体材料工艺器件的技术需求。	
4	CMP 抛 光 模 组	DMS <sup>®</sup> 单 / 双 CMP 模 组	该装备主要服务于研发机构及实验室场景，通过定制化研磨模组设计、先进终点控制技术、自动化工艺控制和整机通用设计，实现CMP工艺结果。	
5	研 磨 液 系 统	SDS <sup>®</sup>	根据市场需求开发的2个100升研磨液供液系统，该装备配备双重泵/过滤器式设计工艺，满足持续运行需求，适用制程包括Si/Poly/STI/ILD/W/Cu CMP等。	
6	研 磨 液 系 统	SDD <sup>®</sup>	根据市场需求开发的2个200升研磨液供液系统，该装备配备全自动系统，满足无杂质和颗粒污染需求，提供高效的系统数据监控与记录，适用制程包括Si/ Poly/ STI/ ILD/ W/ Cu CMP等。	

## (2) 采购模式

标的公司的采购基于未来销售订单及主要销售产品的市场预期进行，采购部及生产计划部基于对未来销售的预期和供应链效率对公司生产所需的零部件进行备货，相关采购流程由生产计划部提请系统审核，并由采购部收到审核完成的请购单后进行下单。

CMP 设备是实现化学机械抛光和化学机械平坦化工艺的全自动超精密装备，零部件的精度、洁净度、稳定性、可靠性和一致性对于整机的工艺性能和质量产生较大影响。为保证标的公司产品的质量和性能，标的公司制定了严格的供应商准入和审核制度，根据供应商技术能力、质量管控能力、生产能力、价格水平、交货周期、资产管理和服务等因素，选定合格的供应商纳入合格供应商名录。标的公司一般会与主要供应商签订框架协议并以订单形式具体执行采购。对于新品研发中出现的新物料需求，若现有合格供应商无法供应，则启动新供应商及相应原材料的评估和验证，验证通过后进行采购。

### （3）生产模式

标的公司主要根据客户订单或采购意向，并结合客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造，主要实行订单式生产和库存式生产相结合的生产管理方式。基于标的公司 CMP 设备采用模块化设计的优势，在客户有较明确采购预期时就可以开始安排产品的通用模块库存式生产，等待获得正式订单后再开始订单式生产，根据客户明确的技术参数和配置需求设计差异模块，生产剩余的通用模块（如有）和定制化方案中的差异模块。各个模块和功能单元由标的公司质量部门组织相关质量检测工作，全部满足要求后进行各单元和模块的整机组装工作，在过程中配置相应的软件系统，再进入下一环节。软件配置与系统测试是最终检验机台是否满足定制化需求的关键步骤，在全部测试完成后进行出货前质检及整机成品的包装出库。

### （4）销售模式

标的公司主要以直销模式销售产品，通过与客户商业谈判或招投标的方式获取订单。

标的公司设有市场销售部负责市场竞争分析、销售预测与规划、市场开发和产品销售。标的公司设有设备工程部为客户提供驻场服务，设

备工程部确保标的公司产品在客户生产环境中稳定、合规、高效地运行，最大化产品对客户价值，维护并深化客户关系，保障客户价值实现与满意度。具体包括负责标的公司产品在客户端的安装、调试、质保、维修、培训及服务等相关工作。

#### （5）研发模式

标的公司产品研发主要采取自主研发模式，建立了多部门协同配合的自主创新机制，研发中心（机械工程部、电气工程部、先进技术研发部、工艺工程部、工艺核心技术部、软件部）和技术工程部对新技术、新产品进行协同研发。新产品研发流程主要包括立项阶段、实施阶段和测试验收阶段。

#### （6）盈利模式

杭州众硅主营业务为高端化学机械抛光和化学机械抛光平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案，即通过向下游集成电路制造商、碳化硅功率器件厂商等销售 CMP 装备、抛光模组配置方案及研磨液供液系统等产品，并提供关键耗材与维保、升级等服务来实现收入和利润。

#### （7）核心竞争力

##### 1) 聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

标的公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，在 CMP 后清洗技术、终点检测控制技术、APC 智能控制技术、CMP 工艺应用等核心领域均实现创新突破并自主可控。如在终点检测控制技术上，开发了多样化多用途终点检测技术，包含了光谱终点检测系统，以及可融合的多频涡流终点检测系统和激光终点检测系统，适应不同材料不同膜厚检测需求，实现高精度实时反馈，确保抛光工艺的精准控制。其中白光终点检测技术，可在极短采集时间内对高转速抛光过程中大量白光光谱数据进行稳定且准确的实时提取。此外，标的公司已围绕核心

技术构建起全方位知识产权保护矩阵，核心技术自主可控。

标的公司是国内少数能够自主创新制造 12 英寸 CMP 设备的企业，其设备采用 6 抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备 4 盘或 3 盘的架构模式。6 抛光盘的设计不仅可同时支持 3 盘工艺或 2 盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅降低了设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了标的公司在 CMP 设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

### 2) 汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

标的公司创始团队来自浙江大学、南京大学、美国哥伦比亚大学、美国密苏里大学罗拉分校、美国加州大学伯克利分校劳伦斯-伯克利国家实验室等国内外知名高校/科研院所，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，标的公司组建了一支兼具国际视野与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，标的公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

### 3) 公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设

备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，标的公司自主研发并生产的CMP设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。标的公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

#### 4) 设备核心模块自研实现自主可控

CMP设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。标的公司已实现了诸如抛光头、旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研可降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产CMP设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

### （三）主要长期股权投资概述

截至本次评估基准日，杭州众硅电子科技有限公司长期股权投资4项，账面原值5,010,521.88元，计提减值准备10,521.88元，账面净值5,000,000.00元。具体如下：

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例	长期股权投资 账面价值
1	众硅电子科技（上海）有限公司	2022/02	100%	5,000,000.00
2	SIZONE TECHNOLOGY(HK) LIMITED	2021/08	100%	-
3	众进芯科技（福建）有限公司	2023/12	99%	-
4	众恩芯科技（青岛）有限公司	2022/12	99%	-

注：截至本报告书出具日，众恩芯科技（青岛）有限公司、众进芯科技（福建）有限公司已变更为标的公司全资子公司。

## 1、众硅电子科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号  
2 楼

法定代表人：HAIYANG GU

注册资本：500 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 14 日

统一社会信用代码：91310000MA7GM08053

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （1）公司简介

众硅电子科技（上海）有限公司成立于 2022 年 2 月 14 日，公司注册资本为 500.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众硅电子科技（上海）有限公司实收资本 500.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00	500.00	100.00

### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 348.62 万元，负债为 2,078.80 万元，净资产-1,730.17 万元。截至评估基

准日，实现营业收入 116.10 万元，净利润-717.90 万元。

## 2、众恩芯科技（青岛）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼 102 室 2026-0562（A）

法定代表人：朱琳

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91370220MAC6AK4762

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （1）公司简介

众恩芯科技（青岛）有限公司成立于 2022 年 12 月 19 日，公司注册资本为 1,000.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司和朱琳共同发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00
2	朱琳	10.00	1.00
	合计	1,000.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众恩芯科技（青岛）有限公司实收资本 0.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	朱琳	10.00	1.00	0.00	0.00
	合计	1,000.00	100.00	0.00	0.00

## （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 0.07 万元，负债为 0.20 万元，净资产为-0.13 万元。截至评估基准日，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.03 万元。

### 3、Sizone Technology (HK) Limited

公司类型：私人股份有限公司

公司地址：RM 1002, 10/F EASEY COMM, BLDG 253-261  
HENNESSY RD, WAN CHAI, HONG KONG

成立日期：2021 年 8 月 4 日

#### （1）公司简介

Sizone Technology (HK) Limited 成立于 2021 年 8 月 4 日，公司注册资本为 1.00 万港元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万港元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00
	合计	1.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，Sizone Technology (HK) Limited 实收资本 1.00 万港元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万港元）	注册比例%	实收资本（万港元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00	1.00	100.00
	合计	1.00	100.00	1.00	100.00

#### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 0.00 万元，负债为 0.00 万元，净资产为 0.00 万元。截至评估基准日，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.62 万元。

### 4、众进芯科技（福建）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：福建省晋江市福兴东路罗山段3号

法定代表人：刘李

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2023年12月19日

统一社会信用代码：91350582MAD7GFQT8Q

经营范围：一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （1）公司简介

众进芯科技（福建）有限公司成立于2023年12月19日，公司注册资本为1,000.00万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

截至评估基准日2025年12月31日，众进芯科技（福建）有限公司实收资本0.00万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	刘李	10.00	1.00	0.00	0.00
合计		1,000.00	100.00	0.00	0.00

#### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日2025年12月31日，该公司尚未建账，资产总额为0.00，净资产为0.00。

#### （四）委托人与被评估单位之间的关系

本次资产评估的委托人为中微半导体设备（上海）股份有限公司，被评估单位为杭州众硅电子科技有限公司。委托人为被评估单位的股东

及股权拟收购方。

### （五）其他资产评估报告使用人

资产评估委托合同未约定其他报告使用人。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

## 二、评估目的

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》，中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69% 股权。为此，中微半导体设备（上海）股份有限公司需了解杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益于评估基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值。

本次资产评估的目的是反映杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考。

## 三、评估对象和评估范围

评估对象是杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值。评估范围为杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债。

合并报表口径下，根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后合并报表，合并报表口径下公司资产总额为 102,212.56 万元，负债总额为 26,932.17 万元，净资产为 75,280.39 万元。其中，流动资产 96,359.75 万元，非流动资产 5,852.82 万元；流动负债 25,714.73 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

母公司报表口径下，根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后单体报表，公司资产总额为 104,275.53 万元，负债总额为 26,755.27

万元，净资产为 77,520.26 万元。其中，流动资产 98,014.37 万元，非流动资产 6,261.16 万元；流动负债 25,537.84 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

上述资产与负债数据摘自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的被评估单位 2025 年 12 月 31 日标准无保留意见的《审计报告》（普华永道中天特审字(2026)第 0065 号），评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

### （一）委估主要资产情况

本次评估范围中的主要资产为应收账款、存货、固定资产、无形资产等。其中，应收账款主要为应收下游客户设备销售货款；存货主要为生产 CMP 设备相关的原材料、委托加工物资、产成品、在产品、发出商品等；固定资产主要为经营用固定资产，包括车辆、机器设备及电子设备；无形资产主要为外购软件及账面未记录的专利权、软件著作权、商标、域名等。

### （二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截至评估基准日，企业申报的账面记录的无形资产为 20 项外购软件，账面未记录的无形资产共 353 项。其中已注册中国境内商标共计 68 项，已注册中国境外商标共计 53 项，注册中的商标 3 项，软件著作权 8 项，已获批准的中国境内专利权 106 项，其中 42 项为发明专利、53 项为实用新型专利、11 项为外观设计专利，已获批准的中国境外专利权 114 项，其中 89 项为发明专利、23 项为外观设计专利、2 项为实用新型专利，域名 1 项，具体情况如下：

#### 1、外购软件












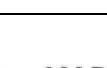

序号	名称	取得日期	所有权人
1	中望 3D 软件	2025/08	杭州众硅电子科技有限公司
2	杭州北山科技有限公司中望 CAD 平台软件 5 套	2023/08	杭州众硅电子科技有限公司
3	中望 CAD 软件	2024/05	杭州众硅电子科技有限公司
4	中望 CAD 平台软件 V2020(5 套)	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
5	KeyShot11Pro	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
6	MATLAB	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
7	PLM 系统	2019/01	杭州众硅电子科技有限公司
8	ERP 系统	2019/09	杭州众硅电子科技有限公司
9	6400 网络安全系统一套	2021/09	杭州众硅电子科技有限公司
10	中望 3D 平台设计软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
11	中望 CAD 平台软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
12	中望 3D 平台设计软件 V2022	2021/07	杭州众硅电子科技有限公司
13	中望 3D 平台设计软件 V2023	2022/06	杭州众硅电子科技有限公司
14	中望 CAD2023 专业版	2022/08	杭州众硅电子科技有限公司
15	中望 3D2023 标准版升级	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
16	广州中望龙腾软件股份有限公司杭州众硅 3D 产品功能开发费	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
17	中望 3D 平台设计软件 V2022（5 套）	2022/11	杭州众硅电子科技有限公司
18	COMSOL	2022/10	杭州众硅电子科技有限公司
19	MDK	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
20	KEIL	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司

## 2、商标


境内商标明细如下：






序号	权利人	注册号	商标标识	专用权期限	使用类别
1	杭州众硅	83471595		2025-09-07 至 2035-09-06	7 类 机械设备
2	杭州众硅	80450440		2025-07-07 至 2035-07-06	9 类 科学仪器


3	杭州众硅	79453564	<b>sMAP</b>	2025-03-28 至 2035-03-27	9 类 科学仪器
4	杭州众硅	78465551	<b>TNTAS eCMP</b>	2024-10-28 至 2034-10-27	9 类 科学仪器
5	杭州众硅	78465536	<b>TNTAS eCMP</b>	2024-10-28 至 2034-10-27	7 类 机械设备
6	杭州众硅	76918083	<b>dView</b>	2024-08-28 至 2034-08-27	7 类 机械设备
7	杭州众硅	76541431	<b>hCMP</b>	2024-07-28 至 2034-07-27	7 类 机械设备
8	杭州众硅	76532744	<b>hCMP</b>	2024-07-21 至 2034-07-20	9 类 科学仪器
9	杭州众硅	76100178	<b>mCMP</b>	2024-07-14 至 2034-07-13	7 类 机械设备
10	杭州众硅	76120133	<b>mCMP</b>	2024-07-14 至 2034-07-13	9 类 科学仪器
11	杭州众硅	75675889	<b>eView</b>	2024-08-21 至 2034-08-20	9 类 科学仪器
12	杭州众硅	75684558	<b>sView</b>	2024-06-07 至 2034-06-06	7 类 机械设备
13	杭州众硅	75681896	<b>eView</b>	2024-08-21 至 2034-08-20	7 类 机械设备
14	杭州众硅	75681934	<b>sView</b>	2025-06-14 至 2035-06-13	9 类 科学仪器
15	杭州众硅	75374290	<b>mMAP</b>	2024-08-21 至 2034-08-20	7 类 机械设备

16	杭州众硅	75354106		2024-08-14 至 2034-08-13	9 类 科学仪器
17	杭州众硅	75364792		2024-06-07 至 2034-06-06	9 类 科学仪器
18	杭州众硅	75354086		2024-06-07 至 2034-06-06	7 类 机械设备
19	杭州众硅	75285972A		2024-06-14 至 2034-06-13	7 类 机械设备
20	杭州众硅	75285972		2025-06-21 至 2035-06-20	7 类 机械设备
21	杭州众硅	74918117		2024-05-28 至 2034-05-27	7 类 机械设备
22	杭州众硅	73335681		2024-02-07 至 2034-02-06	7 类 机械设备
23	杭州众硅	73345937		2024-02-14 至 2034-02-13	9 类 科学仪器
24	杭州众硅	73263142		2024-04-07 至 2034-04-06	9 类 科学仪器
25	杭州众硅	73266569		2024-04-07 至 2034-04-06	7 类 机械设备
26	杭州众硅	73247718		2024-04-07 至 2034-04-06	9 类 科学仪器
27	杭州众硅	73254489		2024-04-07 至 2034-04-06	7 类 机械设备
28	杭州众硅	71449178		2023-10-28 至 2033-10-27	3 类 日化用品

29	杭州众硅	71453805	 SIZONE	2024-02-28 至 2034-02-27	9 类 科学仪器
30	杭州众硅	71324724	 SIZONE	2024-12-07 至 2034-12-06	42 类 设计研究
31	杭州众硅	71046046	 WCMP	2024-04-21 至 2034-04-20	9 类 科学仪器
32	杭州众硅	71043369	 tCMP	2023-10-21 至 2033-10-20	7 类 机械设备
33	杭州众硅	71054635	 tCMP	2023-10-07 至 2033-10-06	9 类 科学仪器
34	杭州众硅	71040472	 WCMP	2023-10-07 至 2033-10-06	7 类 机械设备
35	杭州众硅	69985134	 CMP <sup>e</sup>	2024-01-21 至 2034-01-20	9 类 科学仪器
36	杭州众硅	69474158	 ZHONG GUI	2024-03-21 至 2034-03-20	7 类 机械设备
37	杭州众硅	69130284	 SIZONE	2023-09-21 至 2033-09-20	7 类 机械设备
38	杭州众硅	69135169	 TTAIS	2023-09-21 至 2033-09-20	9 类 科学仪器
39	杭州众硅	69134470	 SIZONE	2023-09-21 至 2033-09-20	40 类 材料加工
40	杭州众硅	69120026	 SIZONE	2023-10-07 至 2033-10-06	1 类 化学原料
41	杭州众硅	69120069	 SIZONE	2023-09-14 至 2033-09-13	37 类 建筑修理

42	杭州众硅	69136420	<b>TTAIS</b>	2023-09-07 至 2033-09-06	7 类 机械设备
43	杭州众硅	69129658	 SIZONE	2024-11-28 至 2034-11-27	42 类 设计研究
44	杭州众硅	67125479	<b>sCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
45	杭州众硅	67129953	<b>sCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	9 类 科学仪器
46	杭州众硅	67116815	<b>xCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
47	杭州众硅	65713545	<b>TNTAS</b>	2023-01-21 至 2033-01-20	9 类 科学仪器
48	杭州众硅	65715828	<b>TTAIS</b>	2024-04-14 至 2034-04-13	7 类 机械设备
49	杭州众硅	65720217	<b>TMTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备
50	杭州众硅	65734434	<b>TNTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备
51	杭州众硅	65713519	<b>TTAISN</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	9 类 科学仪器
52	杭州众硅	65718889	<b>TMTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	9 类 科学仪器
53	杭州众硅	65738714	<b>TTAIS</b>	2023-03-21 至 2033-03-20	9 类 科学仪器
54	杭州众硅	65738637	<b>TTAISN</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备

55	杭州众硅	65715828A		2023-02-28 至 2033-02-27	7 类 机械设备
56	杭州众硅	65341636	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
57	杭州众硅	65352408	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
58	杭州众硅	65344838	SIZONE SDS	2022-11-28 至 2032-11-27	7 类 机械设备
59	杭州众硅	65344892	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
60	杭州众硅	65352855	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
61	杭州众硅	65352699	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
62	杭州众硅	65337973	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
63	杭州众硅	65352697	SIZONE SDS	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
64	杭州众硅	34700114		2019-07-07 至 2029-07-06	9 类 科学仪器
65	杭州众硅	34700098		2019-07-07 至 2029-07-06	7 类 机械设备
66	杭州众硅	32274636		2019-04-07 至 2029-04-06	9 类 科学仪器
67	杭州众硅	32274633		2019-12-21 至 2029-12-20	7 类 机械设备

68	杭州众硅	32279159		2020-04-21 至 2030-04-20	9 类 科学仪器
----	------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------

境外商标明细如下：

序号	商标名称	国家/地区/组织	注册地	注册号	类别	注册日	有效期	权利人	取得方式	他项权利
1		马德里国际注册	日本	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
2			日本	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
3			韩国	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
4			韩国	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
5			美国	6297605	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
6			美国	6291605	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
7			欧盟	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
8			欧盟	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
9			新加坡	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
10			新加坡	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
11				中国台湾	中国台湾	02109945	7 类、9 类	2020-12-16	2030-12-15	杭州众硅
12		马德里国际注册	日本	1548407	7 类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
13		日本	日本	6387275	9 类	2021-05-11	2031-05-11	杭州众硅	原始取得	无
14		马德里国际注册	韩国	1548407	7 类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
15		韩国	韩国	40-1752832	9 类	2021-07-15	2031-07-15	杭州众硅	原始取得	无
16		马德里国际注册	美国	6268972	7 类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
17		美国	美国	6444084	9 类	2021-08-10	2031-08-10	杭州众硅	原始取得	无
18		马德里国际注册	欧盟	1548407	7 类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无

19		欧盟	欧盟	018224343	9类	2020-08-01	2030-04-10	杭州众硅	原始取得	无
20		马德里国际注册	新加坡	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
21		新加坡	新加坡	40202009597U	9类	2020-05-08	2030-05-08	杭州众硅	原始取得	无
22		中国台湾	中国台湾	02099392	7类、9类	2020-11-01	2030-10-31	杭州众硅	原始取得	无
23	TTAIS	欧盟	欧盟	018823748	7类、9类	2023-06-14	2033-01-19	杭州众硅	原始取得	无
24		韩国	韩国	40-2270814	7类	2024-11-08	2034-11-08	杭州众硅	原始取得	无
25		韩国	韩国	40-2270830	9类	2024-11-04	2034-11-04	杭州众硅	原始取得	无
26		日本	日本	6717320	7类、9类	2023-07-13	2033-07-13	杭州众硅	原始取得	无
27		新加坡	新加坡	40202302136W	7类、9类	2023-02-07	2033-02-07	杭州众硅	原始取得	无
28		中国台湾	中国台湾	02316528	7类	2023-09-01	2033-08-31	杭州众硅	原始取得	无
29		中国台湾	中国台湾	02316740	9类	2023-09-01	2033-08-31	杭州众硅	原始取得	无
30		TTAIS	美国	美国	7666240	7类、9类	2025-01-28	2035-01-29	杭州众硅	原始取得
31	TNTAS	欧盟	欧盟	018865670	7类、9类	2023-09-12	2033-04-21	杭州众硅	原始取得	无
32		日本	日本	6747127	7类、9类	2023-10-20	2033-10-20	杭州众硅	原始取得	无
33		中国台湾	中国台湾	02334452	7类	2023-11-16	2033-11-15	杭州众硅	原始取得	无
34		中国台湾	中国台湾	02334712	9类	2023-11-16	2033-11-15	杭州众硅	原始取得	无
35		新加坡	新加坡	40202309676Y	7类、9类	2024-03-13	2033-05-04	杭州众硅	原始取得	无
36		美国	美国	7432079	7类、9类	2024-07-02	2034-07-03	杭州众硅	原始取得	无
37		韩国	韩国	40-2283338	7类	2024-12-02	2034-12-01	杭州众硅	原始取得	无
38		韩国	韩国	40-2283341	9类	2024-12-02	2034-12-01	杭州众硅	原始取得	无

39	mCMP	新加坡	新加坡	40202501796W	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
40		中国台湾	中国台湾	02484328	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
41	tCMP	新加坡	新加坡	40202501797R	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
42		中国台湾	中国台湾	02484327	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
43	xCMP	新加坡	新加坡	40202501798P	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
44		中国台湾	中国台湾	02484326	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
45	dView	新加坡	新加坡	40202501793X	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
46		中国台湾	中国台湾	02474470	9类	2025-08-16	2035-08-15	杭州众硅	原始取得	无
47	eView	新加坡	新加坡	40202501792S	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
48		中国台湾	中国台湾	02484467	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
49	sView	新加坡	新加坡	40202501794V	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
50		中国台湾	中国台湾	02484466	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
51	mCMP	美国	美国	7982584	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
52	tCMP	美国	美国	7982583	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
53	xCMP	美国	美国	7982582	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无

注册中的商标明细如下:

序号	内容或名称	取得日期	专利号或注册号
1		2025/02	78483204
2		2025/02	83718856
3		2025/02	83708238

### 3、软件著作权

序号	权利人	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	首次发表日	他项权利
1	杭州众硅	Sizone Canaan CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第3979698号	2019SR0558941	原始取得	未发表	无
2	杭州众硅	Sizone SINAI CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第6652088号	2020SR1849086	原始取得	未发表	无

序号	权利人	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	首次发表日	他项权利
3	杭州众硅	Sizone ZION CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 7676983 号	2021SR0954357	原始取得	未发表	无
4	杭州众硅	Sizone DRACO CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 9688894 号	2022SR0734695	原始取得	未发表	无
5	杭州众硅	SDS 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 9639224 号	2022SR0685025	原始取得	未发表	无
6	杭州众硅	Sizone SHEBA CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 11645217 号	2023SR1058044	原始取得	未发表	无
7	杭州众硅	Sizone LAMB CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 11646342 号	2023SR1059169	原始取得	未发表	无
8	杭州众硅	Sizone Dove 第三代半导体系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 12283993 号	2023SR1696820	原始取得	未发表	无

#### 4、专利

中国境内专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得途径	法律状态	他项权利
1	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023112396583	2023-09-22	发明	原始取得	授权	无
2	杭州众硅	一种抛光垫沟槽在线修整方法及装置	2025112141085	2025-08-28	发明	原始取得	授权	无
3	杭州众硅	一种用于晶圆清洗装置的从动机构及晶圆清洗装置	2025113685359	2025-09-24	发明	原始取得	授权	无
4	杭州众硅	一种化学机械抛光在线监测方法	2025110653799	2025-07-31	发明	原始取得	授权	无
5	杭州众硅	一种用于 CMP 设备抛光垫沟槽修整的方法	2023112936007	2023-10-08	发明	原始取得	授权	无
6	杭州众硅	站立式晶圆卡座	202111533401X	2021-12-15	发明	原始取得	授权	无
7	杭州众硅	一种可调平式抛光盘及抛光系统	2024223742429	2024-09-27	实用新型	原始取得	授权	无
8	杭州众硅	一种晶圆提拉结构	2025103110213	2025-03-17	发明	原始取得	授权	无
9	杭州众硅	一种用于快速调温的化学液输送单元及化学机械平坦化设备	2024206596934	2024-04-01	实用新型	原始取得	授权	无
10	杭州众硅	抛光研磨装置	2024304771328	2024-07-30	外观设计	原始取得	授权	无
11	杭州众硅	一种电化学机械抛光及平坦化装置	2024211355783	2024-05-23	实用新型	原始取得	授权	无
12	杭州众硅	一种用于半导体湿法设备的晶圆定位检测方法	2024116930911	2024-11-25	发明	原始取得	授权	无
13	杭州众硅	一种用于电化学机械平坦化设备的电抛光头、导电	2025101877875	2025-02-20	发明	原始取得	授权	无

		系统及其装配方法						
14	杭州众硅	联动式单动力源控制间停机构、晶圆修整机构及工作方法	2024116669404	2024-11-21	发明	原始取得	授权	无
15	杭州众硅	一种晶圆搬运装置及抛光系统、抛光工艺	2024116612270	2024-11-20	发明	原始取得	授权	无
16	杭州众硅	一种抛光垫及晶圆抛光系统	2024203287163	2024-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
17	杭州众硅	一种化学机械抛光及平坦化系统	2024204236775	2024-03-05	实用新型	原始取得	授权	无
18	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2024202256223	2024-01-30	实用新型	原始取得	授权	无
19	杭州众硅	一种用于导电晶圆的传输装置	2024208760026	2024-04-25	实用新型	原始取得	授权	无
20	杭州众硅	一种带有压力检测的修整装置	2024210918589	2024-05-17	实用新型	原始取得	授权	无
21	杭州众硅	一种晶圆旋转干燥装置	2024206000894	2024-03-26	实用新型	原始取得	授权	无
22	杭州众硅	化学机械平坦化装置	2024301324801	2024-03-15	外观设计	原始取得	授权	无
23	杭州众硅	抛光研磨装置	2024300460724	2024-01-24	外观设计	原始取得	授权	无
24	杭州众硅	一种导电型晶圆化学机械抛光系统	2023233277503	2023-12-05	实用新型	原始取得	授权	无
25	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法	2019104814482	2019-06-04	发明	原始取得	授权	无
26	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023226009702	2023-09-22	实用新型	原始取得	授权	无
27	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	2021104070747	2021-04-15	发明	原始取得	授权	无
28	杭州众硅	一种晶圆传输机械手	2021102933431	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
29	杭州众硅	晶圆夹持臂夹爪	2022305192323	2022-08-10	外观设计	原始取得	授权	无
30	杭州众硅	一种可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	2020113382226	2020-11-25	发明	原始取得	授权	无
31	杭州众硅	晶圆抛光系统	2023218495446	2023-07-13	实用新型	原始取得	授权	无
32	杭州众硅	一种晶圆传输装置	2023216687244	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
33	杭州众硅	一种晶圆传输监测系统	2023218599746	2023-07-13	实用新型	原始取得	授权	无
34	杭州众硅	一种预清洗输入装置	2023216754959	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
35	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2023216722892	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
36	杭州众硅	一种 CMP 抛光垫再加工装置	2023216039222	2023-06-21	实用新型	原始取得	授权	无

37	杭州众硅	一种用于半导体清洗单元的晶圆有无检测装置	2023208720594	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
38	杭州众硅	一种拼接式工作台机构	2023209035886	2023-04-20	实用新型	原始取得	授权	无
39	杭州众硅	一种晶圆清洁干燥模组状态检测方法、装置及平坦化设备	2022105084239	2022-05-11	发明	原始取得	授权	无
40	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2023203161480	2023-02-14	实用新型	原始取得	授权	无
41	杭州众硅	一种抛光垫加工装置	2022229899063	2022-11-07	实用新型	原始取得	授权	无
42	杭州众硅	一种晶圆清洗箱	2023201723676	2023-01-13	实用新型	原始取得	授权	无
43	杭州众硅	一种排风脏污收集装置及化学机械平坦化抛光设备	2023208367028	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
44	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229651320	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
45	杭州众硅	应用于导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229771233	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
46	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械抛光及平坦化系统	2022229614336	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
47	杭州众硅	一种晶圆干燥装置	2023205456301	2023-03-14	实用新型	原始取得	授权	无
48	杭州众硅	一种用于化学机械平坦化白光终点检测的采集方法及系统	2022106070657	2022-05-31	发明	原始取得	授权	无
49	杭州众硅	一种导电型抛光头固定装置及导电型抛光头系统	2022231254625	2022-11-23	实用新型	原始取得	授权	无
50	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023201637007	2023-01-13	实用新型	原始取得	授权	无
51	杭州众硅	晶圆夹持器	2022305191918	2022-08-10	外观设计	原始取得	授权	无
52	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022234891659	2022-12-22	实用新型	原始取得	授权	无
53	杭州众硅	一种晶圆干燥抬升方法	2023102418938	2023-03-14	发明	原始取得	授权	无
54	杭州众硅	一种晶圆有无检测的提拉结构机械手	2022228546755	2022-10-26	实用新型	原始取得	授权	无
55	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	2022103161527	2022-03-29	发明	原始取得	授权	无
56	杭州众硅	一种清洗刷预清洗系统	2020101573307	2020-03-09	发明	原始取得	授权	无
57	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022112694450	2022-10-18	发明	原始取得	授权	无
58	杭州众硅	抛光研磨装置（150&300）	2022304099308	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无

59	杭州众硅	一种涡流终点检测装置及方法	2022112574529	2022-10-14	发明	原始取得	授权	无
60	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	202222128694X	2022-08-12	实用新型	原始取得	授权	无
61	杭州众硅	一种晶圆循环清洗系统	2022221015365	2022-08-10	实用新型	原始取得	授权	无
62	杭州众硅	一种晶圆夹持装置	2022220957792	2022-08-10	实用新型	原始取得	授权	无
63	杭州众硅	抛光研磨装置（300β）	2022304103360	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无
64	杭州众硅	抛光研磨装置（200s）	2022304096846	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无
65	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	2022107327358	2022-06-27	发明	原始取得	授权	无
66	杭州众硅	一种晶圆搬运装置	2022214128871	2022-06-07	实用新型	原始取得	授权	无
67	杭州众硅	供液装置	2022305164982	2022-08-09	外观设计	原始取得	授权	无
68	杭州众硅	清洗装置	2022305055190	2022-08-04	外观设计	原始取得	授权	无
69	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022216587824	2022-06-30	实用新型	原始取得	授权	无
70	杭州众硅	一种晶圆传递装置	2022207093191	2022-03-29	实用新型	原始取得	授权	无
71	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2021114452396	2021-11-30	发明	原始取得	授权	无
72	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置	2022209517117	2022-04-24	实用新型	原始取得	授权	无
73	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2021230946535	2021-12-10	实用新型	原始取得	授权	无
74	杭州众硅	一种提拉式晶圆传输机构	2022202326195	2022-01-26	实用新型	原始取得	授权	无
75	杭州众硅	一种晶圆检测系统	2022203603706	2022-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
76	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229713411	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无
77	杭州众硅	一种动态检测装置及化学机械平坦化设备	2022101643690	2022-02-23	发明	原始取得	授权	无
78	杭州众硅	晶圆驱动机构	2021230426920	2021-12-06	实用新型	原始取得	授权	无
79	杭州众硅	一种站立式晶圆卡座	2021231583806	2021-12-15	实用新型	原始取得	授权	无
80	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	2022100041307	2022-01-05	发明	原始取得	授权	无
81	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法及检测系统	2022100773979	2022-01-24	发明	原始取得	授权	无
82	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229694980	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无

83	杭州众硅	一种晶圆抛光装置	2021112182640	2021-10-20	发明	原始取得	授权	无
84	杭州众硅	一种用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	2021114722319	2021-12-06	发明	原始取得	授权	无
85	杭州众硅	一种晶圆紧固装置	2021216969237	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
86	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	2021225192769	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
87	杭州众硅	一种用于晶圆的紧固装置	2021216969256	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
88	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	2021225191535	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
89	杭州众硅	晶圆紧固装置	2021216940328	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
90	杭州众硅	抛光装置	2021304973519	2021-08-03	外观设计	原始取得	授权	无
91	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥方法及机构	2021108994674	2021-08-06	发明	原始取得	授权	无
92	杭州众硅	一种多工位夹取装置	202110770071X	2021-07-08	发明	原始取得	授权	无
93	杭州众硅	一种晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	2019104403343	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
94	杭州众硅	一种结合研磨和单晶圆清洗模组的化学机械平坦化设备	2019111130957	2019-11-14	发明	原始取得	授权	无
95	杭州众硅	一种抛光装置	202011419911X	2020-12-08	发明	原始取得	授权	无
96	杭州众硅	用于化学机械平坦化设备的抛光头压力控制设备及方法	2019113033010	2019-12-17	发明	原始取得	授权	无
97	杭州众硅	抛光头检测装置、腔室气密性和传感器有效性检测方法	2021104488565	2021-04-25	发明	原始取得	授权	无
98	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	2021102490467	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
99	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	2021102490255	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
100	杭州众硅	一种晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	2019108427084	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
101	杭州众硅	一种晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	2020107204397	2020-07-24	发明	原始取得	授权	无
102	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2020102077484	2020-03-23	发明	原始取得	授权	无
103	杭州众硅	基于光谱的化学机械抛光在线终点检测方法	2019104403451	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
104	杭州众硅	一种化学机械抛光平坦化晶圆传输设备	2019208326110	2019-06-04	实用新型	原始取得	授权	无

105	杭州众硅	一种晶圆清洗装置	2019209736837	2019-06-26	实用新型	原始取得	授权	无
106	杭州众硅	内置式双重限位机构	2019202198142	2019-02-21	实用新型	原始取得	授权	无

中国境外专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	国家/地区/组织	专利号	申请日	授权日	专利类型	取得方式	他项权利
1	杭州众硅	一种抛光装卸部件模块	美国	US 12,194,592 B2	2021-03-22	2025-01-14	发明	原始取得	无
2	杭州众硅		新加坡	11202102935Q	2019-08-28	2025-08-12	发明	原始取得	无
3	杭州众硅		韩国	10-2584030	2021-04-19	2023-09-25	发明	原始取得	无
4	杭州众硅	用于 CMP 工艺的晶片装载支架、晶片装载系统和晶片安装方法	美国	US 12,103,134 B2	2019-09-04	2024-10-01	发明	原始取得	无
5	杭州众硅		新加坡	11202111470X	2019-09-04	2025-01-27	发明	原始取得	无
6	杭州众硅		韩国	10-2605197	2021-09-13	2023-11-20	发明	原始取得	无
7	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法、晶圆平坦化单元	美国	US 12,251,785 B2	2019-08-20	2025-03-18	发明	原始取得	无
8	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆转移方法、晶圆平坦化装置	韩国	10-2533567	2021-04-07	2023-05-12	发明	原始取得	无
9	杭州众硅		新加坡	11202103477T	2019-08-20	2023-09-19	发明	原始取得	无
10	杭州众硅	晶圆检测装置及使用该装置的晶圆检测方法	美国	US 11,961,749 B2	2020-08-04	2024-04-16	发明	原始取得	无

11	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备、晶圆传送机器人及晶圆翻转方法	韩国	10-2709839	2021-04-27	2024-09-20	发明	原始取得	无
12	杭州众硅		新加坡	11202103852Y	2019-09-26	2024-02-08	发明	原始取得	无
13	杭州众硅		美国	US 11,908,720 B2	2021-04-09	2024-02-20	发明	原始取得	无
14	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	美国	US 12,482,674 B2	2020-09-29	2025-11-25	发明	原始取得	无
15	杭州众硅		韩国	10-2705137	2022-06-20	2024-09-05	发明	原始取得	无
16	杭州众硅	晶圆输送装置、化学机械平坦化装置及晶圆输送方法	美国	US 12,427,619 B2	2020-08-06	2025-09-30	发明	原始取得	无
17	杭州众硅	晶圆位置检测装置	日本	7638389	2021-10-20	2025-02-20	发明	原始取得	无
18	杭州众硅		韩国	10-2858973	2023-09-08	2025-09-09	发明	原始取得	无
19	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	日本	7714253	2022-10-14	2025-07-18	发明	原始取得	无
20	杭州众硅	晶圆抛光系统	韩国	10-2837898	2024-02-14	2025-07-21	发明	原始取得	无
21	杭州众硅		日本	7712007	2022-08-30	2025-07-14	发明	原始取得	无
22	杭州众硅	晶圆抛光装置	美国	US 11,794,304 B2	2022-01-19	2023-10-24	发明	原始取得	无
23	杭州众硅		韩国	10-2693838	2022-02-24	2024-08-06	发明	原始取得	无
24	杭州众硅		新加坡	10202201571V	2022-02-18	2024-08-21	发明	原始取得	无
25	杭州众硅	晶圆抛光系统	日本	7728045	2022-08-30	2025-08-14	发明	原始取得	无
26	杭州众硅		韩国	10-2837898	2024-02-14	2025-07-21	发明	原始取得	无
27	杭州众硅	抛光研磨装置	美国	US D1,018,612 S	2022-10-19	2024-03-19	外观设计	原始取得	无

28	杭州众硅		韩国	DM/226149	2022-10-19	2023-11-28	外观设计	原始取得	无
29	杭州众硅		新加坡	DM/226149	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
30	杭州众硅		日本	1748952	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
31	杭州众硅		欧盟	DM/226149	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
32	杭州众硅	抛光研磨装置	美国	US D1, 018, 613 S	2022-10-19	2024-03-19	外观设计	原始取得	无
33	杭州众硅		韩国	DM/226151	2022-10-19	2023-11-28	外观设计	原始取得	无
34	杭州众硅		新加坡	DM/226151	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
35	杭州众硅		日本	1748953	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
36	杭州众硅		欧盟	DM/226151	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
37	杭州众硅		美国	US 12,017,293 B2	2023-01-19	2024-06-25	发明	原始取得	无
38	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	欧盟	EP 4364890	2023-03-15	2025-07-02	发明	原始取得	无
39	杭州众硅		韩国	10-2819458	2023-03-30	2025-06-09	发明	原始取得	无
40	杭州众硅		日本	7688074	2023-05-30	2025-05-26	发明	原始取得	无
41	杭州众硅		用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	日本	3253377	2022-11-09	2025-10-16	实用新型	原始取得
42	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	日本	7660959	2022-11-09	2025-04-04	发明	原始取得	无
43	杭州众硅	用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	日本	7788191	2022-11-09	2025-12-10	发明	原始取得	无
44	杭州众硅	抛光垫修整装置	日本	7773262	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
45	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	日本	7773261	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
46	杭州众硅	抛光垫表面状况在线检测方法 & 检测系统	韩国	10-2904378	2024-06-13	2025-12-22	发明	原始取得	无

47	杭州众硅	晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	韩国	10-2816529	2024-07-17	2025-05-29	发明	原始取得	无
48	杭州众硅	抛光研磨装置（ECMP 外观）	韩国	DM/237809	2024-05-23	2025-02-17	外观设计	原始取得	无
49	杭州众硅		加拿大	231357	2024-05-23	2025-04-03	外观设计	原始取得	无
50	杭州众硅		日本	1790565	2024-05-23	2025-01-27	外观设计	原始取得	无
51	杭州众硅		欧盟	DM/237809	2024-05-23	2024-07-11	外观设计	原始取得	无
52	杭州众硅	抛光研磨装置（TANAS,EFE M T 形）	韩国	DM/240665	2024-08-29	2025-07-25	外观设计	原始取得	无
53	杭州众硅		日本	1794400	2024-08-29	2025-03-17	外观设计	原始取得	无
54	杭州众硅		日本	1799656	2024-08-29	2025-05-19	外观设计	原始取得	无
55	杭州众硅		欧盟	DM/240665	2024-08-29	2024-10-28	外观设计	原始取得	无
56	杭州众硅	包含可移动装卸模组的研磨装卸构件模组及其晶圆传输方法	中国台湾	I 731281	2018-11-26	2021-06-21	发明	原始取得	无
57	杭州众硅	可挠性的抛光装卸部件模组及晶圆传输的方法	中国台湾	I 739048	2018-11-19	2021-09-11	发明	原始取得	无
58	杭州众硅	CMP 制程的晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	中国台湾	I 713141	2019-11-25	2020-12-11	发明	原始取得	无
59	杭州众硅	化学机械研磨设备	中国台湾	I 806931	2018-11-22	2023-07-01	发明	原始取得	无
60	杭州众硅	化学机械平坦化晶圆传输设备及其使用方法	中国台湾	I 717119	2019-11-22	2021-01-21	发明	原始取得	无
61	杭州众硅	晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	中国台湾	I 773943	2019-11-25	2022-08-11	发明	原始取得	无
62	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备	中国台湾	I 695422	2018-11-20	2020-06-01	发明	原始取得	无
63	杭州众硅	清洗刷预清洗系统	中国台湾	I 757924	2020-10-22	2022-03-11	发明	原始取得	无

64	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	中国台湾	I 837429	2020-10-22	2024-04-01	发明	原始取得	无
65	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无
66	杭州众硅	晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	中国台湾	I 734635	2020-10-22	2021-07-21	发明	原始取得	无
67	杭州众硅	可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	中国台湾	I 823141	2021-09-08	2023-11-21	发明	原始取得	无
68	杭州众硅	抛光装置	中国台湾	I 815179	2021-09-08	2023-09-11	发明	原始取得	无
69	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	中国台湾	I 794963	2021-09-08	2023-03-01	发明	原始取得	无
70	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	中国台湾	I 787998	2021-09-08	2022-12-21	发明	原始取得	无
71	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	中国台湾	I 834990	2021-09-08	2024-03-11	发明	原始取得	无
72	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	中国台湾	I 816394	2022-05-11	2023-09-21	发明	原始取得	无
73	杭州众硅	一种修整头旋转部件、抛光垫修整头和修整器	中国台湾	I 801997	2021-09-08	2023-05-11	发明	原始取得	无
74	杭州众硅	多工位夹取装置	中国台湾	I 816180	2021-09-08	2023-09-21	发明	原始取得	无
75	杭州众硅	晶圆清洗干燥方法及晶圆清洗干燥机构	中国台湾	I 803379	2022-07-01	2023-05-21	发明	原始取得	无
76	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 825934	2022-08-22	2023-12-11	发明	原始取得	无
77	杭州众硅	一种晶圆研磨装置	中国台湾	I 829054	2021-12-23	2024-01-11	发明	原始取得	无
78	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	中国台湾	I 839861	2022-09-26	2024-04-21	发明	原始取得	无
79	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	中国台湾	I 808023	2022-10-14	2023-07-01	发明	原始取得	无

80	杭州众硅	晶圆寻位方法	中国台湾	I 816576	2022-10-14	2023-09-21	发明	原始取得	无
81	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 818688	2022-08-23	2023-10-11	发明	原始取得	无
82	杭州众硅	晶圆驱动机构	中国台湾	I 817770	2022-10-14	2023-10-01	发明	原始取得	无
83	杭州众硅	站立式晶圆卡座	中国台湾	I 857368	2022-10-17	2024-10-01	发明	原始取得	无
84	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	中国台湾	I 820968	2022-10-17	2023-11-01	发明	原始取得	无
85	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	中国台湾	I 834448	2022-12-23	2024-03-01	发明	原始取得	无
86	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法 & 检测系统	中国台湾	I 829393	2022-10-17	2024-01-11	发明	原始取得	无
87	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、其装载方法及使用方法	中国台湾	I 823623	2022-10-17	2023-11-21	发明	原始取得	无
88	杭州众硅	晶圆清洁干燥模块状态检测方法、装置及平坦化设备	中国台湾	I 874908	2023-02-09	2025-03-01	发明	原始取得	无
89	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	中国台湾	I 838117	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无
90	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆传输方法	中国台湾	I 896992	2023-06-29	2025-09-11	发明	原始取得	无
91	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225666	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
92	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225667	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
93	杭州众硅	涡流终点检测装置及方法	中国台湾	I 854476	2023-02-07	2024-09-01	发明	原始取得	无
94	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	中国台湾	I 838116	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无
95	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无
96	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械研磨系统	中国台湾	I 869019	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无

97	杭州众硅	研磨垫再利用加工装置	中国台湾	I 899689	2023-11-03	2025-10-01	发明	原始取得	无
98	杭州众硅	一种导电型研磨头固定装置及导电型研磨头系统	中国台湾	I 866602	2023-11-10	2024-12-11	发明	原始取得	无
99	杭州众硅	导电吸附膜及抛光头	中国台湾	I 845382	2023-07-21	2024-06-11	发明	原始取得	无
100	杭州众硅	一种用于 CMP 设备研磨垫沟槽修整的方法	中国台湾	I 869022	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
101	杭州众硅	晶圆研磨系统及晶圆处理方法	中国台湾	I 886965	2024-05-20	2025-06-11	发明	原始取得	无
102	杭州众硅	可调式晶圆装卸台	中国台湾	I 896134	2024-05-20	2025-09-01	发明	原始取得	无
103	杭州众硅	用于改善边缘研磨均匀性的研磨装置	中国台湾	I 900014	2024-05-21	2025-10-01	发明	原始取得	无
104	杭州众硅	一种用于 CMP 清洁干燥模组的检测装置及检测方法	中国台湾	I 886962	2024-05-17	2025-06-11	发明	原始取得	无
105	杭州众硅	一种化学机械研磨及平坦化系统	中国台湾	I 891372	2024-05-17	2025-07-21	发明	原始取得	无
106	杭州众硅	一种电化学机械研磨及平坦化装置	中国台湾	I 896171	2024-06-18	2025-09-01	发明	原始取得	无
107	杭州众硅	一种研磨头清洗方法及清洗装置	中国台湾	I 863868	2024-05-17	2024-11-21	发明	原始取得	无
108	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 234468	2024-05-22	2024-10-21	外观设计	原始取得	无
109	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 240377	2024-11-15	2025-09-11	外观设计	原始取得	无
110	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 241113	2024-11-15	2025-10-21	外观设计	原始取得	无
111	杭州众硅	化学机械抛光的在线监测装置	中国台湾	I 862202	2023-10-03	2024-11-11	发明	原始取得	无
112	杭州众硅	晶圆研磨系统	中国台湾	I 892653	2024-05-20	2025-08-01	发明	原始取得	无
113	杭州众硅	晶圆抛光系统、安装方法及使用方法	日本	7736360	2023-01-09	2025-09-01	发明	原始取得	无

114	杭州众硅	立式晶圆盒	日本	3253988	2022-12-30	2025-12-04	实用新型	原始取得	无
-----	------	-------	----	---------	------------	------------	------	------	---

## 5、域名

序号	网站名称	许可证号	注册日期	到期日期
1	sizonetech.com	浙 ICP 备 18044783 号-2	2018/11	2032/11

### （三）企业申报的表外资产的类型、数量

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，除上述申报的无形资产外，企业申报的评估范围内无其他表外资产。

### （四）引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 27 日出具的标准无保留意见的《审计报告》（普华永道中天特审字(2026)第 0065 号）审计结果，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

## 四、价值类型

依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

## 五、评估基准日

本项目资产评估的基准日是 2025 年 12 月 31 日。

委托人为本次资产评估工作拟订了时间表，为了加快整体工作的进程，同时考虑到评估基准日尽可能与本次评估目的的实现日接近的需要和完成评估工作的实际可能，经与各方协商，确定评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。

## 六、评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据，及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

### （一）经济行为依据

1、《中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

### （二）法律法规依据

1、《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

2、《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订）；

3、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

4、《中华人民共和国企业所得税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；

5、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）；

6、《中华人民共和国著作权法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2020年11月11日通过）；

7、《中华人民共和国专利法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过）；

8、《中华人民共和国商标法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；

9、《中华人民共和国增值税法》（2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）；

10、财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

11、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）；

12、《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年2月17日中国证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过，根据2025年2月19日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）；

13、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会令第73号，2020年2月14日修订）；

14、其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

### （三）评估准则依据

1、《资产评估基本准则》（财资〔2017〕43号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30号）；

3、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协〔2018〕36号）；

4、《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协〔2019〕35号）；

5、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35号）；

6、《资产评估执业准则——企业价值》（中评协〔2018〕38号）；

7、《资产评估执业准则——机器设备》（中评协〔2017〕39号）；

8、《资产评估执业准则——无形资产》（中评协〔2017〕37号）；

9、《资产评估执业准则——知识产权》（中评协〔2023〕14号）；

10、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33号）；

11、《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协〔2018〕37号）；

12、《资产评估执业准则——利用专家工作及相關报告》（中评协[2017]35号）；

13、《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；

14、《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；

15、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48号）；

16、《专利资产评估指导意见》（中评协[2017]49号）；

17、《著作权资产评估指导意见》（中评协[2017]50号）；

18、《商标资产评估指导意见》（中评协[2017]51号）；

19、其他与评估工作相关的准则等。

#### （四）资产权属依据

1、重要资产购置合同或凭证；

2、权属证书（软件著作权证书、专利证书等）；

3、其他参考资料。

#### （五）取价依据

1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》（普华永道中天特审字(2026)第0065号）；

2、《2025机电产品报价手册》（机械工业信息研究院）；

3、中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2025年12月20日公布的贷款市场报价利率；

4、委托人和被评估单位依法提供的审计报告、财务会计报表、资产申报明细表和和有关资产初始计量资料；

5、其他参考资料。

#### （六）其它参考资料

1、Wind金融数据终端；

- 2、《投资估价》（[美]Damodaran 著，[加]林谦译，清华大学出版社）；
- 3、《价值评估：公司价值的衡量与管理（第3版）》（[美]Copeland, T.等著，郝绍伦，谢关平译，电子工业出版社）；
- 4、《资产评估常用数据与参数手册》（机械工业出版社2011版）；
- 5、《企业会计准则——基本准则》（财政部令33号，财政部于2006年2月15日颁布，2014年7月修订版）及《企业会计准则第1号-存货》等41项具体准则；
- 6、《资产评估专家指引第8号——资产评估中的核查验证》（中评协[2019]39号）；
- 7、其他参考资料。

## 七、评估方法

### （一）评估方法简介

依据《资产评估执业准则——企业价值》（中评协[2018]38号）和《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协[2019]35号）的规定，执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、评估方法的适用条件、评估方法应用所依据数据的质量和数量等情况，分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当结合企业性质、资产规模、历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集

到的可比企业数量，考虑市场法的适用性。

企业价值评估中的资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

## （二）评估方法选择

本次评估目的是中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司股权。

资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估。

国外半导体设备行业经过多年发展，市场集中度高、盈利模式成熟且稳定，龙头企业已形成较为稳定的现金流。而鉴于中国大陆半导体设备尤其是 CMP（化学机械抛光设备）公司业务起步较晚，成熟度远低于国外，当前全球 CMP 行业被美国应用材料、日本荏原主导，两者市占率 8 成以上。

在国外对半导体核心技术封锁的背景下，被评估单位成立时间不长，部分产品仍处于客户验证阶段。此外叠加近年来下游半导体行业周期性的影响，难以对公司在可预见年限内预测其收益与风险水平。因此，本次不适宜采用收益法评估。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，结合本次评估被评估单位的特殊性，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用交易案例比较法；同时考虑到与被评估单位处于同一行业，产品类型、业务结构、主要经营模式相类似的上市公司数量较多，可比公司股价及经营和财务数据相关信息公开，具备资料的收集条件，故本次评估选择采用可比上市公司

比较法。

综上，本次评估确定采用资产基础法、市场法进行评估。

### （三）资产基础法

资产基础法，是指以被评估单位或经营体评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值的方法。

各类资产及负债的评估方法如下：

#### 1、流动资产

（1）货币资金：包括银行存款和其他货币资金

##### 1) 银行存款

对银行存款人民币账户进行了函证复核，以证明银行存款的真实存在，同时检查有无未入账的银行款项，以及评估基准日后的进账情况。对外币账户，以核实后的基准日外币存款账户金额乘以外汇汇率确认评估值。外汇汇率以基准日中国外汇交易中心公布的相应外币结算价汇率为准。银行存款以核实后账面值确定评估值。

##### 2) 其他货币资金

其他货币资金为 ETC 信用保证金。评估人员核对了账簿记录、查阅了客户交易月报及相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符，所以本次评估按清查核实后账面值确认评估值。

#### （2）交易性金融资产

交易性金融资产主要为理财产品，评估人员取得理财产品的购买合同，抽查了部分原始凭证等相关资料，以证明银行理财产品真实存在。对银行理财产品以基准日核实后的持仓份额乘每股净值确定评估值。

### （3）应收类账款

对应收类账款的评估，评估人员在对应收类账款核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，应收类账款采用个别认定及组合计提的方法评估风险损失。对关联方的往来款项，评估风险坏账损失的风险为 0；对于组合计提部分款项，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率，计算预期信用损失。

按以上标准，确定评估风险损失，以应收账款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

### （4）应收票据

对应收票据的评估，评估人员核查时，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅核对票据票面金额、发生时间、业务内容及票面利率等与账务记录的一致性，以证实应收票据的真实性、完整性，核实结果账、表、单金额相符。经核实应收票据真实，金额准确，未计利息，以核实后账面值确定评估值。

### （5）预付账款

对预付账款的评估，评估人员在对预付款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，未发现供货单位有破产、撤销或不能按合同规定按时提供货物或劳务等情况，以核实后的账面值作为评估值。

### （6）存货

纳入本次评估范围内的存货包含原材料、委托加工物资、产成品、在产品及发出商品。

#### 1) 原材料

原材料因耗用量大，周转速度较快，且主要为基准日近期采购，账面价值接近基准日市价，故按账面确定评估值。部分原材料库龄较长，已计提存货跌价准备，本次评估按照现行市价确认评估值。

## 2) 委托加工物资

委托加工物资主要为基准日近期委托，账面价值接近基准日市价，故按账面确定评估值。部分委托加工物资时间较长，已计提委托加工物资跌价准备，本次评估按照现行市价确认评估值。

## 3) 产成品

产成品按实际成本记账，主要为各类自制模组等，后续主要去向为研发领用。产成品成本组成内容为生产领用的材料、辅助材料，分摊的制造费用和人工费用等，由于生产周期较短，成本升降变化不大，成本结转及时完整，故按核实后的账面价值确认评估值。

## 4) 在产品

在产品按实际成本记账，其成本组成内容为生产领用的材料、辅助材料，分摊的制造费用和人工费用等，主要为各类模组及设备半成品。

清查时，评估人员查阅了相关账簿记录和原始凭单，以确认在产品的真实存在及所有权归属。再次，对在产品采取核实采购发票、入库单、出库单、材料及成本核算账簿等账务记录，来判断在产品的真实性和核算的准确性。

对于正常流转的在产品，由于生产周期较短，成本升降变化不大，成本结转及时完整，故按核实后的账面价值确认评估值。

## 5) 发出商品

发出商品主要为发出的 CMP 设备。经查企业产品均为正常销售，在清查核实的基础上评估人员对企业提供的资料分析，对于发出商品以其完全成本为基础，采用市场价格确定评估值。

评估价值=实际数量×不含税售价×(1-产品销售税金及附加费率-销

售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×(1-所得税率)×r)-后续投入成本

a.不含税售价：不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的；

b.产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算交纳的城市建设税、教育附加、印花税等与产品销售相关的税金与销售收入的比例；

c.销售费用率是按各项销售费用与销售收入的比例平均计算；

d.营业利润率：考虑到被评估单位仍处于亏损，本次按行业营业利润率计算；

e.所得税率按企业现实执行的税率；

f.r为一定的率，由于发出商品已销售，根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险r；

g.后续投入成本主要设备调试期至验收前的料工费投入成本。

## （7）其他流动资产

其他流动资产为待抵扣进项税。评估人员在对其他流动资产核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额，以核实后账面值作为评估值。

## 2、非流动资产

### （1）长期股权投资

对长期股权投资，首先对长期投资形成的原因、账面值和实际状况等进行了取证核实，并查阅了投资协议、股东会决议、章程和有关会计记录等，以确定长期投资的真实性和完整性。

对于全资及控股子公司，对被投资单位评估基准日的整体情况进行了评估。本次评估范围内的被投资单位，成立时间较短，对被投资单位分别进行分析，根据实缴情况、所处阶段、经营情况分别进行评估。

## （2）固定资产

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用市场法和重置成本法进行评估。

### 1) 重置成本法

评估值 = 重置全价 × 成新率

#### ① 重置全价的确定

设备的重置全价，在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、运杂费、安装调试费和资金成本等），综合确定：

重置全价 = 设备购置费（不含税）+ 运杂费（不含税）+ 安装调试费（不含税）+ 其他费用（不含税）+ 资金成本

#### A. 机器设备重置全价

##### a. 购置价

主要通过向生产厂家或贸易公司询价或参照《2025 机电产品价格信息查询系统》等价格资料，以及参考近期同类设备的合同价格确定。对少数未能查询到购置价的设备，采用同年代、同类别设备的价格变动率推算确定购置价。

对与国产设备技术水平近似的进口设备的现价，根据替代原则，即查找国内功能及技术参数相当的替代设备，查询类似国产设备的恰当的市场交易价格，以确定其购置价。

根据国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）文件规定，符合增值税抵扣条件的机器设备重置成本应该扣除相应的增值税。本次评估对于设备购置价、运杂费、安装费、基础费按其对应的增值税率测算可抵扣

进项税额（下同）。故本次评估机器设备的购置价采用不含税价。

#### b.运杂费

以含税购置价为基础，根据生产厂家与设备所在地间发生的装卸、运输、保管、保险及其他相关费用，按不同运杂费率计取，同时，按国家税收优惠政策扣减应抵扣的增值税。购置价格中包含运输费用的不再计取运杂费。

#### c.安装调试费

根据设备的特点、重量、安装难易程度，以含税购置价为基础，按不同安装费率计取，并扣除可抵扣的增值税。

对小型、无须安装的设备 and 购置价中包含安装调试费的，不再计取安装调试费。

#### d.其他费用

其他费用包括管理费、可行性研究报告及评估费、设计费、工程监理费等，是依据该设备所在地建设工程其他费用标准，结合本身设备特点进行计算。本次评估范围内设备为航空维修类机器设备，设备技术要求高，但无需大型安装工程，本次评估无需计算其他费用。

#### e.资金成本

资金成本按照被评估企业的合理建设工期，参照评估基准日中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款基准利率，以设备购置价、运杂费、安装工程费、前期及其他费用等费用总和为基数按照资金均匀投入计取。资金成本计算公式如下：

资金成本=（设备购置价+运杂费+基础费+安装工程费+前期及其他费用）×合理建设工期×贷款基准利率×1/2

#### B.车辆重置全价

根据当地汽车销售信息等近期车辆市场价格资料，确定运输车辆的现行含税购置价，在此基础上根据《中华人民共和国车辆购置税法》

规定计入车辆购置税、新车上户牌照手续费等，对于符合增值税抵扣条件的企业，其车辆重置全价为：

重置全价 = 购置价 + 车辆购置税 + 牌照等杂费 - 可抵扣的增值税

a. 车辆购置价：根据车辆市场信息及《太平洋汽车网汽车报价库》，《易车网》等近期车辆市场价格资料，参照车辆所在地同类车型最新交易的市场价格确定本次评估车辆购置价格；对购置时间较长，现不能查到原型号规格的车辆购置价格时参考相类似、同排量车辆价格作为评估车辆购置价参考价格。

b. 车辆购置税：根据《中华人民共和国车辆购置税法》的有关规定：车辆购置税应纳税额 = 计税价格 × 10%。故：购置附加税 = 购置价 × 10%。

c. 新车上户牌照手续费等：根据车辆所在地该类费用的内容及金额确定。

### C. 电子设备重置全价

评估范围内的电子设备价值量较小，不需要安装（或安装由销售商负责）以及运输费用较低，参照现行市场购置的价格确定。根据国家发布的税收优惠政策，企业购入的符合规定的固定资产所支付的增值税进项税可以抵扣（包括进口设备进口环节增值税），本次项目根据国家税收优惠政策采用不含税价格确定购置价。

重置全价计算公式：

重置全价 = 设备购置费（不含税）

#### ② 成新率的确定

##### A. 机器设备及电子设备成新率：

按照设备的经济使用寿命、现场勘察情况预计设备尚可使用年限，并进而计算其成新率。其公式如下：

成新率 = 尚可使用年限 / （实际已使用年限 + 尚可使用年限） × 100%

对价值量较小的一般设备则采用直接年限法确定其成新率。

## B. 车辆成新率

对于运输车辆，根据《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号）的有关规定和车辆的平均经济使用年限，按以下方法确定成新率后取其较小者为最终成新率，即：

$$\text{使用年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} / \text{规定或经济使用年限}) \times 100\%$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} / \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

$$\text{成新率} = \text{Min}(\text{使用年限成新率}, \text{行驶里程成新率})$$

同时对待估车辆进行必要的勘察鉴定，若勘察鉴定结果与按上述方法确定的成新率相差较大，则进行适当的调整，若两者结果相当，则不进行调整。

### ③ 评估值的确定

$$\text{评估值} = \text{重置全价} \times \text{成新率}$$

### （3）使用权资产

对于使用权资产的评估，评估人员查阅了相关的租赁合同、核对明细账与总账、报表余额是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录。在核实无误的基础上，按照基准日尚存在的剩余资产或权益作为评估值。

### （4）无形资产

#### 1) 专利、软件著作权

##### A. 评估方法选择

专利及软件著作权常用评估方法包括收益法、市场法和成本法。

市场法主要通过活跃在专利及软件著作权市场或资本市场上选择相同或相似的专利及软件著作权作为参照物，同时针对各种价值影响因素，如专利及软件著作权的功能进行类比，将被评估专利及软件著作权与参照物进行价格差异的比较调整，分析各项调整结果，从而确定专利及软件著作权的价值。使用市场法评估专利及软件著作权的必要前提包

括：市场数据公开化程度较高；存在可比的专利技术；参照物的价值影响因素明确且能够量化等。由于我国专利及软件著作权市场交易目前尚处于初级阶段，类似专利及软件著作权的公平交易数据采集较为困难，市场法在本次评估应用中可操作性较差。

成本法通过分析重新开发出被评估专利及软件著作权所需花费的物化劳动来确定评估价值。企业合法取得专利及软件著作权过程中需支出的费用一般包括人工费用、调研咨询费、资产购置费、实验测试费、期间费用等，专利及软件著作权技术赋予企业的真实价值，与企业实际所支出费用之间通常对应关系较弱，故成本法评估通常适用于经营与收益之间不存在较稳定的对应关系，相应产品或服务价格市场性较弱的专利及软件著作权评估。本次评估的专利及软件著作权是被评估单位多年研究、实验的成果，在本次评估过程中，被评估单位向评估人员提供了其历史成本投入情况，因此可以采用成本法进行评估。

收益法以被评估专利及软件著作权未来所能创造的收益现值来确定评估价值，对专利及软件著作权等无形资产而言，其价值主要来源于直接变卖该等无形资产的收益，或者通过使用该等无形资产为其产品或服务注入技术加成而实现的超额收益。本次评估，考虑到国外半导体设备行业经过多年发展，市场集中度高、盈利模式成熟且稳定，龙头企业已形成较为稳定的现金流。

鉴于中国大陆半导体设备尤其是 CMP（化学机械抛光设备）公司业务起步较晚，成熟度远低于国外，当前全球 CMP 行业被美国应用材料、日本荏原主导，两者市占率 8 成以上。在国外对半导体核心技术封锁的背景下，被评估单位成立时间不长，部分产品仍处于客户验证阶段。此外叠加近年来下游半导体行业周期性的影响，难以对公司在可预见年限内预测其收益与风险水平。因此，本次不适宜采用收益法评估。

## B. 成本法概述

专利及软件著作权成本主要由其研制中投入的物化劳动，如消耗的专项原辅材料等资源、占用的仪器、设备和场所以及设计服务等费用；及其投入的相关劳动费用，如研制开发人员的工资、劳务和福利费用等费用所构成。专利及软件著作权所占用的研发费用至少应达到同行业的平均收益率才能够体现其使用价值。专利及软件著作权因更新换代等因素被新的技术代替，将导致其技术的技术性贬值。

专利及软件著作权的评估模型为

$$A=B \times (1-Q)$$

A: 专利及软件著作权评估值

B: 研发费用与研发费用投资回报之和

Q: 技术的贬值率

Q=技术已使用年限/（技术已使用年限+预计尚可使用时间）

## 2) 商标

纳入本次评估范围内的账外无形资产商标权，申请注册相对简单，均对企业收入贡献不大，不直接产生收益故采用成本法评估，依据商标权无形资产形成过程中所需投入的各种成本费用的重置价值确认商标权价值，其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2+C_3$$

式中：P: 评估值

C<sub>1</sub>: 设计成本

C<sub>2</sub>: 注册费用（包括注册代理费）及其他成本

C<sub>3</sub>: 维护使用成本

## 3) 域名

经核实域名注册过程中的合理支出，按其合理支出确定评估值。其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2$$

式中：

P：评估值

C<sub>1</sub>：注册域名 1 年要花费的注册费用

C<sub>2</sub>：域名注册 1 年后到终止日所花费的费用

#### 4) 外购软件

对于外购软件，评估人员查阅相关的证明资料并查阅了原始合同，了解原始入账价值的构成，摊销的方法和期限，查阅了原始合同。经核实表明账、表金额相符。通过向软件供应商询价或网络查询其现行不含税价格确定评估值。

#### (5) 长期待摊费用

对于长期待摊费用，评估人员抽查了原始入账合同、收据等核实其核算内容的真实性和完整性。对于在未来受益期内仍可享受相应权益或资产长期待摊费用，按尚存受益期应分摊的余额确定评估值。

#### (6) 其他非流动资产

其他非流动资产为大额存单及利息，评估人员在对其他非流动资产核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额，以核实后账面值作为评估值。

### 3、负债

检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

#### (四) 市场法

##### 1、概述

根据《资产评估执业准则—企业价值》，企业价值评估中的市场法，是指将被评估单位与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定被评估单位价值的评估方法。

### （1）市场法的应用前提

运用市场法评估股东全部权益价值需要满足如下基本前提条件：

1) 要有一个充分发展、活跃的、公开的市场，在这个市场上成交价格基本上反映市场买卖双方的行情，因此可以排除个别交易的偶然性。

2) 在这个公开市场上要有可比的企业及其交易活动，且交易活动应能较好反映股东全部权益价值的趋势。企业及其交易的可比性是指选择的可比企业及其交易活动是在近期公开市场上已经发生过的，且与被评估的目标企业及其即将发生的业务活动相似。

3) 参照物与被评估单位的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

### （2）市场法选择的理由和依据

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

被评估单位主营业务为高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备的研发、制造和销售。由于该行业具有一定技术壁垒，导致行业内同行业公司相对较少且交易活跃度较低、交易案例数量有限，近年来公开披露的已完成或正在进行中的交易案例较少，交易细节及被并购企业的详细信息难以收集掌握，因此本次未采用交易案例比较法进行估算。

当前证券市场存在较多经营正常稳定、主营业务及产品与被评估单位相似的上市公司，故综合考量后，本次采用上市公司比较法进行估算。

## 2、评估思路

在充分了解并掌握被评估单位企业性质、业务类型、经营模式、发展阶段、企业规模、财务状况等基本情况的基础上，按以下思路开展市场法评估：

### （1）选择可比企业

搜集可比企业信息，通过比较分析筛选出适当数量的可比企业。本次采用上市公司比较法，筛选原则包括：属于同一行业，或者受相同经济因素影响；交易市场相同或可比；有一定时间的上市交易历史，并且近期股票价格没有异动；业务结构、经营模式等方面相近或相似等。

### （2）计算价值比率

根据资本市场数据，对被评估单位与可比公司所处行业的价值影响因素（价值因子）进行线性回归分析，并结合行业及企业特点，选择相对合适的价值比率。

根据可比企业于评估基准日的市值（比准市值）及价值因子，计算可比企业价值比率。

### （3）计算评估价值

根据被评估单位价值比率、价值因子，同时考虑价值比率数据口径，对非经营性资产（负债）、流动性因素进行调整，得出被评估单位股东全部权益价值。

## 3、评估模型

本次评估采用上市公司比较法，基本模型为：

$$E=EV+C-D-M$$

E：股东全部权益价值；

C：现金等价物

D：付息债务

M：少数股东权益

其中：

---

$EV = \text{可比公司比准价值比率} \times \text{被评估单价值因子}$

## 八、评估程序实施过程和情况

整个评估工作分五个阶段进行：

### （一）评估准备阶段

1、委托人召集本项目各中介协调会，有关各方就本次评估的目的、评估基准日、评估范围等问题协商一致，并制订出本次资产评估工作计划。

2、配合企业进行资产清查、填报资产评估申报明细表等工作。评估项目组人员对委估资产进行了详细了解，布置资产评估工作，协助企业进行委估资产申报工作，收集资产评估所需文件资料。

### （二）现场评估阶段

项目组现场评估阶段的主要工作如下：

1、听取委托人及被评估单位有关人员介绍企业总体情况和委估资产的历史及现状，了解企业的财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况。

2、对企业提供的资产评估申报明细表进行审核、鉴别，并与企业有关财务记录数据进行核对，对发现的问题协同企业做出调整。

3、根据资产评估申报明细表，对固定资产、存货以抽查的形式进行盘点。

4、查阅收集委估资产的产权证明文件。

5、根据委估资产的实际状况和特点，确定各类资产的具体评估方法。

6、根据资产评估申报明细表，对主要设备，查阅了技术资料、决算资料和竣工验收资料；对通用设备，主要通过市场调研和查询有关资料，收集价格资料。

7、对企业提供的权属资料进行查验。

8、对评估范围内的资产及负债，在核实的基础上做出初步评估测算。

9、通过对企业现场勘察、参观、以访谈的形式，对被评估企业的经营性资产的现状、规模条件和能力以及历史经营状况、经营收入、成本、期间费用及其构成等的状况进行调查复核。对影响评估作价的主营业务的业务量、业务收入和相关的成本费用等进行了详细调查，查阅了相关的重要合同协议等。在资产核实和尽职调查的基础上，收集相关行业的宏观行业资料以及可比公司的财务资料和市场信息等。

### （三）评估汇总阶段

对各类资产及负债评估的初步结果进行分析汇总，对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

### （四）提交报告阶段

在上述工作基础上，起草初步资产评估报告，初步审核后与委托人就评估结果交换意见。在独立分析相关意见后，按评估机构内部资产评估报告审核制度和程序进行修正调整，最后出具正式资产评估报告。

### （五）整理归集阶段

对评估程序实施过程中的档案进行整理归集。

## 九、评估假设

本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：

### （一）一般假设

#### 1、交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得

以进行的一个最基本的前提假设。

## 2、公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

## 3、企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。对于企业的各类经营性资产而言，能够按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用。

## （二）特殊假设

1、本次评估假设国家政策、经济环境、房地产本身的状况等因素不发生重大变化，委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整，本次评估不考虑通货膨胀因素的影响；

2、企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

3、被评估单位在未来经营期内管理团队尽职尽责，核心人员保持稳定而不发生重大变化，并继续按照现有的经营管理模式持续经营；

4、本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；

5、本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

- 6、本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响；
- 7、可比企业与被评估单位在价值影响因素方面相同或者相似；
- 8、可比企业与被评估单位均能够按交易时公开披露的经营模式、业务架构、资本结构持续经营；
- 9、可比上市公司所涉及的交易均为有序市场环境下的公平交易，交易对价公允有效。可比上市公司信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏；
- 10、评估人员仅基于公开披露的可比企业相关信息选择对比维度及指标，不考虑其他非公开事项对被评估单位价值的影响。

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

## 十、评估结论

我们根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、科学、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用资产基础法、市场法进行评估，对杭州众硅电子科技有限公司纳入评估范围的资产实施了实地勘察、市场调查、询证和评估计算，得出如下结论：

### （一）资产基础法评估结论

资产账面价值 104,275.53 万元，评估值 139,641.94 万元，评估增值 35,366.41 万元，增值率 33.92%。

负债账面价值 26,755.27 万元，评估值 26,755.27 万元，无评估增减值。

所有者权益账面价值 77,520.26 万元，评估值 112,886.67 万元，评估增值 35,366.41 万元，增值率 45.62%。详见下表：

#### 资产评估结果汇总表

评估基准日：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
<b>流动资产</b>	<b>98,014.37</b>	<b>101,069.60</b>	<b>3,055.23</b>	<b>3.12</b>
<b>非流动资产</b>	<b>6,261.16</b>	<b>38,572.34</b>	<b>32,311.18</b>	<b>516.06</b>
其中：长期股权投资	500.00	500.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,437.87	1,872.78	434.92	30.25
在建工程	-	-	-	-
无形资产	29.09	31,905.36	31,876.26	109,562.39
其中：土地使用权	-	-	-	-
其他非流动资产	3,059.67	3,059.67	-	-
<b>资产总计</b>	<b>104,275.53</b>	<b>139,641.94</b>	<b>35,366.41</b>	<b>33.92</b>
流动负债	25,537.84	25,537.84	-	-
非流动负债	1,217.44	1,217.44	-	-
<b>负债总计</b>	<b>26,755.27</b>	<b>26,755.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>77,520.26</b>	<b>112,886.67</b>	<b>35,366.41</b>	<b>45.62</b>

评估结果与账面所有者权益比较增值 35,366.41 万元，增值率 45.62%，主要原因为存货、无形资产、固定资产增值，具体如下：

1、存货账面值为 53,898.75 万元，评估值为 56,953.98 万元，评估增值 3,055.23 万元，增值率 5.67%，增值主要原因是由于产品市场行情较好，发出商品评估值中考虑了部分利润所致。

2、无形资产账面值为 29.09 万元，评估值 31,905.36 万元，评估增值 31,876.26 万元，增值率 109,562.39%，增值原因主要为账外的专利及软著等资产具有使用价值。

3、固定资产账面值为 1,437.87 万元，评估值为 1,872.78 万元，评估增值 434.92 万元，增值率 30.25%，增值原因主要为：本次评估采用的经济使用年限和企业采用的会计折旧年限不同，故造成评估增值。

## （二）市场法评估结论

采用市场法估值，合并报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益账面值 75,280.39 万元，评估值 250,140.00 万元，评估增值 174,859.61 万元，增值率 232.28%。

被评估单位在行业中技术领先，具有技术密集、高技能人才密集的特点，市场法评估中结合评估对象行业发展、收入类型、市场需求等因素变化对未来获利能力的影响，评估结果包含了资源优势、技术优势、管理优势等账外的无形资产，故导致评估结果增值。

### （三）评估结果的差异分析

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 250,140.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 112,886.67 万元，高 137,253.33 万元，差异率 121.59%。两种评估方法差异的原因主要是：

1、资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；

2、上市公司比较法反映了在正常公平交易的条件下公开市场对于评估对象价值的测算，通过选取合适价值比率，模拟估算出评估对象的公开市场交易性的市场价值。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

### （四）评估结果的选取

杭州众硅电子科技有限公司是一家高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备公司，为半导体行业及其他高科技领域提供优质技术和高效服务。公司的使命是促进全球芯片生产制造工艺技术的发展，集聚了国内外高端人才，拥有强大的专业技术研发团队，旨在为全世界芯片生产厂商提供一流的化学机械平坦化抛光（CMP）设备，为他们提供先进技术和高效的服务，帮助芯片生产厂商解决技术难题。

公司主要从事高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备及周边产品的研发与生产，主要产品包括众硅 TTAIS<sup>®</sup>150CMP、TTAIS<sup>®</sup>200CMP、众硅 TTAIS<sup>®</sup>300 CMP、单模组 CMP 系统、抛光液供液系统（SDS）、ECMP 等产品，以及相关产品的技术服务。

公司的核心竞争力如下：

### 1、聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，在 CMP 后清洗技术、终点检测控制技术、APC 智能控制技术、CMP 工艺应用等核心领域实现重大创新突破并完全自主可控。公司是国内少数能够自主创新制造 12 英寸 CMP 设备的企业，其设备采用 6 抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备 4 盘或 3 盘的架构模式。6 抛光盘的设计不仅可同时支持 3 盘工艺或 2 盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅大幅降低设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了公司在 CMP 设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

### 2、汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

公司创始团队来自浙江大学、南京大学等国内外知名高校，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，公司组建了一支兼具国际视野与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

### 3、公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的

技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，公司自主研发并生产的 CMP 设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

#### 4、设备核心模块自研实现自主可控

CMP 设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。公司已实现了诸如抛光头、旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研大幅降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产 CMP 设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

由于杭州众硅电子科技有限公司主要产品为高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备，市场对于该类企业更多的是看重其研发和未来的发展。市场法参考与被评估单位相似的可比公司近期交易价格，通过分析并调整可比公司与被评估单位各自特点及差异，确定被评估单位评估值，从市场价格的角度测算被评估单位的整体市场价值。因此市场法能够从行业的发展前景、行业特性等方面反映公司的价值。

通过以上分析，我们选用市场法作为本次被评估单位的定价方法。由此得到杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在基准日时点的市场价值为 250,140.00 万元。

## 十一、特别事项说明

### （一）引用其他机构出具报告结论的情况

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计结果。评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

### （二）产权瑕疵事项

截至评估基准日，评估人员发现被评估单位存在仍在申请中的专利及商标，后续可能存在被驳回的风险，提请报告使用者注意。

### （三）未决事项、法律纠纷等不确定因素

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，被评估单位及其子公司不存在重大未决事项、法律纠纷等不确定因素。

### （四）抵（质）押及其或有负债、或有资产的性质、金额及其对应资产负债情况

截至评估基准日，被评估单位及其子公司不存在对外担保情况。

### （五）重大期后事项

截至报告出具日，被评估单位及其子公司新增 9 项已注册专利，提请报告使用人注意。

### （六）其他需要说明的事项

1、截至评估基准日，被评估单位及其子公司存在以下租赁事项：

序号	承租人	出租人	产权证号	租赁地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租金 (元/ 月/平 方米)	租赁期限
1	杭州众硅	浙江青山湖科研创新基地投	浙 (2019) 临安区不	杭州市临安区青山湖街道大园路 1155 号创业广场 A 座 13、14、	2,995.86	商业办公	30.00	2025-01-16 至

序号	承租人	出租人	产权证号	租赁地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租金 (元/月/平方米)	租赁期限
		资有限公司	动产权第0015440号	15楼				2026-01-15
2	杭州众硅	浙江钜典药业有限公司	浙(2017)临安市不动产权第0002771号	杭州市临安市青山湖街道创业街88号1幢2层北	1,755.00	厂房及仓储	38.00	2023-05-01至2026-04-30
3				杭州市临安市青山湖街道创业街88号1幢1层北	1,895.40	厂房及仓储	38.00	2022-10-17至2026-04-30
4				杭州市临安市青山湖街道创业街88号1幢1层及其夹层	1,980.00	厂房和办公用房	30.00	2023-07-01至2026-04-30
5	杭州众硅	浙江大学科技园发展有限公司	杭房权证西移字第07546327号	杭州市西湖区西溪路525号浙江大学国家大学科技园西溪园区A楼东区218-219室	304.88	办公	100.50	2025-09-01至2026-08-31
6	上海众硅	上海桥合置业有限公司	沪(2022)浦字不动产权第023918号	上海市浦东新区新金桥路36、56号的上海国际财富中心1幢南塔1805室(15层)	415.07	办公	145.50	2024-12-01至2026-11-30
7	杭州众硅	卓悦商服(广州)产业服务有限公司	粤(2024)广州市不动产权第10067420号	广州市增城区宁西街创新大道14号101第8层802单元	132.89	办公	13.86	2025-12-01至2028-11-30

被评估单位经营场所为租赁，租金水平及租赁情况正常。假设现有租赁状况不变的情况下，被评估单位可继续以租赁方式和合理的租赁价格取得经营场所的使用权持续经营。

2、本报告中所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成，提请报告使用者注意。

3、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所

对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人及被评估单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。

4、本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

5、评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。

6、在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；

（2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；

（3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

## 十二、评估报告使用限制说明

1、本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是反映被评估单位在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

2、本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

3、本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

4、委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

5、除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

6、未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

7、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

8、根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自评估基准日2025年12月31日起至2026年12月30日内使用有效。

### 十三、评估报告日

评估报告日为二〇二六年三月二十七日。

（此页无正文）



浙江中联资产评估有限公司

签字评估师：



签字评估师：



二〇二六年三月二十七日

# 杭州市财政局

杭财资备案（2025）28号

## 中联资产评估集团（浙江）有限公司 变更备案公告

中联资产评估集团（浙江）有限公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部第97号令）、《浙江省资产评估机构财政监督管理实施办法》（浙财企〔2017〕92号）的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

一、原中联资产评估集团（浙江）有限公司现变更为浙江中联资产评估有限公司。

二、原股东为中联资产评估集团有限公司、杭州联远管理咨询合伙企业（有限合伙）、邬崇国、骆丁辉、杨沈斌、樊立刚，现变更为周斌、杭州联远管理咨询合伙企业（有限合伙）、邬崇国、骆丁辉、杨沈斌、樊立刚。

相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。





统一社会信用代码  
91330000758074863F (1/2)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家  
企业信用信息公示系统”了解  
更多登记、备案、许可、监  
管信息

名称 浙江中联资产评估有限公司

注册资本 壹仟零陆拾捌万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2004年01月18日

法定代表人 邬崇国

住所 浙江省杭州市拱墅区米市巷街道湖墅南路260号6楼

经营范围 企业整体评估、房地产、机器设备、流动资产、无形资产的单项及资产评估咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2025年09月26日

从事证券服务业务资产评估机构名录 (截至2025年12月5日)

日期: 2025-12-05 来源: 证监会 [打印] [大] [中] [小] [分享] [收藏]

从事证券服务业务资产评估机构名录 (截至2025年12月5日)

191	中联资产评估集团(新疆)有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路天成广场18楼	0991-2306900
192	浙江中联资产评估有限公司	浙江省杭州市江干区钱潮路C18号铭鑫大厦13楼	0571-88372126
193	中联资产评估集团北京数据有限公司	北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层108-143	010-88000065
194	中联资产评估集团广西有限公司	广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2201-2206号	0771-5535507
195	中联资产评估集团河南有限公司	河南省郑州市郑东新区商都路5号B6栋中部LED光电大厦3楼	0371-55290869
196	中联资产评估集团山东有限公司	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场10号楼1302室	0531-88253986
197	中联资产评估集团四川有限公司	四川省中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元16层1608号	028-85578567
198	中联资产评估集团有限公司	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4	010-88000062
199	中联资产评估咨询(上海)有限公司	上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦505	0512-65162285
200	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内15层2180C室	010-51398652
201	中勤资产评估有限公司	北京市西城区金融大街33号通泰大厦C602	010-53669155
202	中全资产评估(北京)有限公司	北京市海淀区阜成路73号B座六层604号	010-68980040
203	中瑞国际房地产土地资产评估有限公司	北京市海淀区西直门北大街32号	010-66553366-823 3
204	中瑞世联资产评估集团有限公司	北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心写字楼A座1608室	010-66553366-830 5



# 中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号: 33190025

会员姓名: 李洪柱

证件号码: 330327\*\*\*\*\*8

所在机构: 浙江中联资产评估有限公司



年检情况: 2025 年通过

职业资格: 资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值

诚信铸就行业

本人印鉴:



签名:

李洪柱



(有效期至 2026-04-30 日止)



# 中国资产评估协会 见习执业会员证书

会员编号：33230240

会员姓名：周承起

证件号码：330802\*\*\*\*\*8

所在机构：浙江中联资产评估有限公司



年检情况：2025 年通过

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值

诚信铸就行业

本人印鉴：



签名：

周承起



(有效期至 2026-04-30 日止)

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及  
支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司

股东全部权益价值评估项目

资 产 评 估 说 明

浙联评报字[2026]第 64 号

浙江中联资产评估有限公司

二〇二六年三月二十七日



## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>关于评估说明使用范围的声明</b> .....	<b>109</b>
<b>第二部分</b>	<b>企业关于进行资产评估有关事项的说明</b> .....	<b>110</b>
<b>第三部分</b>	<b>资产清查核实情况说明</b> .....	<b>111</b>
一、	评估对象与评估范围说明 .....	111
二、	资产核实情况总体说明 .....	139
<b>第四部分</b>	<b>资产基础法评估说明</b> .....	<b>142</b>
一、	流动资产评估技术说明 .....	142
二、	长期股权投资评估技术说明 .....	149
三、	固定资产-设备类资产评估技术说明 .....	154
四、	使用权资产评估技术说明 .....	165
五、	无形资产-其他评估技术说明 .....	165
六、	长期待摊费用评估技术说明 .....	175
七、	其他非流动资产评估技术说明 .....	175
八、	负债评估技术说明 .....	175
<b>第五部分</b>	<b>市场法评估说明</b> .....	<b>180</b>
一、	评估假设 .....	180
二、	市场法简介 .....	181
三、	行业发展前景与经营分析 .....	184
四、	市场法评估过程 .....	205
<b>第六部分</b>	<b>评估结论及其分析</b> .....	<b>216</b>
一、	评估结论 .....	216
二、	评估结果的差异分析 .....	217
三、	评估结果的选取 .....	218
<b>企业关于进行资产评估有关事项的说明</b>		

## 第一部分 关于评估说明使用范围的声明

本资产评估说明，仅供评估主管机关、企业主管部门审查资产评估报告和相关监管部门检查评估机构工作之用，非法律、行政法规规定，材料的全部或部分内容不得提供给其它任何单位和个人，也不得见诸于公开媒体；任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用人。

浙江中联资产评估有限公司  
二〇二六年三月二十七日



## 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明

本评估说明该部分内容由委托人和被评估单位共同撰写，并由委托单位法定代表人和被评估单位法定代表人签字，加盖相应单位公章并签署日期。详细内容请见《企业关于进行资产评估有关事项的说明》。

### 第三部分 资产清查核实情况说明

#### 一、评估对象与评估范围说明

##### 评估对象与评估范围内容

评估对象为杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值。评估范围为杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债。

合并报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的资产总额为 102,212.56 万元，负债总额为 26,932.17 万元，净资产为 75,280.39 万元。其中，流动资产 96,359.75 万元，非流动资产 5,852.82 万元；流动负债 25,714.73 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

母公司报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的资产总额为 104,275.53 万元，负债总额为 26,755.27 万元，净资产为 77,520.26 万元。其中，流动资产 98,014.37 万元，非流动资产 6,261.16 万元；流动负债 25,537.84 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

上述资产与负债数据摘自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产负债表，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

本次评估范围中的主要资产为应收账款、存货、固定资产、无形资产等。其中，应收账款主要为应收下游客户设备销售货款；存货主要为生产 CMP 设备相关的原材料、委托加工物资、产成品、在产品、

发出商品等；固定资产主要为经营用固定资产，包括车辆、机器设备及电子设备；无形资产主要为外购软件及账面未记录的专利权、软件著作权、商标、域名等。

### 实物资产的分布情况及特点

纳入评估范围内的实物资产账面值 55,336.61 万元，占评估范围内总资产的 53.07%。这些资产具有以下特点：

1、实物资产主要分布在杭州众硅电子科技有限公司厂区，部分位于客户项目现场。

2、存货为原材料、委托加工物资、产成品、在产品及发出商品。存货分布比较集中，主要在杭州众硅电子科技有限公司及其子公司，截至基准日存货均有专人管理，现状较好。

3、设备类资产较为集中，均分布在被评估单位区域内。委估机器设备共 55 项，主要为膜厚仪、CDA 设备等。专用性高，有专人养护；运输设备共 2 项，为企业自用别克、奔驰等车辆，均有车辆行驶证，截至评估基准日，汽车日常维护保养正常，车辆均能正常行驶；电子设备共 550 项，主要为电脑等办公设备。截至基准日固定资产使用正常，保养情况良好。

### 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截至评估基准日，企业申报的账面记录的无形资产为 20 项外购软件，账面未记录的无形资产共 353 项。其中已注册中国境内商标共计 68 项，已注册中国境外商标共计 53 项，注册中的商标 3 项，软件著作权 8 项，已获批准的中国境内专利权 106 项，其中 42 项为发明专利、53 项为实用新型专利、11 项为外观设计专利，已获批准的中国境外专利权 114 项，其中 89 项为发明专利、23 项为外观设计专利、

2 项为实用新型专利，域名 1 项，具体情况如下：

### 1、外购软件

序号	名称	取得日期	所有权人
1	中望 3D 软件	2025/08	杭州众硅电子科技有限公司
2	杭州北山科技有限公司中望 CAD 平台软件 5 套	2023/08	杭州众硅电子科技有限公司
3	中望 CAD 软件	2024/05	杭州众硅电子科技有限公司
4	中望 CAD 平台软件 V2020(5 套)	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
5	KeyShot11Pro	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
6	MATLAB	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
7	PLM 系统	2019/01	杭州众硅电子科技有限公司
8	ERP 系统	2019/09	杭州众硅电子科技有限公司
9	6400 网络安全系统一套	2021/09	杭州众硅电子科技有限公司
10	中望 3D 平台设计软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
11	中望 CAD 平台软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
12	中望 3D 平台设计软件 V2022	2021/07	杭州众硅电子科技有限公司
13	中望 3D 平台设计软件 V2023	2022/06	杭州众硅电子科技有限公司
14	中望 CAD2023 专业版	2022/08	杭州众硅电子科技有限公司
15	中望 3D2023 标准版升级	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
16	广州中望龙腾软件股份有限公司杭州众硅 3D 产品功能开发费	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
17	中望 3D 平台设计软件 V2022 (5 套)	2022/11	杭州众硅电子科技有限公司
18	COMSOL	2022/10	杭州众硅电子科技有限公司
19	MDK	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
20	KEIL	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司

### 2、商标

境内商标明细如下：

序号	权利人	注册号	商标标识	专用权期限	使用类别
69	杭州众硅	83471595		9-07 至 2035-09-06	7类 机械设备
70	杭州众硅	80450440		7-07 至 2035-07-06	9类 科学仪器
71	杭州众硅	79453564		3-28 至 2035-03-27	9类 科学仪器
72	杭州众硅	78465551		0-28 至 2034-10-27	9类 科学仪器
73	杭州众硅	78465536		0-28 至 2034-10-27	7类 机械设备
74	杭州众硅	76918083		2024-08-28 至 2034-08-27	7类 机械设备
75	杭州众硅	76541431		7-28 至 2034-07-27	7类 机械设备
76	杭州众硅	76532744		7-21 至 2034-07-20	9类 科学仪器
77	杭州众硅	76100178		7-14 至 2034-07-13	7类 机械设备
78	杭州众硅	76120133		7-14 至 2034-07-13	9类 科学仪器
79	杭州众硅	75675889		8-21 至 2034-08-20	9类 科学仪器
80	杭州众硅	75684558		6-07 至 2034-06-06	7类 机械设备

81	杭州众硅	75681896	<b>eView</b>	8-21 至 2034-08-20	7 类 机械设备
82	杭州众硅	75681934	<b>sView</b>	6-14 至 2035-06-13	9 类 科学仪器
83	杭州众硅	75374290	<b>mMAP</b>	8-21 至 2034-08-20	7 类 机械设备
84	杭州众硅	75354106	<b>mMAP</b>	8-14 至 2034-08-13	9 类 科学仪器
85	杭州众硅	75364792	<b>eMAP</b>	6-07 至 2034-06-06	9 类 科学仪器
86	杭州众硅	75354086	<b>eMAP</b>	6-07 至 2034-06-06	7 类 机械设备
87	杭州众硅	75285972A	<b>CMP<sup>e</sup></b>	6-14 至 2034-06-13	7 类 机械设备
88	杭州众硅	75285972	<b>CMP<sup>e</sup></b>	6-21 至 2035-06-20	7 类 机械设备
89	杭州众硅	74918117	<b>eHEAD</b>	5-28 至 2034-05-27	7 类 机械设备
90	杭州众硅	73335681	<b>h-CMP</b>	2-07 至 2034-02-06	7 类 机械设备
91	杭州众硅	73345937	<b>h-CMP</b>	2-14 至 2034-02-13	9 类 科学仪器
92	杭州众硅	73263142	<b>preMAP</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	9 类 科学仪器
93	杭州众硅	73266569	<b>TTAI</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	7 类 机械设备


94	杭州众硅	73247718	<b>TTAI</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	9类 科学仪器
95	杭州众硅	73254489	<b>preMAP</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	7类 机械设备
96	杭州众硅	71449178		2023-10-28 至 2033-10-27	3类 日化用品
97	杭州众硅	71453805	<b>SIZONE</b>	2-28 至 2034-02-27	9类 科学仪器
98	杭州众硅	71324724	<b>SIZONE</b>	2-07 至 2034-12-06	42类 设计研究
99	杭州众硅	71046046	<b>wCMP</b>	4-21 至 2034-04-20	9类 科学仪器
100	杭州众硅	71043369	<b>tCMP</b>	0-21 至 2033-10-20	7类 机械设备
101	杭州众硅	71054635	<b>tCMP</b>	0-07 至 2033-10-06	9类 科学仪器
102	杭州众硅	71040472	<b>wCMP</b>	0-07 至 2033-10-06	7类 机械设备
103	杭州众硅	69985134	<b>CMP<sup>e</sup></b>	21 至 2034-01-20	9类 科学仪器
104	杭州众硅	69474158	<b>ZHONG GUI</b>	3-21 至 2034-03-20	7类 机械设备
105	杭州众硅	69130284	 SIZONE	2023-09-21 至 2033-09-20	7类 机械设备
106	杭州众硅	69135169	<b>TTAIS</b>	2023-09-21 至 2033-09-20	9类 科学仪器


107	杭州众硅	69134470		2023-09-21 至 2033-09-20	40 类 材料加工
108	杭州众硅	69120026		2023-10-07 至 2033-10-06	1 类 化学原料
109	杭州众硅	69120069		2023-09-14 至 2033-09-13	37 类 建筑修理
110	杭州众硅	69136420	<b>TTAIS</b>	2023-09-07 至 2033-09-06	7 类 机械设备
111	杭州众硅	69129658		2024-11-28 至 2034-11-27	42 类 设计研究
112	杭州众硅	67125479	<b>sCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
113	杭州众硅	67129953	<b>sCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	9 类 科学仪器
114	杭州众硅	67116815	<b>xCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
115	杭州众硅	65713545	<b>TNTAS</b>	2023-01-21 至 2033-01-20	9 类 科学仪器
116	杭州众硅	65715828	<b>TTAIS</b>	2024-04-14 至 2034-04-13	7 类 机械设备
117	杭州众硅	65720217	<b>TMTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备
118	杭州众硅	65734434	<b>TNTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备
119	杭州众硅	65713519	<b>TTAISN</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	9 类 科学仪器

120	杭州众硅	65718889	<b>TMTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	9类 科学仪器
121	杭州众硅	65738714	<b>TTAIS</b>	2023-03-21 至 2033-03-20	9类 科学仪器
122	杭州众硅	65738637	<b>TTAISN</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7类 机械设备
123	杭州众硅	65715828A	<b>TTAIS</b>	2023-02-28 至 2033-02-27	7类 机械设备
124	杭州众硅	65341636	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	9类 科学仪器
125	杭州众硅	65352408	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	7类 机械设备
126	杭州众硅	65344838	SIZONE SDS	2022-11-28 至 2032-11-27	7类 机械设备
127	杭州众硅	65344892	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	9类 科学仪器
128	杭州众硅	65352855	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	7类 机械设备
129	杭州众硅	65352699	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	9类 科学仪器
130	杭州众硅	65337973	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	7类 机械设备
131	杭州众硅	65352697	SIZONE SDS	2022-12-07 至 2032-12-06	9类 科学仪器
132	杭州众硅	34700114	Tenms	2019-07-07 至 2029-07-06	9类 科学仪器


133	杭州众硅	34700098		2019-07-07 至 2029-07-06	7类 机械设备
134	杭州众硅	32274636		2019-04-07 至 2029-04-06	9类 科学仪器
135	杭州众硅	32274633		2019-12-21 至 2029-12-20	7类 机械设备
136	杭州众硅	32279159		2020-04-21 至 2030-04-20	9类 科学仪器

境外商标明细如下：

序号	商标名称	国家/地区/组织	注册地	注册号	类别	注册日	有效期	权利人	取得方式	他项权利
54		马德里国际注册	日本	1532374	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
55			日本	1531846	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
56			韩国	1532374	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
57			韩国	1531846	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
58			美国	6297605	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
59			美国	6291605	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无

60			欧盟	1532374	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
61			欧盟	1531846	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
62			新加坡	1532374	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
63			新加坡	1531846	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
64		中国台湾	中国台湾	02109945	7类、9类	2020-12-16	2030-12-15	杭州众硅	原始取得	无
65		马德里国际注册	日本	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
66		日本	日本	6387275	9类	2021-05-11	2031-05-11	杭州众硅	原始取得	无
67		马德里国际注册	韩国	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
68		韩国	韩国	40-1752832	9类	2021-07-15	2031-07-15	杭州众硅	原始取得	无
69		马德里国际注册	美国	6268972	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
70		美国	美国	6444084	9类	2021-	2031-	杭	原始	无

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股  
东全部权益价值评估项目·资产评估说明

						08-10	08-10	州 众 硅	取得	
71		马德 里国 际注 册	欧盟	1548407	7类	2020- 04-22	2030- 04-22	杭 州 众 硅	原始 取得	无
72		欧盟	欧盟	0182243 43	9类	2020- 08-01	2030- 04-10	杭 州 众 硅	原始 取得	无
73		马德 里国 际注 册	新加 坡	1548407	7类	2020- 04-22	2030- 04-22	杭 州 众 硅	原始 取得	无
74		新加 坡	新加 坡	4020200 9597U	9类	2020- 05-08	2030- 05-08	杭 州 众 硅	原始 取得	无
75		中国 台湾	中国 台湾	0209939 2	7 类、 9类	2020- 11-01	2030- 10-31	杭 州 众 硅	原始 取得	无
76		欧盟	欧盟	0188237 48	7 类、 9类	2023- 06-14	2033- 01-19	杭 州 众 硅	原始 取得	无
77		韩国	韩国	40- 2270814	7类	2024- 11-08	2034- 11-08	杭 州 众 硅	原始 取得	无
78		韩国	韩国	40- 2270830	9类	2024- 11-04	2034- 11-04	杭 州 众 硅	原始 取得	无
79		日本	日本	6717320	7 类、 9类	2023- 07-13	2033- 07-13	杭 州 众 硅	原始 取得	无
80		新加 坡	新加 坡	4020230 2136W	7 类、	2023- 02-07	2033- 02-07	杭 州	原始 取得	无

					9类			众 硅		
81		中国 台湾	中国 台湾	0231652 8	7类	2023- 09-01	2033- 08-31	杭 州 众 硅	原始 取得	无
82		中国 台湾	中国 台湾	0231674 0	9类	2023- 09-01	2033- 08-31	杭 州 众 硅	原始 取得	无
83	<b>TTAIS</b>	美国	美国	7666240	7 类、 9类	2025- 01-28	2035- 01-29	杭 州 众 硅	原始 取得	无
84	<b>TNTAS</b>	欧盟	欧盟	0188656 70	7 类、 9类	2023- 09-12	2033- 04-21	杭 州 众 硅	原始 取得	无
85		日本	日本	6747127	7 类、 9类	2023- 10-20	2033- 10-20	杭 州 众 硅	原始 取得	无
86		中国 台湾	中国 台湾	0233445 2	7类	2023- 11-16	2033- 11-15	杭 州 众 硅	原始 取得	无
87		中国 台湾	中国 台湾	0233471 2	9类	2023- 11-16	2033- 11-15	杭 州 众 硅	原始 取得	无
88		新加 坡	新加 坡	4020230 9676Y	7 类、 9类	2024- 03-13	2033- 05-04	杭 州 众 硅	原始 取得	无
89		美国	美国	7432079	7 类、 9类	2024- 07-02	2034- 07-03	杭 州 众 硅	原始 取得	无
90		韩国	韩国	40- 2283338	7类	2024- 12-02	2034- 12-01	杭 州 众	原始 取得	无

								硅		
91		韩国	韩国	40- 2283341	9类	2024- 12-02	2034- 12-01	杭州 众 硅	原始 取得	无
92	mCMP	新加 坡	新加 坡	4020250 1796W	7类	2025- 01-23	2035- 01-23	杭州 众 硅	原始 取得	无
93		中国 台湾	中国 台湾	0248432 8	7类	2025- 10-01	2035- 09-30	杭州 众 硅	原始 取得	无
94	tCMP	新加 坡	新加 坡	4020250 1797R	7类	2025- 01-23	2035- 01-23	杭州 众 硅	原始 取得	无
95		中国 台湾	中国 台湾	0248432 7	7类	2025- 10-01	2035- 09-30	杭州 众 硅	原始 取得	无
96	xCMP	新加 坡	新加 坡	4020250 1798P	7类	2025- 01-23	2035- 01-23	杭州 众 硅	原始 取得	无
97		中国 台湾	中国 台湾	0248432 6	7类	2025- 10-01	2035- 09-30	杭州 众 硅	原始 取得	无
98	dView	新加 坡	新加 坡	4020250 1793X	9类	2025- 01-23	2035- 01-23	杭州 众 硅	原始 取得	无
99		中国 台湾	中国 台湾	0247447 0	9类	2025- 08-16	2035- 08-15	杭州 众 硅	原始 取得	无
100	eView	新加 坡	新加 坡	4020250 1792S	9类	2025- 01-23	2035- 01-23	杭州 众 硅	原始 取得	无

101		中国台湾	中国台湾	02484467	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
102	sView	新加坡	新加坡	40202501794V	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
103		中国台湾	中国台湾	02484466	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
104	mCMP	美国	美国	7982584	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
105	tCMP	美国	美国	7982583	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
106	xCMP	美国	美国	7982582	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无

注册中的商标明细如下：

序号	内容或名称	取得日期	专利号或注册号
1		2025/02	78483204
2		2025/02	83718856
3		2025/02	83708238

### 3、软件著作权

序号	权利人	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	首次发表日	他项权利
1	杭州众硅	Sizone Canaan CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 3979698 号	2019SR0558941	原始取得	未发表	无
2	杭州众硅	Sizone SINAI CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 6652088 号	2020SR1849086	原始取得	未发表	无
3	杭州众硅	Sizone ZION CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 7676983 号	2021SR0954357	原始取得	未发表	无
4	杭州众硅	Sizone DRACO CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 9688894 号	2022SR0734695	原始取得	未发表	无
5	杭州众硅	SDS 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 9639224 号	2022SR0685025	原始取得	未发表	无
6	杭州众硅	Sizone SHEBA CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 11645217 号	2023SR1058044	原始取得	未发表	无
7	杭州众硅	Sizone LAMB CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 11646342 号	2023SR1059169	原始取得	未发表	无
8	杭州众硅	Sizone Dove 第三代半导体系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第 12283993 号	2023SR1696820	原始取得	未发表	无

#### 4、专利

中国境内专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得途径	法律状态	他项权利
1	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023112396583	2023-09-22	发明	原始取得	授权	无
2	杭州众硅	一种抛光垫沟槽在线修整方法及装置	2025112141085	2025-08-28	发明	原始取得	授权	无
3	杭州众硅	一种用于晶圆清洗装置的从动机构及晶圆清洗装置	2025113685359	2025-09-24	发明	原始取得	授权	无
4	杭州众硅	一种化学机械抛光在线监测方法	2025110653799	2025-07-31	发明	原始取得	授权	无

5	杭州众硅	一种用于 CMP 设备抛光垫沟槽修整的方法	2023112936007	2023-10-08	发明	原始取得	授权	无
6	杭州众硅	站立式晶圆卡座	202111533401X	2021-12-15	发明	原始取得	授权	无
7	杭州众硅	一种可调平式抛光盘及抛光系统	2024223742429	2024-09-27	实用新型	原始取得	授权	无
8	杭州众硅	一种晶圆提拉结构	2025103110213	2025-03-17	发明	原始取得	授权	无
9	杭州众硅	一种用于快速调温的化学液输送单元及化学机械平坦化设备	2024206596934	2024-04-01	实用新型	原始取得	授权	无
10	杭州众硅	抛光研磨装置	2024304771328	2024-07-30	外观设计	原始取得	授权	无
11	杭州众硅	一种电化学机械抛光及平坦化装置	2024211355783	2024-05-23	实用新型	原始取得	授权	无
12	杭州众硅	一种用于半导体湿法设备的晶圆定位检测方法	2024116930911	2024-11-25	发明	原始取得	授权	无
13	杭州众硅	一种用于电化学机械平坦化设备的电抛光头、导电系统及其装配方法	2025101877875	2025-02-20	发明	原始取得	授权	无
14	杭州众硅	联动式单动力源控制间停机构、晶圆修整机构及工作方法	2024116669404	2024-11-21	发明	原始取得	授权	无
15	杭州众硅	一种晶圆搬运装置及抛光系统、抛光工艺	2024116612270	2024-11-20	发明	原始取得	授权	无
16	杭州众硅	一种抛光垫及晶圆抛光系统	2024203287163	2024-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
17	杭州众硅	一种化学机械抛光及平坦化系统	2024204236775	2024-03-05	实用新型	原始取得	授权	无
18	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2024202256223	2024-01-30	实用新型	原始取得	授权	无
19	杭州众硅	一种用于导电晶圆的传输装置	2024208760026	2024-04-25	实用新型	原始取得	授权	无
20	杭州众硅	一种带有压力检测的修整装置	2024210918589	2024-05-17	实用新型	原始取得	授权	无
21	杭州众硅	一种晶圆旋转干燥装置	2024206000894	2024-03-26	实用新型	原始取得	授权	无
22	杭州众硅	化学机械平坦化装置	2024301324801	2024-03-15	外观设计	原始取得	授权	无
23	杭州众硅	抛光研磨装置	2024300460724	2024-01-24	外观设计	原始取得	授权	无

24	杭州众硅	一种导电型晶圆化学机械抛光系统	2023233 277503	2023- 12-05	实用 新型	原始 取得	授权	无
25	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法	2019104 814482	2019- 06-04	发明	原始 取得	授权	无
26	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023226 009702	2023- 09-22	实用 新型	原始 取得	授权	无
27	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	2021104 070747	2021- 04-15	发明	原始 取得	授权	无
28	杭州众硅	一种晶圆传输机械手	2021102 933431	2019- 09-06	发明	原始 取得	授权	无
29	杭州众硅	晶圆夹持臂夹爪	2022305 192323	2022- 08-10	外观 设计	原始 取得	授权	无
30	杭州众硅	一种可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	2020113 382226	2020- 11-25	发明	原始 取得	授权	无
31	杭州众硅	晶圆抛光系统	2023218 495446	2023- 07-13	实用 新型	原始 取得	授权	无
32	杭州众硅	一种晶圆传输装置	2023216 687244	2023- 06-28	实用 新型	原始 取得	授权	无
33	杭州众硅	一种晶圆传输监测系统	2023218 599746	2023- 07-13	实用 新型	原始 取得	授权	无
34	杭州众硅	一种预清洗输入装置	2023216 754959	2023- 06-28	实用 新型	原始 取得	授权	无
35	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2023216 722892	2023- 06-28	实用 新型	原始 取得	授权	无
36	杭州众硅	一种 CMP 抛光垫再加工装置	2023216 039222	2023- 06-21	实用 新型	原始 取得	授权	无
37	杭州众硅	一种用于半导体清洗单元的晶圆有无检测装置	2023208 720594	2023- 04-14	实用 新型	原始 取得	授权	无
38	杭州众硅	一种拼接式工作台机构	2023209 035886	2023- 04-20	实用 新型	原始 取得	授权	无
39	杭州众硅	一种晶圆清洁干燥模组状态检测方法、装置及平坦化设备	2022105 084239	2022- 05-11	发明	原始 取得	授权	无
40	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2023203 161480	2023- 02-14	实用 新型	原始 取得	授权	无
41	杭州众硅	一种抛光垫加工装置	2022229 899063	2022- 11-07	实用 新型	原始 取得	授权	无
42	杭州众硅	一种晶圆清洗箱	2023201 723676	2023- 01-13	实用 新型	原始 取得	授权	无

43	杭州众硅	一种排风脏污收集装置及化学机械平坦化抛光设备	2023208367028	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
44	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229651320	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
45	杭州众硅	应用于导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229771233	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
46	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械抛光及平坦化系统	2022229614336	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
47	杭州众硅	一种晶圆干燥装置	2023205456301	2023-03-14	实用新型	原始取得	授权	无
48	杭州众硅	一种用于化学机械平坦化白光终点检测的采集方法及系统	2022106070657	2022-05-31	发明	原始取得	授权	无
49	杭州众硅	一种导电型抛光头固定装置及导电型抛光头系统	2022231254625	2022-11-23	实用新型	原始取得	授权	无
50	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023201637007	2023-01-13	实用新型	原始取得	授权	无
51	杭州众硅	晶圆夹持器	2022305191918	2022-08-10	外观设计	原始取得	授权	无
52	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022234891659	2022-12-22	实用新型	原始取得	授权	无
53	杭州众硅	一种晶圆干燥抬升方法	2023102418938	2023-03-14	发明	原始取得	授权	无
54	杭州众硅	一种晶圆有无检测的提拉结构机械手	2022228546755	2022-10-26	实用新型	原始取得	授权	无
55	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	2022103161527	2022-03-29	发明	原始取得	授权	无
56	杭州众硅	一种清洗刷预清洗系统	2020101573307	2020-03-09	发明	原始取得	授权	无
57	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022112694450	2022-10-18	发明	原始取得	授权	无
58	杭州众硅	抛光研磨装置（150&300）	2022304099308	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无
59	杭州众硅	一种涡流终点检测装置及方法	2022112574529	2022-10-14	发明	原始取得	授权	无

60	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2022221 28694X	2022- 08-12	实用 新型	原始 取得	授权	无
61	杭州众硅	一种晶圆循环清洗系统	2022221 015365	2022- 08-10	实用 新型	原始 取得	授权	无
62	杭州众硅	一种晶圆夹持装置	2022220 957792	2022- 08-10	实用 新型	原始 取得	授权	无
63	杭州众硅	抛光研磨装置（300β）	2022304 103360	2022- 06-30	外观 设计	原始 取得	授权	无
64	杭州众硅	抛光研磨装置（200s）	2022304 096846	2022- 06-30	外观 设计	原始 取得	授权	无
65	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶 圆旋转夹持机构及晶圆 清洗干燥系统	2022107 327358	2022- 06-27	发明	原始 取得	授权	无
66	杭州众硅	一种晶圆搬运装置	2022214 128871	2022- 06-07	实用 新型	原始 取得	授权	无
67	杭州众硅	供液装置	2022305 164982	2022- 08-09	外观 设计	原始 取得	授权	无
68	杭州众硅	清洗装置	2022305 055190	2022- 08-04	外观 设计	原始 取得	授权	无
69	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022216 587824	2022- 06-30	实用 新型	原始 取得	授权	无
70	杭州众硅	一种晶圆传递装置	2022207 093191	2022- 03-29	实用 新型	原始 取得	授权	无
71	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2021114 452396	2021- 11-30	发明	原始 取得	授权	无
72	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸 台工作位置的装置	2022209 517117	2022- 04-24	实用 新型	原始 取得	授权	无
73	杭州众硅	一种化学机械平坦化设 备	2021230 946535	2021- 12-10	实用 新型	原始 取得	授权	无
74	杭州众硅	一种提拉式晶圆传输机 构	2022202 326195	2022- 01-26	实用 新型	原始 取得	授权	无
75	杭州众硅	一种晶圆检测系统	2022203 603706	2022- 02-22	实用 新型	原始 取得	授权	无
76	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229 713411	2021- 11-30	实用 新型	原始 取得	授权	无
77	杭州众硅	一种动态检测装置及化 学机械平坦化设备	2022101 643690	2022- 02-23	发明	原始 取得	授权	无
78	杭州众硅	晶圆驱动机构	2021230 426920	2021- 12-06	实用 新型	原始 取得	授权	无
79	杭州众硅	一种站立式晶圆卡座	2021231 583806	2021- 12-15	实用 新型	原始 取得	授权	无

80	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	2022100041307	2022-01-05	发明	原始取得	授权	无
81	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法及检测系统	2022100773979	2022-01-24	发明	原始取得	授权	无
82	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229694980	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无
83	杭州众硅	一种晶圆抛光装置	2021112182640	2021-10-20	发明	原始取得	授权	无
84	杭州众硅	一种用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	2021114722319	2021-12-06	发明	原始取得	授权	无
85	杭州众硅	一种晶圆紧固装置	2021216969237	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
86	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	2021225192769	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
87	杭州众硅	一种用于晶圆的紧固装置	2021216969256	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
88	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	2021225191535	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
89	杭州众硅	晶圆紧固装置	2021216940328	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
90	杭州众硅	抛光装置	2021304973519	2021-08-03	外观设计	原始取得	授权	无
91	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥方法及机构	2021108994674	2021-08-06	发明	原始取得	授权	无
92	杭州众硅	一种多工位夹取装置	202110770071X	2021-07-08	发明	原始取得	授权	无
93	杭州众硅	一种晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	2019104403343	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
94	杭州众硅	一种结合研磨和单晶圆清洗模组的化学机械平坦化设备	2019111130957	2019-11-14	发明	原始取得	授权	无
95	杭州众硅	一种抛光装置	202011419911X	2020-12-08	发明	原始取得	授权	无
96	杭州众硅	用于化学机械平坦化设备的抛光头压力控制设备及方法	2019113033010	2019-12-17	发明	原始取得	授权	无
97	杭州众硅	抛光头检测装置、腔室气密性和传感器有效性检测方法	2021104488565	2021-04-25	发明	原始取得	授权	无

98	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	2021102490467	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
99	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	2021102490255	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
100	杭州众硅	一种晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	2019108427084	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
101	杭州众硅	一种晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	2020107204397	2020-07-24	发明	原始取得	授权	无
102	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2020102077484	2020-03-23	发明	原始取得	授权	无
103	杭州众硅	基于光谱的化学机械抛光在线终点检测方法	2019104403451	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
104	杭州众硅	一种化学机械抛光平坦化晶圆传输设备	2019208326110	2019-06-04	实用新型	原始取得	授权	无
105	杭州众硅	一种晶圆清洗装置	2019209736837	2019-06-26	实用新型	原始取得	授权	无
106	杭州众硅	内置式双重限位机构	2019202198142	2019-02-21	实用新型	原始取得	授权	无

中国境外专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	国家/地区/组织	专利号	申请日	授权日	专利类型	取得方式	他项权利
115	杭州众硅	一种抛光装卸部件模块	美国	US 12, 194, 59 2 B2	2021-03-22	2025-01-14	发明	原始取得	无
116	杭州众硅		新加坡	11202102935Q	2019-08-28	2025-08-12	发明	原始取得	无
117	杭州众硅		韩国	10-2584030	2021-04-19	2023-09-25	发明	原始取得	无
118	杭州众硅	用于 CMP 工艺的晶片装载支架、晶片装载系统和晶片安装方法	美国	US 12, 103, 13 4 B2	2019-09-04	2024-10-01	发明	原始取得	无
119	杭州众硅		新加坡	11202111470X	2019-09-04	2025-01-27	发明	原始取得	无
120	杭州众硅		韩国	10-2605197	2021-09-13	2023-11-20	发明	原始取得	无

121	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法、晶圆平坦化单元	美国	US 12,251,785 B2	2019-08-20	2025-03-18	发明	原始取得	无
122	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆转移方法、晶圆平坦化装置	韩国	10-2533567	2021-04-07	2023-05-12	发明	原始取得	无
123	杭州众硅		新加坡	112021034 77T	2019-08-20	2023-09-19	发明	原始取得	无
124	杭州众硅	晶圆检测装置及使用该装置的晶圆检测方法	美国	US 11,961,749 B2	2020-08-04	2024-04-16	发明	原始取得	无
125	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备、晶圆传送机器人及晶圆翻转方法	韩国	10-2709839	2021-04-27	2024-09-20	发明	原始取得	无
126	杭州众硅		新加坡	112021038 52Y	2019-09-26	2024-02-08	发明	原始取得	无
127	杭州众硅		美国	US 11,908,720 B2	2021-04-09	2024-02-20	发明	原始取得	无
128	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	美国	US 12,482,674 B2	2020-09-29	2025-11-25	发明	原始取得	无
129	杭州众硅		韩国	10-2705137	2022-06-20	2024-09-05	发明	原始取得	无
130	杭州众硅	晶圆输送装置、化学机械平坦化装置及晶圆输送方法	美国	US 12,427,619 B2	2020-08-06	2025-09-30	发明	原始取得	无
131	杭州众硅	晶圆位置检测装置	日本	7638389	2021-10-20	2025-02-20	发明	原始取得	无
132	杭州众硅		韩国	10-2858973	2023-09-08	2025-09-09	发明	原始取得	无

133	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	日本	7714253	2022-10-14	2025-07-18	发明	原始取得	无
134	杭州众硅	晶圆抛光系统	韩国	10-2837898	2024-02-14	2025-07-21	发明	原始取得	无
135	杭州众硅		日本	7712007	2022-08-30	2025-07-14	发明	原始取得	无
136	杭州众硅	晶圆抛光装置	美国	US 11,794,304 B2	2022-01-19	2023-10-24	发明	原始取得	无
137	杭州众硅		韩国	10-2693838	2022-02-24	2024-08-06	发明	原始取得	无
138	杭州众硅		新加坡	102022015 71V	2022-02-18	2024-08-21	发明	原始取得	无
139	杭州众硅	晶圆抛光系统	日本	7728045	2022-08-30	2025-08-14	发明	原始取得	无
140	杭州众硅		韩国	10-2837898	2024-02-14	2025-07-21	发明	原始取得	无
141	杭州众硅	抛光研磨装置	美国	US D1, 018, 612 S	2022-10-19	2024-03-19	外观设计	原始取得	无
142	杭州众硅		韩国	DM/22614 9	2022-10-19	2023-11-28	外观设计	原始取得	无
143	杭州众硅		新加坡	DM/22614 9	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
144	杭州众硅		日本	1748952	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
145	杭州众硅		欧盟	DM/22614 9	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
146	杭州众硅	抛光研磨装置	美国	US D1, 018, 613 S	2022-10-19	2024-03-19	外观设计	原始取得	无
147	杭州众硅		韩国	DM/22615 1	2022-10-19	2023-11-28	外观设计	原始取得	无
148	杭州众硅		新加坡	DM/22615 1	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
149	杭州众硅		日本	1748953	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
150	杭州众硅		欧盟	DM/22615 1	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无

151	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	美国	US 12,017,293 B2	2023-01-19	2024-06-25	发明	原始取得	无
152	杭州众硅		欧盟	EP 4364890	2023-03-15	2025-07-02	发明	原始取得	无
153	杭州众硅		韩国	10-2819458	2023-03-30	2025-06-09	发明	原始取得	无
154	杭州众硅		日本	7688074	2023-05-30	2025-05-26	发明	原始取得	无
155	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	日本	3253377	2022-11-09	2025-10-16	实用新型	原始取得	无
156	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	日本	7660959	2022-11-09	2025-04-04	发明	原始取得	无
157	杭州众硅	用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	日本	7788191	2022-11-09	2025-12-10	发明	原始取得	无
158	杭州众硅	抛光垫修整装置	日本	7773262	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
159	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	日本	7773261	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
160	杭州众硅	抛光垫表面状况在线检测方法及检测系统	韩国	10-2904378	2024-06-13	2025-12-22	发明	原始取得	无
161	杭州众硅	晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	韩国	10-2816529	2024-07-17	2025-05-29	发明	原始取得	无
162	杭州众硅	抛光研磨装置（ECMP 外观）	韩国	DM/23780 9	2024-05-23	2025-02-17	外观设计	原始取得	无
163	杭州众硅		加拿大	231357	2024-05-23	2025-04-03	外观设计	原始取得	无
164	杭州众硅		日本	1790565	2024-05-23	2025-01-27	外观设计	原始取得	无
165	杭州众硅		欧盟	DM/23780 9	2024-05-23	2024-07-11	外观设计	原始取得	无
166	杭州众硅	抛光研磨装置（TANAS,EFE	韩国	DM/240665	2024-08-29	2025-07-25	外观设计	原始取得	无

167	杭州众硅	MT形)	日本	1794400	2024-08-29	2025-03-17	外观设计	原始取得	无
168	杭州众硅		日本	1799656	2024-08-29	2025-05-19	外观设计	原始取得	无
169	杭州众硅		欧盟	DM/240665	2024-08-29	2024-10-28	外观设计	原始取得	无
170	杭州众硅	包含可移动装卸模组的研磨装卸构件模组及其晶圆传输方法	中国台湾	I 731281	2018-11-26	2021-06-21	发明	原始取得	无
171	杭州众硅	可挠性的抛光装卸部件模组及晶圆传输的方法	中国台湾	I 739048	2018-11-19	2021-09-11	发明	原始取得	无
172	杭州众硅	CMP 制程的晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	中国台湾	I 713141	2019-11-25	2020-12-11	发明	原始取得	无
173	杭州众硅	化学机械研磨设备	中国台湾	I 806931	2018-11-22	2023-07-01	发明	原始取得	无
174	杭州众硅	化学机械平坦化晶圆传输设备及其使用方法	中国台湾	I 717119	2019-11-22	2021-01-21	发明	原始取得	无
175	杭州众硅	晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	中国台湾	I 773943	2019-11-25	2022-08-11	发明	原始取得	无
176	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备	中国台湾	I 695422	2018-11-20	2020-06-01	发明	原始取得	无
177	杭州众硅	清洗刷预清洗系统	中国台湾	I 757924	2020-10-22	2022-03-11	发明	原始取得	无
178	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	中国台湾	I 837429	2020-10-22	2024-04-01	发明	原始取得	无
179	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无

180	杭州众硅	晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	中国台湾	I 734635	2020-10-22	2021-07-21	发明	原始取得	无
181	杭州众硅	可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	中国台湾	I 823141	2021-09-08	2023-11-21	发明	原始取得	无
182	杭州众硅	抛光装置	中国台湾	I 815179	2021-09-08	2023-09-11	发明	原始取得	无
183	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	中国台湾	I 794963	2021-09-08	2023-03-01	发明	原始取得	无
184	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	中国台湾	I 787998	2021-09-08	2022-12-21	发明	原始取得	无
185	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	中国台湾	I 834990	2021-09-08	2024-03-11	发明	原始取得	无
186	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	中国台湾	I 816394	2022-05-11	2023-09-21	发明	原始取得	无
187	杭州众硅	一种修整头旋转部件、抛光垫修整头和修整器	中国台湾	I 801997	2021-09-08	2023-05-11	发明	原始取得	无
188	杭州众硅	多工位夹取装置	中国台湾	I 816180	2021-09-08	2023-09-21	发明	原始取得	无
189	杭州众硅	晶圆清洗干燥方法及晶圆清洗干燥机构	中国台湾	I 803379	2022-07-01	2023-05-21	发明	原始取得	无
190	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 825934	2022-08-22	2023-12-11	发明	原始取得	无
191	杭州众硅	一种晶圆研磨装置	中国台湾	I 829054	2021-12-23	2024-01-11	发明	原始取得	无
192	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	中国台湾	I 839861	2022-09-26	2024-04-21	发明	原始取得	无
193	杭州	多晶圆刷洗装	中国	I 808023	2022-	2023-	发明	原始	无

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股  
东全部权益价值评估项目·资产评估说明

	众硅	置	台湾		10-14	07-01		取得	
194	杭州众硅	晶圆寻位方法	中国台湾	I 816576	2022-10-14	2023-09-21	发明	原始取得	无
195	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 818688	2022-08-23	2023-10-11	发明	原始取得	无
196	杭州众硅	晶圆驱动机构	中国台湾	I 817770	2022-10-14	2023-10-01	发明	原始取得	无
197	杭州众硅	站立式晶圆卡座	中国台湾	I 857368	2022-10-17	2024-10-01	发明	原始取得	无
198	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	中国台湾	I 820968	2022-10-17	2023-11-01	发明	原始取得	无
199	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	中国台湾	I 834448	2022-12-23	2024-03-01	发明	原始取得	无
200	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法 & 检测系统	中国台湾	I 829393	2022-10-17	2024-01-11	发明	原始取得	无
201	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、其装载方法及使用方法	中国台湾	I 823623	2022-10-17	2023-11-21	发明	原始取得	无
202	杭州众硅	晶圆清洁干燥模块状态检测方法、装置及平坦化设备	中国台湾	I 874908	2023-02-09	2025-03-01	发明	原始取得	无
203	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	中国台湾	I 838117	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无
204	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆传输方法	中国台湾	I 896992	2023-06-29	2025-09-11	发明	原始取得	无
205	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225666	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
206	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225667	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
207	杭州众硅	涡流终点检测装置及方法	中国台湾	I 854476	2023-02-07	2024-09-01	发明	原始取得	无
208	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	中国台湾	I 838116	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无

209	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无
210	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械研磨系统	中国台湾	I 869019	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
211	杭州众硅	研磨垫再利用加工装置	中国台湾	I 899689	2023-11-03	2025-10-01	发明	原始取得	无
212	杭州众硅	一种导电型研磨头固定装置及导电型研磨头系统	中国台湾	I 866602	2023-11-10	2024-12-11	发明	原始取得	无
213	杭州众硅	导电吸附膜及抛光头	中国台湾	I 845382	2023-07-21	2024-06-11	发明	原始取得	无
214	杭州众硅	一种用于 CMP 设备研磨垫沟槽修整的方法	中国台湾	I 869022	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
215	杭州众硅	晶圆研磨系统及晶圆处理方法	中国台湾	I 886965	2024-05-20	2025-06-11	发明	原始取得	无
216	杭州众硅	可调式晶圆装卸台	中国台湾	I 896134	2024-05-20	2025-09-01	发明	原始取得	无
217	杭州众硅	用于改善边缘研磨均匀性的研磨装置	中国台湾	I 900014	2024-05-21	2025-10-01	发明	原始取得	无
218	杭州众硅	一种用于 CMP 清洁干燥模组的检测装置及检测方法	中国台湾	I 886962	2024-05-17	2025-06-11	发明	原始取得	无
219	杭州众硅	一种化学机械研磨及平坦化系统	中国台湾	I 891372	2024-05-17	2025-07-21	发明	原始取得	无
220	杭州众硅	一种电化学机械研磨及平坦化装置	中国台湾	I 896171	2024-06-18	2025-09-01	发明	原始取得	无
221	杭州众硅	一种研磨头清洗方法及清洗	中国台湾	I 863868	2024-05-17	2024-11-21	发明	原始取得	无

		装置							
222	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 234468	2024-05-22	2024-10-21	外观设计	原始取得	无
223	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 240377	2024-11-15	2025-09-11	外观设计	原始取得	无
224	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 241113	2024-11-15	2025-10-21	外观设计	原始取得	无
225	杭州众硅	化学机械抛光的在线监测装置	中国台湾	I 862202	2023-10-03	2024-11-11	发明	原始取得	无
226	杭州众硅	晶圆研磨系统	中国台湾	I 892653	2024-05-20	2025-08-01	发明	原始取得	无
227	杭州众硅	晶圆抛光系统、安装方法及使用方法	日本	7736360	2023-01-09	2025-09-01	发明	原始取得	无
228	杭州众硅	立式晶圆盒	日本	3253988	2022-12-30	2025-12-04	实用新型	原始取得	无

## 5、域名

序号	网站名称	许可证号	注册日期	到期日期
1	sizonetech.com	浙 ICP 备 18044783 号-2	2018/11	2032/11

### 企业申报的表外资产的类型、数量

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，除上述申报的无形资产外，企业申报的评估范围内无其他表外资产。

### 引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额（或者评估值）

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 27 日出具的《普华永道中天特审字(2026)第 0065 号》审计报告结果。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

## 二、资产核实情况总体说明

## 资产核实人员组织、实施时间和过程

评估人员在进入现场核实前，制定现场核实实施计划，按资产类型和分布特点，分成固定资产、无形资产、股权投资、流动资产和其他资产小组，进行现场的核实工作。核实工作结束后，各小组对资产核实及现场勘察情况进行工作总结。资产核实的主要步骤如下：

首先，辅导企业进行资产的清查、申报评估的资产明细，并收集整理评估资料。评估人员开展前期布置工作，评估师对企业资产评估配合工作要求进行了详细讲解，包括资产评估的基本概念、资产评估的任务、本次资产评估的计划安排、需委托人和被评估企业提供的资料清单、企业资产清查核实工作的要求、评估明细表和资产调查表的填报说明等。在此基础上，填报“评估申报明细表”和“资产调查表”，收集并整理委估资产的产权权属资料和反映资产性能、技术状态、经济技术指标等情况的资料。

其次，依据资产评估申报明细表，对申报资产进行现场查勘。不同的资产类型，采取不同的查勘方法。根据核实结果，由企业进一步补充、修改和完善资产评估申报明细表，使“表”、“实”相符。

再次，核实评估资料，尤其是资产权属资料。在核实“表”、“实”相符的基础上，对企业提供的产权资料进行了核查。核查中，重点查验了产权权属资料中所载明的所有人以及其他事项。

### 影响资产核实的事项及处理方法

无。

### 资产核查核实结论

经过资产核实，除账外无形资产及上述事项外，至评估基准日，评估人员在资产核实所知范围内，核实情况表明：

1、实物资产的核实情况与申报明细一一核对，对资产核实明细

项目已与企业财务人员进行了沟通，核实无误。

2、非实物资产评估申报明细表和账面记录一致，申报明细表与实际情况吻合。

## 第四部分 资产基础法评估说明

根据本次资产评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等，采用资产基础法进行评估。各类资产及负债的评估方法说明如下。

### 一、流动资产评估技术说明

#### 评估范围

纳入评估的流动资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、存货及其他流动资产。

#### 评估程序

1、根据企业填报的流动资产评估申报表，与企业财务报表进行核对，明确需进行评估的流动资产的具体内容。

2、根据企业填报的流动资产评估申报表，到现场进行账务核对，原始凭证的查验，对实物类流动资产进行盘点、对资产状况进行调查核实。

3、收集与整理相关文件、资料并取得资产现行价格资料。

4、在账务核对清晰、情况了解清楚并已收集到评估所需的资料的基础上分别评定估算。

#### 评估方法

##### 1、流动资产评估方法

采用重置成本法评估，主要是：对于货币资金，以核实后的账面值为评估值；对应收、预付类债权资产，以核对无误账面值为基础，根据实际收回的可能性确定评估值；对存货，在核实评估基准日实际库存数量的基础上，以实际库存量乘以实际成本或可变现价格得出评估值。

##### 2、各项流动资产的评估

## （1）货币资金

货币资金账面金额 123,995,440.29 元，其中银行存款 123,987,440.29 元，其他货币资金 8,000.00 元。

### 1) 银行存款

对银行存款人民币账户进行了函证复核，以证明银行存款的真实存在，同时检查有无未入账的银行款项，以及评估基准日后的进账情况。对外币账户，以核实后的基准日外币存款账户金额乘以外汇汇率确认评估值。外汇汇率以基准日中国外汇交易中心公布的相应外币结算价汇率为准。银行存款以核实后账面值确定评估值。

银行存款评估值 123,987,440.29 元。

### 2) 其他货币资金

其他货币资金主要为 ETC 信用保证金。评估人员核对了账簿记录、查阅了客户交易月报及相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符，所以本次评估按清查核实后账面值确认评估值。

其他货币资金评估值 8,000.00 元。

综上，货币资金评估值为 123,995,440.29 元。

## （2）交易性金融资产

交易性金融资产账面值 51,360,623.02 元，主要为企业投资的理财产品。评估人员核对了账簿记录、查阅了客户交易记录及相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符，所以本次评估以基准日核实后的持仓份额乘每股净值确定评估值。

交易性金融资产评估值 51,360,623.02 元。

## （3）应收票据

应收票据账面值 102,964.25 元，主要为银行承兑汇票。核查时，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅核对票据票面金额、发生时间、业务内容及票面利率等与账务记录的一致性，以证实应收票据的真实性、完整性，核实结果账、表、单金额相符。经核实，应收票据记载真实，金额准确，无未计利息，以核实后账面值为评估值。

应收票据评估值 102,964.25 元。

#### （4）应收账款

应收账款账面余额 166,241,873.12 元，计提坏账准备 3,922,779.74 元，账面净额 162,319,093.38 元，主要为应收的货款等。评估人员核对了账簿记录、抽查了部分原始凭证等相关资料，核实交易事项的真实性、账龄、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符。

评估人员在对应收款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，应收账款采用组合计提的方法估计评估风险损失，具体结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率，计算预期信用损失。计算过程详见下表：

应收账款评估风险损失计算表

项目	金额（元）	评估风险损失率	评估风险损失额
组合计提	166,241,873.12	0.90%-2.77%	3,922,779.74
合计	166,241,873.12		3,922,779.74

按以上标准，确定评估风险损失为 3,922,779.74 元，以应收账款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

应收账款评估值为 162,319,093.38 元。

#### （5）预付账款

预付账款账面余额 9,134,993.01 元，主要为预付的材料款等。评估人员查阅了相关合同或协议，了解了评估基准日至评估现场作业日期间已接受的服务情况。未发现单位有破产、撤销或不能按合同规定按时提供劳务等情况，故以核实后账面值作为评估值。

预付账款评估值为 9,134,993.01 元。

#### （6）其他应收款

其他应收款账面余额 20,464,172.09 元，计提坏账准备 22,128.26 元，账面净额 20,442,043.83 元，主要为应收的往来款、押金、税金等。

评估人员在对应收款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，采用个别认定及组合计提的方法估计评估风险损失，对关联方的往来款项，评估风险坏账损失的风险为 0；对于组合计提部分款项，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率，计算预期信用损失。计算过程详见下表：

其他应收款评估风险损失计算表

项目	金额（元）	评估风险损失率	评估风险损失额
组合计提	1,662,172.09	1.11%-1.39%	22,128.26
关联方	18,802,000.00	0.00%	-
合计	20,464,172.09		22,128.26

按以上标准，确定评估风险损失为 22,128.26 元，以其他应收款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

其他应收款评估值为 20,442,043.83 元。

#### （7）存货

存货账面余额为 580,139,939.02 元，包括原材料、委托加工物资、产成品、在产品及发出商品，已计提存货跌价准备 41,152,455.93 元，

存货账面净额为 538,987,483.09 元。

评估人员对存货抽查大额发生额及原始凭证，主要客户的购、销合同，收、发货记录，生产日报表，验证账面价值构成、成本核算方法的真实、完整性；查验存货收发、结转的跨期事项，确定所有权为其所有；了解存货收、发和保管核算制度，对存货实施抽查盘点；查验存货有无残次、毁损、积压和报废等情况。收集存货市场参考价格及产品销售价格资料以其作为取价参考依据，结合市场询价资料综合分析确定评估值。数量以评估基准日实际数量为准。存货的具体评估方法及过程如下：

### 1) 原材料

原材料账面值 165,737,000.02 元，原材料因耗用量大，周转速度较快，且主要为基准日近期采购，账面值接近基准日市价，故按账面确定评估值。部分原材料库龄较长，已计提存货跌价准备，本次评估按照现行市价确认评估值。

原材料评估值 165,737,000.02 元。

### 2) 委托加工物资

委托加工物资账面值 900,082.34 元，委托加工物资主要为基准日近期委托，账面值接近基准日市价，故按账面确定评估值。部分委托加工物资时间较长，已计提委托加工物资跌价准备，本次评估按照现行市价确认评估值。

委托加工物资评估值 900,082.34 元。

### 3) 产成品

产成品账面值 6,417,548.96 元，主要为各类自制模组等，后续主要去向为研发领用。产成品成本组成内容为生产领用的材料、辅助材料，分摊的制造费用和人工费用等，由于生产周期较短，成本升降变

化不大，成本结转及时完整，故按核实后的账面值确认评估值。

产成品评估值 6,417,548.96 元。

#### 4) 在产品

在产品账面价值为 170,323,754.74 元，主要为生产成本等。

在产品按实际成本记账，其成本组成内容为生产领用的材料、制造费用、辅助材料和人工费用等。

清查时，评估人员查阅了相关账簿记录和原始凭单，以确认在产品的真实存在及所有权归属。再次，对在产品采取核实采购发票、入库单、出库单、材料及成本核算账簿等账务记录，来判断在产品的真实性和核算的准确性。

对于正常流转的在产品，由于生产周期较短，成本升降变化不大，成本结转及时完整，故按核实后的账面值确认评估值。

在产品评估值 170,323,754.74 元。

#### 5) 发出商品

发出商品账面金额 195,609,097.03 元，主要为 300mm CMP 产品。经查企业产品均为正常销售，在清查核实的基础上评估人员对企业提供的资料分析，对于发出商品以其完全成本为基础，采用市场价格确定评估值。

评估价值=实际数量×不含税售价×(1-产品销售税金及附加费率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×(1-所得税率)×r)-后续投入成本

a.不含税售价：不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的；

b.产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算交纳的城市建设税、教育附加、印花税等与产品销售相关的税金与销售收

入的比例；

c.销售费用率是按各项销售费用与销售收入的比例平均计算；

d.营业利润率：考虑到被评估单位仍处于亏损，本次按行业营业利润率计算；

e.所得税率按企业现实执行的税率；

f.r 为一定的率，由于发出商品已销售，根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险 r 为 30%。

g.后续投入成本主要设备调试期至验收前的料工费投入成本。

发出商品评估值 226,161,412.77 元，评估增值 30,552,315.73 元，增值率 15.62%。发出商品评估增值的原因是产品市场行情较好，发出商品评估值中考虑了部分利润所致。

### 案例：300CMP（发出商品序号 5）

300CMP（ST0072）设备属于一般销售产品，评估时以该产品的不含税销售价格减去预计后续预计成本、销售费用、全部税金和一定的产品销售利润后，确定评估值。

计算公式：

评估价值=实际数量×不含税售价×（1-税金及附加率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×（1-所得税率）×r）-后续投入成本

根据该项发出商品销售合同，300CMP（ST0072）设备销售单价为 21,800,000.00 元（不含税），预计后续投入成本 2,760,194.66 元，税金及附加费率 0.08%，销售费用率为 2.10%，所得税税率为 15.00%，营业利润率为 15.35%，r 取 30.00%，将以上参数代入公式，得：

评估单价=21,800,000.00 × [ 1-0.08%-2.10%-15.35% × 15.00%-15.35% × （1-15.00%） × 30.00% ] -2,760,194.66

=17,208,294.97（元）

即该产品评估基准日评估单价 17,208,294.97 元。基准日实际库存数量 1 台。评估值为：

$17,208,294.97 \times 1 = 17,208,294.97$ （元）

#### 6) 存货的评估值

存货账面值合计 538,987,483.09 元，评估值 569,539,798.83 元，评估增值 30,552,315.73 元，增值率 5.67%，增值主要原因是由于产品市场行情较好，发出商品评估值中考虑了部分利润所致。

#### (8) 其他流动资产

其他流动资产账面值 73,801,057.63 元，主要为待抵扣进项税。评估人员在对其他流动资产核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额，以核实后账面值作为评估值。

其他流动资产评估值 73,801,057.63 元。

## 二、长期股权投资评估技术说明

### 评估范围

长期股权投资共 4 项，为 3 家全资子公司及 1 家控股子公司。截至评估基准日账面原值为 5,010,521.88 元，计提减值准备 10,521.88 元，账面净额为 5,000,000.00 元。具体情况如下：

长期股权投资明细表

序号	被投资单位名称	持股比例%	投资日期
1	众硅电子科技（上海）有限公司	100.00%	2022/02
2	SIZONE TECHNOLOGY (HK) LIMITED	100.00%	2021/08
3	众恩芯科技（青岛）有限公司	99.00%	2023/12
4	众进芯科技（福建）有限公司	99.00%	2022/12

注：截至本报告书出具日，众恩芯科技（青岛）有限公司、众进芯科技（福建）有限公司已变更为标的公司全资子公司。

### 被投资单位介绍

## 1、众硅电子科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

法定代表人：HAIYANG GU

注册资本：500 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 14 日

统一社会信用代码：91310000MA7GM08053

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理咨询。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （1）公司简介

众硅电子科技（上海）有限公司成立于 2022 年 2 月 14 日，公司注册资本为 500.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众硅电子科技（上海）有限公司实收资本 500.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00	500.00	100.00

### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为

348.62 万元，负债为 2,078.80 万元，净资产-1,730.17 万元。截至评估基准日，实现营业收入 116.10 万元，净利润-717.90 万元。

## 2、众恩芯科技（青岛）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼 102 室 2026-0562（A）

法定代表人：朱琳

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91370220MAC6AK4762

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （3）公司简介

众恩芯科技（青岛）有限公司成立于 2022 年 12 月 19 日，公司注册资本为 1,000.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司和朱琳共同发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00
2	朱琳	10.00	1.00
	合计	1,000.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众恩芯科技（青岛）有限公司实收资本 0.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
----	----	----------	-------	----------	---------------

1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	朱琳	10.00	1.00	0.00	0.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### （4）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 0.07 万元，负债为 0.20 万元，净资产为-0.13 万元。截至评估基准日，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.03 万元。

### 3、Sizone Technology (HK) Limited

公司类型：私人股份有限公司

公司地址：RM 1002, 10/F EASEY COMM, BLDG 253-261 HENNESSY RD, WAN CHAI, HONG KONG

成立日期：2021 年 8 月 4 日

#### （1）公司简介

Sizone Technology (HK) Limited 成立于 2021 年 8 月 4 日，公司注册资本为 1.00 万港元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万港元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00
合计		<b>1.00</b>	<b>100.00</b>

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，Sizone Technology (HK) Limited 实收资本 1.00 万港元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万港元）	注册比例%	实收资本（万港元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00	1.00	100.00
合计		<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>

#### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为

0.00 万元，负债为 0.00 万元，净资产为 0.00 万元。截至评估基准日，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.62 万元。

#### 4. 众进芯科技（福建）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：福建省晋江市福兴东路罗山段 3 号

法定代表人：刘李

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91350582MAD7GFQT8Q

经营范围：一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

##### （2）公司简介

众进芯科技（福建）有限公司成立于 2023 年 12 月 19 日，公司注册资本为 1,000.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众进芯科技（福建）有限公司实收资本 0.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00

2	刘李	10.00	1.00	0.00	0.00
合计		1,000.00	100.00	0.00	0.00

### (3) 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，该公司尚未建账，资产总额为 0.00，净资产为 0.00。

#### 评估过程及方法

对长期股权投资，首先对长期投资形成的原因、账面值和实际状况等进行了取证核实，并查阅了投资协议、股东会决议、章程和有关会计记录等，以确定长期投资的真实性和完整性。

对于全资及控股子公司，对被投资单位评估基准日的整体情况进行了评估，本次评估范围内的被投资单位，成立时间较短，其中众硅电子科技（上海）有限公司处于前期筹备阶段，本次采用账面值确定评估值；SIZONE TECHNOLOGY (HK) LIMITED 已全部实缴，但未实际运营，本次按 0 评估；众进芯科技（福建）有限公司和众恩芯科技（青岛）有限公司尚未实缴，本次采用账面值确定评估值。

#### 长期股权投资评估结果

按照上述方法，长期股权投资合计账面值 5,000,000.00 元，评估值 5,000,000.00 元，评估无增减值。具体评估结果如下：

长期股权投资评估结论表

单位：元

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	持股比例%	账面价值	评估价值
1	众硅电子科技（上海）有限公司	2022/2	长期	100%	5,000,000.00	5,000,000.00
2	众恩芯科技（青岛）有限公司	2022/12	长期	99%	10,521.88	-
3	Sizone Technology (HK) Limited	2021/8	长期	100%	-	-
4	众进芯科技（福建）有限公司	2023/12	长期	99%	-	-
合计					5,010,521.88	5,000,000.00
减：长期股权投资减值准备					10,521.88	-
净 额					5,000,000.00	5,000,000.00

### 三、固定资产-设备类资产评估技术说明

#### 1、评估范围

纳入本次评估范围的设备类资产为杭州众硅电子科技有限公司截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日申报的全部设备，评估基准日的账面值情况如下：

金额：人民币元

科目名称	账面价值	
	原值	净值
设备类合计	27,579,823.06	14,378,662.81
固定资产-机器设备	23,018,061.93	13,593,774.92
固定资产-车辆	843,690.26	326,869.95
固定资产-电子设备	3,718,070.87	458,017.95

#### 2、设备概况

机器设备：主要设备涉及膜厚仪、CDA 设备等大型设备，截至评估基准日，设备维护保养正常，设备运行良好。

车辆：车辆为企业自用车辆，截至评估基准日，汽车日常维护保养正常，能正常行驶。

电子设备：电子设备主要为电脑等办公用设备。维护保养较好，均能正常使用。

#### 3、评估过程

##### （1）资产核实

1) 为保证评估结果的准确性，根据企业设备资产的构成特点，指导该公司根据实际情况填写资产评估明细表，并以此作为评估的基础。

2) 针对资产评估明细表中不同的设备资产性质及特点，采取不同的核实方法进行实地考察。做到不重不漏，并对设备的实际运行状况进行认真观察和记录。

对金额较小、数量较多的小型设备，主要核对财务明细账、固定资产卡片，以抽查的方式对实物进行清查核实。

3) 根据现场实地勘察结果，进一步完善评估明细表，要求做到“表”、“实”相符。

4) 关注本次评估范围内设备的产权问题，如：抽查设备的购置合同；查阅固定资产明细账及相关财务凭证，了解设备账面原值构成情况。

## (2) 评定估算

根据评估目的确定价值类型、选择评估方法，开展市场询价工作，进行评定估算。

## (3) 评估汇总

对设备类资产评估的初步结果进行分析汇总，对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

## (4) 撰写评估技术说明

按资产评估准则的要求，编制“设备评估技术说明”。

## 4、评估方法

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用市场法和重置成本法进行评估。

### A. 市场法

机器设备评估值 = 市场价

### B. 重置成本法

#### (1) 重置全价的确定

##### ① 机器设备重置全价的确定

重置全价 = 设备购置价 + 运杂费 + 安装调试费 + 其它费用 + 资金成

## 本-可抵扣税费

### A.购置价

主要通过向设备生产厂家或销售公司询价或参照《2025 机电产品报价手册》等价格资料，以及参考近期同类设备的合同价格确定。对少数未能查询到购置价的设备，采用同年代、同类别设备的价格变动率推算确定购置价。

根据《中华人民共和国增值税法》(2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过)及《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)的相关规定，以及“财税〔2016〕36号”文件和“财税〔2018〕32号”文件《关于调整增值税税率的通知》对于符合增值税抵扣条件的项目，计算出可抵扣的增值税。

### B.运杂费

以含税购置价为基础，根据生产厂家与设备所在地间发生的装卸、运输、保管、保险及其他相关费用，按不同运杂费率计取，同时，根据相关文件规定抵扣率扣减应抵扣的增值税。购置价格中包含运输费用的不再计取运杂费。

### C.安装调试费

根据被评估设备辅助材料消耗、安装基础情况、安装的难易程度，参照《资产评估常用数据与参数手册》相关设备安装费率予以测算确认。对小型、无须安装的设备，不考虑安装工程费。

### D.工程建设其他费

参考国家有关政策和当地相关规定以及企业可行性研究报告以及竣工决算资料调整计取，主要包括建设单位管理费、工程监理费、环境评价费、可行性研究费、勘察设计费、招投标代理费、联合试运

转费等。

#### E.资金成本

资金成本为评估对象在合理建设工期（按整体工程考虑）内占用资金的筹资成本，计算公式如下：

资金成本 = (设备购置费 + 运杂费 + 安装工程费 + 其他费用) × 合理建设工期 × 贷款利率 × 1/2

贷款利率按照评估基准日执行的利率确定，资金在建设期内按均匀投入考虑。

#### ②运输车辆重置全价

根据当地汽车销售信息等近期车辆市场价格资料，确定运输车辆的现行含税购置价，在此基础上根据《中华人民共和国车辆购置税法》规定计入车辆购置税、新车上户牌照手续费等，对于符合增值税抵扣条件的企业，其车辆重置全价为：

重置全价 = 购置价 + 车辆购置税 + 牌照等杂费 - 可抵扣的增值税

a.车辆购置价：根据车辆市场信息及《太平洋汽车网汽车报价库》，《易车网》等近期车辆市场价格资料，参照车辆所在地同类车型最新交易的市场价格确定本次评估车辆购置价格；对购置时间较长，现不能查到原型号规格的车辆购置价格时参考相类似、同排量车辆价格作为评估车辆购置价参考价格。

b.车辆购置税：根据《中华人民共和国车辆购置税法》的有关规定：车辆购置税应纳税额 = 计税价格 × 10%。故：购置附加税 = 购置价 × 10%。

c.新车上户牌照手续费等：根据车辆所在地该类费用的内容及金额确定。

#### ③电子设备重置全价

评估范围内的电子设备价值量较小，不需要安装（或安装由销售商负责）以及运输费用较低，参照现行市场购置的价格确定。根据国家发布的税收优惠政策，企业购入的符合规定的固定资产所支付的增值税进项税可以抵扣（包括进口设备进口环节增值税），本次项目根据国家税收优惠政策采用不含税价格确定购置价。

重置全价计算公式：

重置全价 = 设备购置费（不含税）

## （2）成新率的确定

①机器设备及电子设备成新率：

按照设备的经济使用寿命、现场勘察情况预计设备尚可使用年限，并进而计算其成新率。其公式如下：

成新率 = 尚可使用年限 / 经济使用年限 × 100%

对价值量较小的一般设备则采用年限法确定其成新率。

②车辆成新率

对于运输车辆，根据《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号）的有关规定和车辆的平均经济使用年限，按以下方法确定成新率后取其较小者为最终成新率，即：

使用年限成新率 = (1 - 已使用年限 / 规定或经济使用年限) × 100%

行驶里程成新率 = (1 - 已行驶里程 / 规定行驶里程) × 100%

成新率 = Min（使用年限成新率，行驶里程成新率）

同时对待估车辆进行必要的勘察鉴定，若勘察鉴定结果与按上述方法确定的成新率相差较大，则进行适当的调整，若两者结果相当，则不进行调整。

## （3）评估值的确定

### ①机器设备、电子设备及车辆评估值

评估值 = 重置全价 × 成新率

对生产年代久远，已无同类型号的电子设备及停产停售的车辆则参照近期二手市场行情确定评估值。

## 5、评估结果及价值比较变动原因分析

### （1）评估结果

纳入本次评估范围的设备类资产评估结果详见下表：

名称	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
设备类合计	27,579,823.06	14,378,662.81	24,679,800.00	18,727,839.00	-10.52	30.25
固定资产-机器设备	23,018,061.93	13,593,774.92	22,253,800.00	17,359,903.00	-3.32	27.70
固定资产-车辆	843,690.26	326,869.95	684,100.00	535,283.00	-18.92	63.76
固定资产-电子设备	3,718,070.87	458,017.95	1,741,900.00	832,653.00	-53.15	81.79

具体评估结果详见“机器设备明细表”、“车辆评估明细表”、“电子设备评估明细表”。

### （2）评估值与账面价值比较变动原因分析

1) 造成机器设备评估原值减值的主要原因为部分设备购置时间较长近年来价格有所下降所致，评估净值增值主要系本次评估时采用的设备经济寿命年限比企业会计折旧年限长。

2) 车辆类资产受近年来车辆市场竞争降价影响，价格呈下降趋势造成车辆评估原值减值，评估时考虑的车辆经济寿命年限比企业会计折旧年限长是造成车辆评估净值增值的主要原因。

3) 电子设备更新较快是评估减值的主要原因，评估净值增值主要系本次评估时采用的设备经济寿命年限比企业会计折旧年限长。

## 6、评估案例

### 案例一：膜厚仪（机器设备明细表 序号：20）

启用日期：2021年8月

数量：1 台

账面原值：862,100.00 元

账面净值：152,304.32 元

### （1）重置全价确定

#### ①重置全价的计算

该膜厚仪重置全价由设备购置费、国内运杂费、安装调试费、其他费用和资金成本等部分构成，即

重置全价 = 设备购置费（不含税）+ 运杂费（不含税）+ 安装调试费（不含税）+ 其他费用（不含税）+ 资金成本

本次经销商报价已包含运杂费、安装调试费用及其他费用等，故单台膜厚仪重置全价为 1,141,300.00 元（含税）。

#### ②有关数据的说明

A.设备购置价：经通过厂商询价确定，该设备含税购置价为 1,141,300.00 元。（含税）

B.运杂费：经通过厂商询价，该设备运杂费已包含在设备报价中，故本次评估不再重复考虑。

C.安装费：经咨询设备厂商，该设备无需调试，本次评估安装费（不含税）为 0.00 元。

D.其他费：考虑设备无需安装，无其他费用。

E.资金成本：考虑设备无需建设安装，无资金成本。

#### F.重置全价

重置全价 = 设备购置费（不含税）+ 运杂费（不含税）+ 安装费（不含税）+ 其他费用（不含税）+ 资金成本

=1,010,000.00 元（取整）

#### ③成新率的确定

该设备于2021年8月购买并投入使用，至评估基准日已使用4.41年，通过现场勘察、查阅相关运行记录、检修记录等资料，并向设备管理及使用人员了解，对该设备企业坚持正常的维修保养制度，注重设备的安全性能，确定该设备尚可使用6年。

$$\begin{aligned}\text{成新率} &= \text{尚使用年限} \div (\text{已使用年限} + \text{尚使用年限}) \\ &= 6.00 \div (4.41 + 6.00) \\ &= 58\% (\text{取整})\end{aligned}$$

#### ④评估值的确定

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= \text{重置全价} \times \text{成新率} \times \text{数量} \\ &= 1,010,000.00 \times 58\% \times 1 \\ &= 585,800.00 \text{ 元} (\text{取整})\end{aligned}$$

### 案例二：奔驰车 V260L 长轴距豪华版 7 座 2022 款（车辆明细表序号 1）

#### （1）车辆基本概况

名称：奔驰车 V260L 长轴距豪华版 7 座 2022 款

生产厂家：福建奔驰汽车有限公司

购入日期：2023 年 07 月

启用日期：2023 年 08 月

牌照号码：浙 A670Q0

已行驶里程：101,554.00 公里

账面原值：551,752.21 元

账面净值：298,405.99 元

#### （2）重置全价的确定

车辆的重置全价由车辆购置价（不含税）、车辆购置附加税和新车上户牌照手续费等合理费用构成。

重置全价 = 购置价（不含税）+ 车辆购置附加税 + 新车上户牌照手续费

1) 购置价（含税）：经向汽车经销商咨询，该车的基准日市场销售价格为 478,800.00 元（含增值税）。

2) 车辆购置附加税：根据《财政部税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，取新车不含税价格的 10%。

3) 新车上户牌照手续费为 1,165.00 元。

4) 该车的重置全价

重置全价

$$= 478,800.00 / (1+13\%) + 478,800.00 / (1+13\%) \times 10\% + 1,165$$

$$= 467,300.00 \text{ 元（取整）}$$

(3) 成新率的确定

根据《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号）的有关规定和车辆的平均经济使用年限，按以下方法分别确定使用年限成新率和行驶里程成新率，取其较小者为该车的成新率，即

$$\text{使用年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} \div \text{规定或经济使用年限}) \times 100\%$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} \div \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

$$\text{成新率} = \text{Min}(\text{使用年限成新率}, \text{行驶里程成新率})$$

1) 行驶里程成新率

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} \div \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

该车已行驶里程为 101,554.00 公里，规定行驶里程 60 万公里，

则：

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - 101,554.00 \div 600,000) \times 100\%$$

$$= 83\% \text{（取整）}$$

## 2) 年限法成新率

$$\text{年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} \div \text{经济使用年限}) \times 100\%$$

该车经济使用年限为 15 年，2023 年 08 月投入使用，至评估基准日已使用 2.4 年，则：

$$\begin{aligned}\text{年限成新率} &= (1 - 2.4 \div 15) \times 100\% \\ &= 84\% (\text{取整})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3) \text{成新率} &= \text{Min} (\text{使用年限成新率}, \text{行驶里程成新率}) \\ &= 83\%\end{aligned}$$

对待估车辆进行了必要的勘察，未发现需调整的事项，故确定成新率为 83%。

## (4) 评估值的确定

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= \text{重置全价} \times \text{成新率} \\ &= 467,300.00 \times 83\% \\ &= 387,859.00 \text{ 元}\end{aligned}$$

## 案例三：笔记本电脑（电子设备明细表序号 530）

### (1) 设备概况

型号：T14

生产厂家：联想

购置日期：2025 年 10 月

启用日期：2025 年 10 月

账面原值：4,946.01 元

账面净值：4,671.23 元

### (2) 重置全价的确定

重置全价 = 购置价（不含税）

经市场调查及网上查询，该设备基准日含税售价为 5,500.00 元，

则重置全价为：

$$\begin{aligned}\text{重置全价} &= 5,500.00 / 1.13 \\ &= 4,900.00 \text{ 元（取整）}\end{aligned}$$

### （3）成新率的确定

该设备经济使用年限为 5 年，于 2025 年 10 月购置并启用，截至评估基准日已使用 0.2 年，尚可使用 5 年，故

$$\begin{aligned}\text{成新率} &= 5 / (0.2 + 5) \\ &= 96\% \text{（取整）}\end{aligned}$$

### （4）评估值的确定

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= \text{重置全价} \times \text{成新率} \\ &= 4,900.00 \times 96\% \\ &= 4,704.00 \text{ 元}\end{aligned}$$

## 四、使用权资产评估技术说明

使用权资产账面值为 10,396,497.77 元，为办公场所经营租赁产生的使用权资产。评估人员核对了企业总账、明细账、会计报表及清查评估明细表，审核了相关的原始凭证、租赁合同，对每项租赁资产的初始计量、摊销金额的准确性、合理性等进行了分析，符合租赁会计准则的核算规定，账面余额合理反映了基准日企业享有的相关使用权资产的权益价值，故本次评估值以核实后账面值确认评估值。

使用权资产评估值为 10,396,497.77 元。

## 五、无形资产-其他评估技术说明

### 评估范围

截至评估基准日，企业申报的账面记录的无形资产为 20 项外购

软件，账面未记录的无形资产共 353 项。其中已注册中国境内商标共计 68 项，已注册中国境外商标共计 53 项，注册中的商标 3 项，软件著作权 8 项，已获批准的中国境内专利权 106 项，其中 42 项为发明专利、53 项为实用新型专利、11 项为外观设计专利，已获批准的中国境外专利权 114 项，其中 89 项为发明专利、23 项为外观设计专利、2 项为实用新型专利，域名 1 项。具体情况详见“第一部分之（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况”。

### 评估过程

#### 第一阶段：准备阶段

对进入本次评估范围的其他无形资产的情况进行初步了解，提交评估准备资料清单和评估申报明细表，根据评估规划要求指导被评估单位填写《无形资产—其他无形资产评估明细表》。

#### 第二阶段：现场调查阶段

根据被评估单位填写的资产评估申报表，结合资产的主要特点，评估人员查阅了相关无形资产的相关资料。

#### 第三阶段：评定估算

### 评估方法

#### 1、专利及软件著作权

专利及软件著作权常用评估方法包括收益法、市场法和成本法。

市场法主要通过活跃在活跃的专利及软件著作权市场或资本市场上选择相同或相似的专利及软件著作权作为参照物，同时针对各种价值影响因素，如专利及软件著作权的功能进行类比，将被评估专利及软件著作权与参照物进行价格差异的比较调整，分析各项调整结果，从而确定专利及软件著作权的价值。使用市场法评估专利及软件著作权的必要前提包括：市场数据公开化程度较高；存在可比的专利技术；

参照物的价值影响因素明确且能够量化等。由于我国专利及软件著作权市场交易目前尚处初级阶段，类似专利及软件著作权的公平交易数据采集较为困难，市场法在本次评估应用中可操作性较差。

成本法通过分析重新开发出被评估专利及软件著作权所需花费的物化劳动来确定评估价值。企业合法取得专利及软件著作权过程中需支出的费用一般包括人工费用、调研咨询费、资产购置费、实验测试费、期间费用等，专利技术赋予企业的真实价值，与企业实际所支出费用之间通常对应关系较弱，故成本法评估通常适用于经营与收益之间不存在较稳定的对应关系，相应产品或服务价格市场性较弱的专利及软件著作权评估。本次评估的专利及软件著作权是被评估单位多年研究、实验的成果，在本次评估过程中，被评估单位向评估人员提供了其历史成本投入情况，因此可以采用成本法进行评估。

收益法以被评估专利及软件著作权未来所能创造的收益现值来确定评估价值，对专利及软件著作权等无形资产而言，其价值主要来源于直接变卖该等无形资产的收益，或者通过使用该等无形资产为其产品或服务注入技术加成而实现的超额收益。本次评估，国外半导体设备行业经过多年发展，市场集中度高、盈利模式成熟且稳定，龙头企业已形成较为稳定的现金流。而鉴于中国大陆半导体设备尤其是CMP（化学机械抛光设备）公司业务起步较晚，成熟度远低于国外，当前全球CMP行业被美国应用材料、日本荏原主导，两者市占率8成以上。

在国外对半导体核心技术封锁的背景下，被评估单位成立时间不长，部分产品仍处于客户验证阶段。此外叠加近年来下游半导体行业周期性的影响，难以对公司在可预见年限内预测其收益与风险水平。因此，本次不适宜采用收益法评估。

专利及软件著作权成本主要由其研制中投入的物化劳动，如消耗的专项原辅材料等资源、占用的仪器、设备和场所以及设计服务等费用；及其投入的相关劳动费用，如研制开发人员的工资、劳务和福利费用等费用所构成。专利及软件著作权所占用的研发费用至少应达到同行业的平均收益率才能够体现其使用价值。专利及软件著作权因更新换代等因素被新的技术代替，将导致其技术的技术性贬值。

专利及软件著作权的评估模型为：

$$A=B \times (1-Q)$$

A：专利及软件著作权评估值

B：研发费用与研发费用投资回报之和

Q：技术的贬值率

$$Q = \text{技术已使用年限} / (\text{技术已使用年限} + \text{预计尚可使用时间})$$

## 2、商标

纳入本次评估范围内的账外无形资产商标权，申请注册相对简单，均对企业收入贡献不大，不直接产生收益故采用成本法评估，依据商标权无形资产形成过程中所需投入的各种成本费用的重置价值确认商标权价值，其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2+C_3$$

式中：

P：评估值

C<sub>1</sub>：设计成本

C<sub>2</sub>：注册费用（包括注册代理费）及其他成本

C<sub>3</sub>：维护使用成本

## 3、域名

对于域名，本次纳入评估范围的域名并不包含客户 / 用户资源等

作为获取收入的主要因素，网站建设还需要通过其他的系统/资源来支持，且本次评估仅考虑域名本身价值不考虑转让前运营建设投入、用户资源、网页设计投入，注册时的费用基本反映其价值，故对于申请注册的域名采用成本法进行评估。

经核实域名注册过程中的合理支出，按其合理支出确定评估值。其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2$$

式中：

P：评估值

C<sub>1</sub>：注册域名 1 年要花费的注册费用

C<sub>2</sub>：域名注册 1 年后到终止日所花费的费用

#### 4、外购软件

对于外购软件，评估人员查阅相关的证明资料并查阅了原始合同，了解原始入账价值的构成，摊销的方法和期限，查阅了原始合同。经核实表明账、表金额相符。通过向软件供应商询价或网络查询其现行不含税价格确定评估值。

### 评估案例

#### 1、专利及软件著作权（其他无形资产评估明细表序号 21-389）

##### （1）重置成本的确定

专利重置成本的构成内容包括合理的成本、利润和相关税费等，在确定专利重置成本时，应当合理确定形成专利及软件著作权所需的研发人员工资、物料消耗等成本以及其他相关成本费用。

##### 1) 项目申报研发成本情况

本次评估过程中，根据现场尽职调查情况以及评估师与相关人员的沟通，委托人对相关专利及软件著作权的研制成本进行独立核算，

提供了历史成本的资料，研发成本的基本构成情况，经委托人确认后研发投入内容如下：

### 研发成本明细汇总

单位：万元

项目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
人工成本	232.89	784.64	952.07	1,723.39	2,493.58	3,813.52	5,302.39	5,359.33	20,661.82
直接投入	581.57	995.65	1,223.47	938.09	2,980.04	1,849.55	2,718.34	5,498.57	16,785.28
折旧费	4.72	42.62	37.94	48.90	75.61	139.59	337.09	433.57	1,120.04
<b>汇总</b>	<b>819.19</b>	<b>1,822.91</b>	<b>2,213.47</b>	<b>2,710.39</b>	<b>5,549.23</b>	<b>5,802.66</b>	<b>8,357.82</b>	<b>11,291.48</b>	<b>38,567.15</b>

剥离与专利及软件著作权无关的研发投入，包括已终止的项目、已完成但对应产品已被市场淘汰的项目、研发费用中与专利及软件著作权无直接相关的费用，剥离后与专利及软件著作权直接相关的研发投入内容后明细如下：

### 研发成本明细汇总

单位：万元

项目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
人工成本	3.90	486.74	952.07	1,626.41	1,984.72	3,689.64	5,299.97	5,359.33	19,402.79
直接投入	5.74	330.96	1,223.47	820.58	2,550.69	1,706.24	2,703.53	5,498.57	14,839.77
折旧费	1.24	34.57	37.94	45.82	56.55	131.04	337.01	433.57	1,077.75
<b>汇总</b>	<b>10.89</b>	<b>852.27</b>	<b>2,213.47</b>	<b>2,492.81</b>	<b>4,591.96</b>	<b>5,526.92</b>	<b>8,340.51</b>	<b>11,291.48</b>	<b>35,320.31</b>

## 2) 申报成本的调整

### ①对于人工费的调整

人工费主要包括相关人员的工资、社保四金和津贴，委估资产主要的成本投入时间为2019年至2025年，根据企业所在地区人工该期间人均可支配收入及国内薪酬情况，从2019年至2025年杭州市人均可支配收入以及距专利及软件著作权研发年度的增幅情况如下：

年度	人均可支配收入	增幅
2025年	80,017.00	
2024年	76,777.00	104%
2023年	73,797.00	108%
2022年	70,281.00	114%

2021年	67,709.00	118%
2020年	61,879.00	129%
2019年	59,261.00	135%
2018年	54,348.00	147%

计入重置成本的人工费合计为 20,958.94 万元。

#### ②对于直接投入费用和其他费用的调整

研发过程中所产生的直接投入费用和其他费用主要是研发所需要的物料费以及所产生的差旅费用等，均与物价关系比较密切，本次按照我国各年的 CPI 指数的增长确认，近年国内 CPI 增幅情况如下：

年度	CPI	增幅
2025年	709.42	100.00%
2024年	709.42	100.00%
2023年	708.00	100.20%
2022年	706.60	100.40%
2021年	692.70	102.41%
2020年	686.50	103.34%
2019年	669.80	105.91%
2018年	650.90	108.99%

则项目计入重置成本的项目直接投入费用为 14,934.09 万元。

#### ③对于折旧费的调整

企业的折旧费用为项研发中所需设备折旧，经 CPI 调整后，金额为 1,082.76 万元。

经过以上差异的调整，企业的直接投入成本合计为 36,975.79 万元。

#### ④资金投入的机会成本

研发专利及软件著作权发生的相关支出需要相应的投资回报，其回报可采用同类行业的投入资本回报率进行计算。经同花顺 iFinD 查询，可比公司 2023 年-2024 年的平均投入资本回报率为 10.43%。

则按照投入资本回报率计算，机会成本为 3,855.76 万元。

#### ⑤专利及软件著作权的重置成本

根据上述计算，则专利及软件著作权的重置成本为

$$36,975.79+3,855.76=40,831.55 \text{ 万元}$$

### （2）技术贬值率的确定

根据《资产评估执业准则——知识产权》的相关规定，评估师在采用成本法对专利及软件著作权进行评估时，需考虑专利及软件著作权贬值因素，即需要考虑技术的陈旧率。

根据研发项目以及对应的项目情况，预计研发投入的使用年限在10年左右，按照各年度的成本投入情况加权确认，截至基准日已使用2.27年，同时与企业进行沟通，考虑目前市场情况及应用技术的水平，确认预计尚可使用年限为7.73年。

$$\begin{aligned} Q &= \text{技术已使用年限} / (\text{技术已使用年限} + \text{预计尚可使用时间}) \\ &= 2.27 / (2.27 + 7.73) \times 100\% \\ &= 22.66\% \end{aligned}$$

### （3）评估结果的确定

根据  $A=B \times (1-Q)$  评估模型计算：

$$A=40,831.55 \times (1-22.66\%)=31,579.00 \text{ 万元（取整）}$$

即得出专利及软件著作权评估结果为31,579.00万元（取整）。

## 2、商标

纳入本次评估范围内的账外无形资产商标权，申请注册相对简单，均对企业收入贡献不大，不直接产生收益故采用成本法评估。依据商标权无形资产形成过程中所需投入的各种成本费用的重置价值确认商标权价值，其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2+C_3$$

式中：

P：评估值

C<sub>1</sub>: 设计成本

C<sub>2</sub>: 注册费用（包括注册代理费）及其他成本

C<sub>3</sub>: 维护使用成本

### 案例：第 69474158 号商标（无形资产明细表 序号 249）

评估模型中各项参数的确定

#### （1）设计成本：

据咨询了解此类商标通过设计公司设计，根据市场询价，被评估商标的设计成本为 2,688.00 元。

#### （2）注册费用（包括注册代理费）及其他成本

根据《中华人民共和国商标法》规定，注册商标使用期为十年，目前国内普通商标注册费为 300.00 元，注册代理费通过商标注册公司询价为 810.00 元。

即注册费用（包括注册代理费）及其他成本=1,110.00 元/件

#### （3）维护使用成本

根据评估师的经验，一般普通商标的年维护成本较低，本次评估未考虑维护成本。

#### 商标权重置价值计算

注册号	第 69474158 号
设计成本	2,688.00
注册费用（包括注册代理费）及其他成本	1,110.00
维护使用成本	0.00
重置成本合计	3,798.00

通过评估计算，得出第 69474158 号商标的评估值为 3,798.00 元。

### 3、域名

本次纳入评估范围的域名并不包含客户 / 用户资源等作为获取收入的主要因素，网站建设还需要通过其他的系统 / 资源来支持，且本次评估仅考虑域名本身价值不考虑转让前运营建设投入、用户资源、

网页设计投入，注册时的费用基本反映其价值，故对于申请注册的域名采用成本法进行评估。

经核实域名注册过程中的合理支出，按其合理支出确定评估值。其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2$$

式中：

P：评估值

C<sub>1</sub>：注册域名 1 年要花费的注册费用

C<sub>2</sub>：域名注册 1 年后到终止日所花费的费用

**案例：域名 sizonetech.com（无形资产明细表 序号 528）**

该域名注册日期为 2018 年 11 月 7 日，域名到期日为 2032 年 11 月 7 日，申请年限为 14 年，根据评估人员调查了解，注册该域名费用为 55 元，续费 1 年，费用为 69 元。因此，

$$\begin{aligned} \text{评估值} &= \text{注册成本} + \text{续费成本} \\ &= 55.00 + 69.00 \times 13 \\ &= 952.00 \text{（元）} \end{aligned}$$

#### 4、外购软件

对于外购软件，评估人员查阅相关的证明资料并查阅了原始合同，了解原始入账价值的构成，摊销的方法和期限，查阅了原始合同。经核实表明账、表金额相符。通过向软件供应商询价或网络查询其现行不含税确定评估值。

**案例：中望 3D 软件（无形资产明细表序号 1）**

序号	名称	取得日期	法定/预计使用年限	所有权人
1	中望 CAD 软件	2025/08	/	杭州众硅

企业上述软件为外购软件，市场价可查询，故采用成本法评估。

根据评估人员调查了解，该外购软件市场含税价为 250,000.00 元，所得税率为 6%。

评估值 = 不含税价 =  $250,000.00 \div 1.06 = 235,800.00$ （元，取整）

### 无形资产评估结果

评估范围内的无形资产账面值为 290,941.67 元，评估值 319,053,576.00 元，评估增值 318,762,634.33 元，增值原因主要为账面未记录的软件著作权、专利及软件著作权对企业经营能够产生一定影响，具有使用价值，本次评估按照成本法测算其价值导致无形资产评估增值。

## 六、长期待摊费用评估技术说明

长期待摊费用账面价值为 1,948,800.87 元，主要为厂房装修及消防工程费用。在核对明细账与总账、报表余额是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录。在核实无误的基础上，按照基准日尚存在的剩余资产或权益作为评估值。

长期待摊费用评估价值为 1,948,800.87 元。

## 七、其他非流动资产评估技术说明

其他非流动资产账面值为 30,596,712.33 元，主要为大额存单及利息。评估人员在对其他非流动资产核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额，以核实后账面值作为评估值。

其他非流动资产评估值 30,596,712.33 元。

## 八、负债评估技术说明

评估范围内的负债包括流动负债和非流动负债，流动负债包括短期借款、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债；非流动负债为租赁负债、预计负债、递延收益和其他非流动负债，本次评估在经清查核实的账面值基础上进行。

## 流动负债

### 1、短期借款

短期借款账面值为 150,119,328.92 元，主要为期限在 1 年以内的借款及计提的利息。

评估人员查阅了各笔短期借款的借款合同及相关担保合同、贷款对账单、评估基准日最近一期的结息证明等，逐笔核对了借款金额、借款利率和借款期限。短期借款以核实无误后的账面价值确定为评估值。

短期借款评估值为 150,119,328.92 元。

### 2、应付账款

应付账款账面值 46,761,407.50 元，主要为应付的采购材料款。

评估人员核对了账簿记录、抽查了部分原始凭证及合同等相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，以核查核实后的账面值作为评估值。

应付账款评估值为 46,761,407.50 元。

### 3、合同负债

合同负债账面值 20,374,095.50 元，主要为销售的产品货款，评估人员抽查有关账簿记录和供货合同，确定款项的真实性和完整性，核实结果账表单金额相符，均为在未来应支付相应的权益或资产，故以核查核实后账面值确定为评估值。

合同负债评估值 20,374,095.50 元。

#### 4、应付职工薪酬

应付职工薪酬账面值 14,723,543.72 元，主要为应付的职工工资等。评估人员核实了应付职工薪酬的提取及使用情况，按核实后的账面值确定为评估值。

应付职工薪酬评估值为 14,723,543.72 元。

#### 5、应交税费

应交税费账面值为 1,026,583.82 元，主要为应的交增值税、应交个人所得税等，通过对企业账簿、纳税申报表的查证，证实企业税额计算的正确性，按核实后的账面值确定为评估值。

应交税费评估值为 1,026,583.82 元。

#### 6、其他应付款

其他应付款账面值为 7,118,996.59 元，主要为应付的差旅费等。该款项多为近期发生，滚动余额，基准日后需全部支付，按核实后的账面值确定为评估值。

其他应付款评估值为 7,118,996.59 元。

#### 7、一年内到期的非流动负债

一年到期非流动负债账面值 3,352,319.01 元，为长期租赁核算的租赁负债一年内到期部分。评估人员核查了房屋租赁合同等资料，核实了交易事项的真实性、业务内容和金额等，以核查核实后的账面值作为评估值。

一年到期非流动负债评估值为 3,352,319.01 元。

#### 8、其他流动负债

其他流动负债账面值为 11,902,087.37 元，主要为保证金等。评估人员核实了账簿记录、抽查了部分原始凭证及纳税申报表等相关资料，

核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，以核实后的账面值确定为评估值。

其他流动负债评估值为 11,902,087.37 元。

## 非流动负债

### 1、租赁负债

租赁负债账面值为 6,937,956.23 元，主要为办公场所经营租赁产生的租赁负债。

评估人员核对了相关租赁合同、抽查了部分原始凭证及合同等相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，以核查核实后的账面值作为评估值。

租赁负债评估值为 6,937,956.23 元。

### 2、预计负债

预计负债账面价值 1,656,770.47 元，主要为质保金。

本次评估在核实预计负债的内容和金额基础上，以核查核实后的账面值作为评估值。

预计负债评估值为 1,656,770.47 元。

### 3、递延收益

递延收益账面价值 239,654.85 元，主要为补助。

截至评估基准日时点，账面递延收益补助项目主要为博士后工作站，评估人员核对了账簿记录、抽查了部分原始凭证等相关资料，递延收益对应的补贴项目尚未完成验收程序，本次评估按照核实后账面值确认评估值。

递延收益评估价值为 239,654.85 元。

### 4、其他非流动负债

其他非流动负债账面值为 3,340,000.00 元，主要为政府补助等。

评估人员核对了账簿记录、抽查了部分原始凭证等相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，以核实后的账面值确定为评估值。

其他非流动负债评估值为 3,340,000.00 元。

## 第五部分 市场法评估说明

### 一、评估假设

#### 一般假设

##### 1、交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

##### 2、公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

##### 3、企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。对于企业的各类经营性资产而言，能够按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用。

#### 特殊假设

1、本次评估假设国家政策、经济环境、房地产本身的状况等因素不发生重大变化，委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整，本次评估不考虑通货膨胀因素的影响；

2、企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

3、被评估单位在未来经营期内管理团队尽职尽责,核心人员保持稳定而不发生重大变化，并继续按照现有的经营管理模式持续经营；

4、本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；

5、本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

6、本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响；

7、可比企业与被评估单位在价值影响因素方面相同或者相似；

8、可比企业与被评估单位均能够按交易时公开披露的经营模式、业务架构、资本结构持续经营；

9、可比上市公司所涉及的交易均为有序市场环境下的公平交易，交易对价公允有效。可比上市公司信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏；

10、评估人员仅基于公开披露的可比企业相关信息选择对比维度及指标，不考虑其他非公开事项对被评估单位价值的影响。

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

## 二、市场法简介

### 概述

根据《资产评估执业准则—企业价值》，企业价值评估中的市场法，是指将被评估单位与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定被评估单位价值的评估方法。

#### 1、市场法的应用前提

运用市场法评估企业价值需要满足如下基本前提条件：

（1）要有一个充分发展、活跃的、公开的市场，在这个市场上成交价格基本上反映市场买卖双方的行情，因此可以排除个别交易的偶然性。

（2）在这个公开市场上要有可比的企业及其交易活动，且交易活动应能较好反映企业价值的趋势。企业及其交易的可比性是指选择的可比企业及其交易活动是在近期公开市场上已经发生过的，且与待评估的目标企业及其即将发生的业务活动相似。

（3）参照物与被评估单位的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

## 2、市场法选择的理由和依据

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

被评估单位主营业务为高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备的研发、制造和销售。由于该行业具有一定技术壁垒，导致行业内同行业公司相对较少且交易活跃度较低、交易案例数量有限，近年来公开披露的已完成或正在进行中的交易案例较少，交易细节及被并购企业的详细信息难以收集掌握，因此本次未采用交易案例比较法进行估算。

当前证券市场存在较多经营正常稳定、主营业务及产品与被评估

单位相似的上市公司，故综合考量后，本次采用上市公司比较法进行估算。

### 评估思路

在充分了解并掌握被评估单位企业性质、业务类型、经营模式、发展阶段、企业规模、财务状况等基本情况的基础上，按以下思路开展市场法评估：

#### 1、选择可比企业

搜集可比企业信息，通过比较分析筛选出适当数量的可比企业。本次采用上市公司比较法，筛选原则包括：属于同一行业，或者受相同经济因素影响；交易市场相同或可比；有一定时间的上市交易历史，并且近期股票价格没有异动；业务结构、经营模式等方面相近或相似等。

#### 2、计算价值比率

根据资本市场数据，对被评估单位与可比公司所处行业的价值影响因素（价值因子）进行线性回归分析，并结合行业及企业特点，选择相对合适的价值比率。

根据可比企业于评估基准日的市值（比准市值）及价值因子，计算可比企业价值比率。

#### 3、计算评估价值

根据被评估单位价值比率、价值因子，同时考虑价值比率数据口径，对非经营性资产（负债）、流动性因素进行调整，得出被评估单位股东全部权益价值。

### 评估模型

本次评估采用上市公司比较法，基本模型为：

$$E=EV+C-D-M$$

E: 股东全部权益价值;

EV: 企业价值;

C: 现金等价物;

D: 付息债务;

M: 少数股东权益。

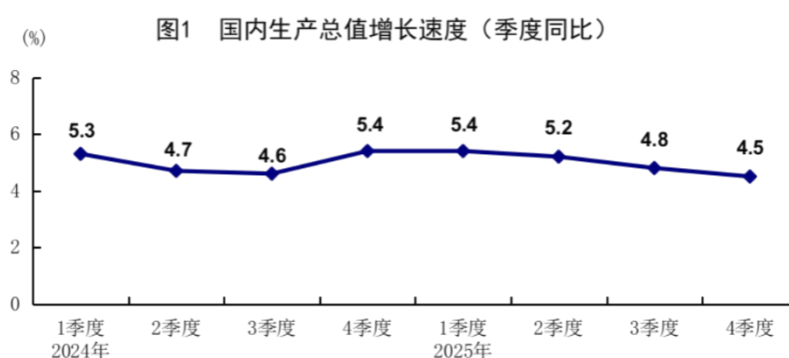
其中:

EV=可比公司比准价值比率 × 被评估单价值因子

### 三、行业发展前景与经营分析

#### 宏观经济概况

初步核算，2025年全年国内生产总值1,401,879亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值93,347亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值499,653亿元，增长4.5%；第三产业增加值808,879亿元，增长5.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.4%，二季度增长5.2%，三季度增长4.8%，四季度增长4.5%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.2%。



数据来源：国家统计局

#### 1、粮食增产丰收，畜牧业稳定增长

2025年全年全国粮食总产量71,488万吨，比上年增加838万吨，增长1.2%。其中，夏粮产量14,975万吨，下降0.1%；早稻产量2,851万吨，

增长1.2%；秋粮产量53,662万吨，增长1.5%。分品种看，小麦产量14,007万吨，基本持平；玉米产量30,124万吨，增长2.1%；稻谷产量20,904万吨，增长0.7%；大豆产量2,091万吨，增长1.3%。全年猪牛羊禽肉产量10,072万吨，比上年增长4.2%，首次超过1亿吨。其中，猪肉产量5,938万吨，增长4.1%；牛肉产量801万吨，增长2.8%；羊肉产量496万吨，下降4.2%；禽肉产量2,837万吨，增长6.7%。牛奶产量4,091万吨，增长0.3%；禽蛋产量3,498万吨，下降2.5%。全年生猪出栏71973万头，增长2.4%；年末生猪存栏42,967万头，增长0.5%。

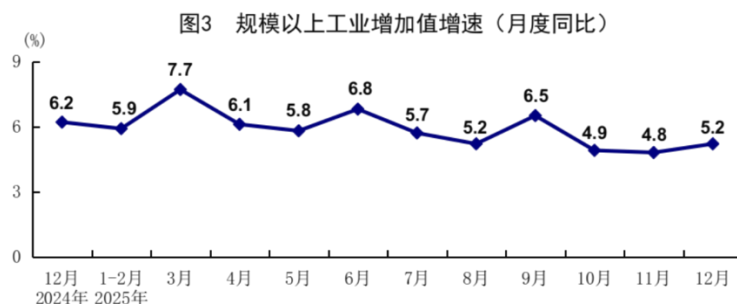


数据来源：国家统计局

## 2、工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势较好

2025年全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%。分三大门类看，采矿业增加值增长5.6%，制造业增长6.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.3%。装备制造业增加值增长9.2%，高技术制造业增加值增长9.4%，增速分别快于规模以上工业3.3、3.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.6%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.3%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量分别增长52.5%、28.0%、25.1%。12月份，规模以上工业增加值同比增长5.2%，环比增长0.49%。12月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.9个百分点；企业生产经营活动预期指数为55.5%，上升2.4个百分点。1—11月份，全

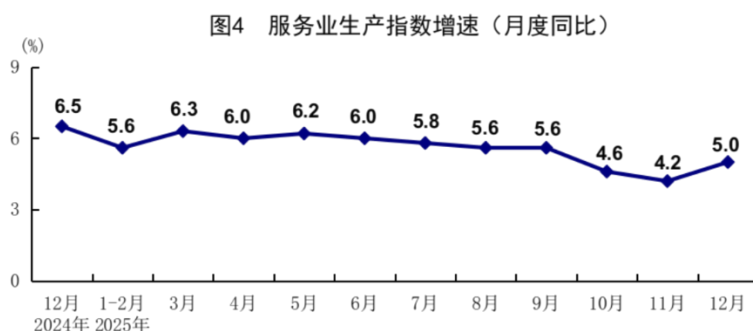
国规模以上工业企业实现利润总额66,269亿元，同比增长0.1%。



数据来源：国家统计局

### 3、服务业平稳增长，现代服务业发展良好

2025年全年服务业增加值比上年增长5.4%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，住宿和餐饮业增加值分别增长11.1%、10.3%、5.2%、5.0%、4.9%。12月份，服务业生产指数同比增长5.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业生产指数分别增长14.8%、11.3%、6.5%。1—11月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.8%。12月份，服务业商务活动指数为49.7%，比上月上升0.2个百分点；服务业业务活动预期指数为56.4%，上升0.5个百分点。其中，电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间。

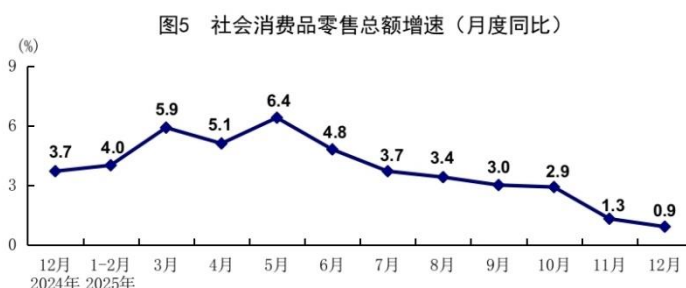


数据来源：国家统计局

### 4、市场销售规模扩大，服务零售较快增长

2025年全年社会消费品零售总额501,202亿元，比上年增长3.7%。

按经营单位所在地分，城镇消费品零售额432,972亿元，增长3.6%；乡村消费品零售额68,230亿元，增长4.1%。按消费类型分，商品零售额443,220亿元，增长3.8%；餐饮收入57,982亿元，增长3.2%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，全年限额以上单位通讯器材类、文化办公用品类、体育娱乐用品类、家用电器和音像器材类、粮油食品类商品零售额分别增长20.9%、17.3%、15.7%、11.0%、9.3%。全国网上零售额159,722亿元，比上年增长8.6%。其中，实物商品网上零售额130,923亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为26.1%。12月份，社会消费品零售总额同比增长0.9%，环比下降0.12%。全年服务零售额比上年增长5.5%。其中，文体休闲服务类、通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、交通出行服务类零售额较快增长。

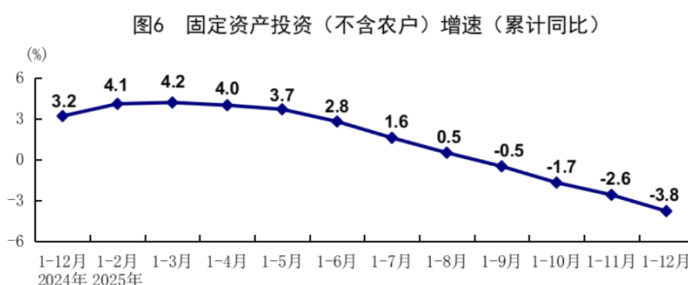


数据来源：国家统计局

## 5、固定资产投资同比下降，制造业投资保持增长

2025年全年全国固定资产投资（不含农户）485,186亿元，比上年下降3.8%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资下降0.5%。分领域看，基础设施投资下降2.2%，制造业投资增长0.6%，房地产开发投资下降17.2%。全国新建商品房销售面积88,101万平方米，下降8.7%；新建商品房销售额83,937亿元，下降12.6%。分产业看，第一产业投资增长2.3%，第二产业投资增长2.5%，第三产业投资下降7.4%。民间投资下降6.4%；扣除房地产开发投资，民间投资下降1.9%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业投资分别增长28.4%、

16.9%。12月份，固定资产投资（不含农户）环比下降1.13%。



数据来源：国家统计局

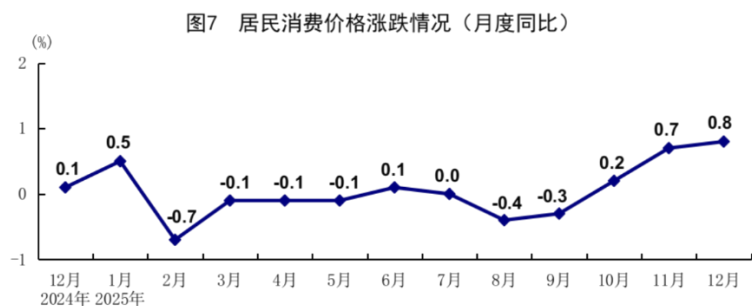
## 6、货物进出口稳定增长，贸易结构持续优化

2025年全年货物进出口总额454,687亿元，比上年增长3.8%。其中，出口269,892亿元，增长6.1%；进口184,795亿元，增长0.5%。民营企业进出口增长7.1%，占进出口总额的比重为57.3%，比上年提高1.8个百分点。对共建“一带一路”国家进出口增长6.3%，占进出口总额的比重为51.9%。高技术产品出口增长13.2%。12月份，货物进出口总额42,630亿元，同比增长4.9%。其中，出口25,359亿元，增长5.2%；进口17,271亿元，增长4.4%。

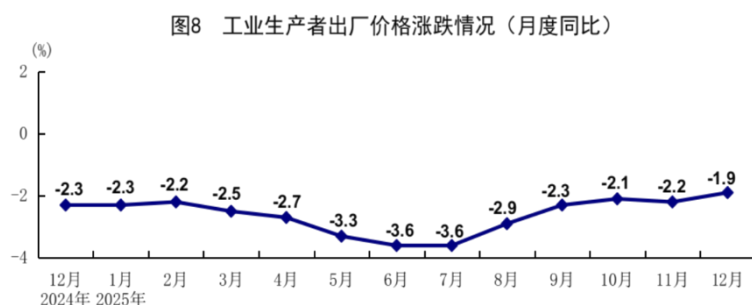
## 7、居民消费价格总体平稳，核心CPI温和回升

2025年全年居民消费价格（CPI）与上年持平。分类别看，食品烟酒价格下降0.7%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.9%，交通通信价格下降2.6%，教育文化娱乐价格上涨0.8%，医疗保健价格上涨0.8%，其他用品及服务价格上涨9.3%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降6.1%，鲜菜价格下降3.9%，粮食价格下降1.0%，鲜果价格上涨1.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.7%，涨幅比上年扩大0.2个百分点。12月份，居民消费价格同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.2%。全年工业生产者出厂价格比上年下降2.6%；12月份同比下降1.9%，环比上涨0.2%。

全年工业生产者购进价格比上年下降3.0%；12月份同比下降2.1%，环比上涨0.4%。



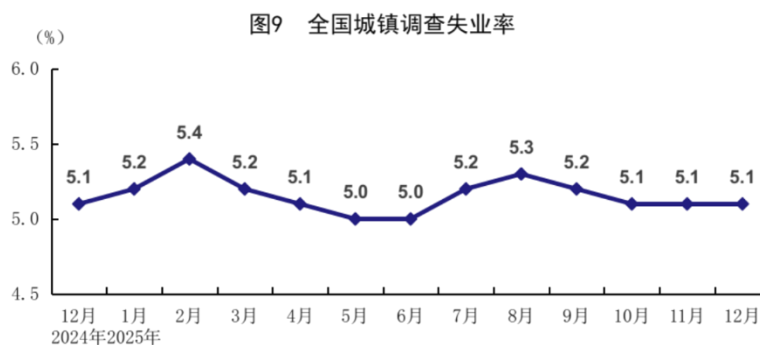
数据来源：国家统计局



数据来源：国家统计局

## 8、就业形势总体稳定，城镇调查失业率平稳

2025年全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。全年农民工总量30,115万人，比上年增长142万人，增长0.5%。其中，本地农民工12,109万人，增长0.1%；外出农民工18,006万人，增长0.8%。



数据来源：国家统计局

### 9、居民收入持续增长，农村居民收入增速快于城镇

2025年全年全国居民人均可支配收入43,377元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长5.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入56,502元，比上年名义增长4.3%，实际增长4.2%；农村居民人均可支配收入24,456元，比上年名义增长5.8%，实际增长6.0%。全国居民人均可支配收入中位数36,231元，比上年名义增长4.4%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入10,150元，中间偏下收入组22,702元，中间收入组35,536元，中间偏上收入组55,586元，高收入组103,778元。2025年全年全国居民人均消费支出29,476元，比上年名义增长4.4%，扣除价格因素实际增长4.4%。全国居民人均食品烟酒消费支出占人均消费支出的比重（恩格尔系数）为29.3%，比上年下降0.5个百分点；全国居民人均服务性消费支出增长4.5%，占人均消费支出的比重为46.1%，与上年持平。

### 10、人口总量有所减少，城镇化率继续提高

2025年年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）140,489万人，比上年末减少339万人。全年出生人口792万人，人口出生率为5.63‰；死亡人口1,131万人，人口死亡率为8.04‰；人口自然增长率为-2.41‰。从性别构成看，男性人口71685万人，女性

人口68,804万人，总人口性别比为104.19（以女性为100）。从年龄构成看，16—59岁人口85136万人，占全国人口的比重为60.6%；60岁及以上人口32,338万人，占全国人口的23.0%，其中65岁及以上人口22,365万人，占全国人口的15.9%。从城乡构成看，城镇常住人口95,380万人，比上年末增加1,030万人；乡村常住人口45,109万人，减少1,369万人；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为67.89%，比上年末提高0.89个百分点。从受教育程度看，16—59岁人口平均受教育年限达到11.3年，比上年提高0.1年。

总的来看，2025年国民经济顶住多重压力保持稳中有进发展态势，高质量发展取得新成效。但也要看到，外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，经济发展中老问题、新挑战仍然不少。

## 行业发展现状及前景分析

### 1、半导体设备行业概况

半导体设备泛指用于生产各类半导体产品所需的生产设备，属于半导体行业产业链的支撑环节，作为支撑芯片设计、制造、封测全产业链运转的核心生产载体，半导体设备承担着电路图案转移、材料刻蚀、薄膜沉积、性能检测等关键工序的实施功能。由于半导体设计、制造和封装测试等环节需在设备技术允许的范围内进行，设备的技术进步将推动半导体产业的发展。根据摩尔定律演进，每隔18-24个月芯片性能将提升一倍，而每更新一代工艺制程，则需更新一代更为先进的制程设备，随着制程推进和工艺升级，单位产能下设备需求将进一步增加，制程和工艺升级推动芯片复杂度提升，更复杂的结构则需要更多的制造工序完成，各类设备的用量显著增加。

依据工艺环节差异，半导体设备可分为前道工艺设备（对应晶圆制造环节）与后道工艺设备（对应封装测试环节）两大类，两类设备

在功能定位与细分品类上各有侧重。

前道工艺设备是晶圆制造环节的核心装备，主要涵盖光刻、干法刻蚀、掺杂、薄膜沉积、平坦化、热处理、湿法清洗、量测检测及工厂辅助设备九大品类，细分品种合计约190种。晶圆制造核心工艺步骤对应专用设备如下：

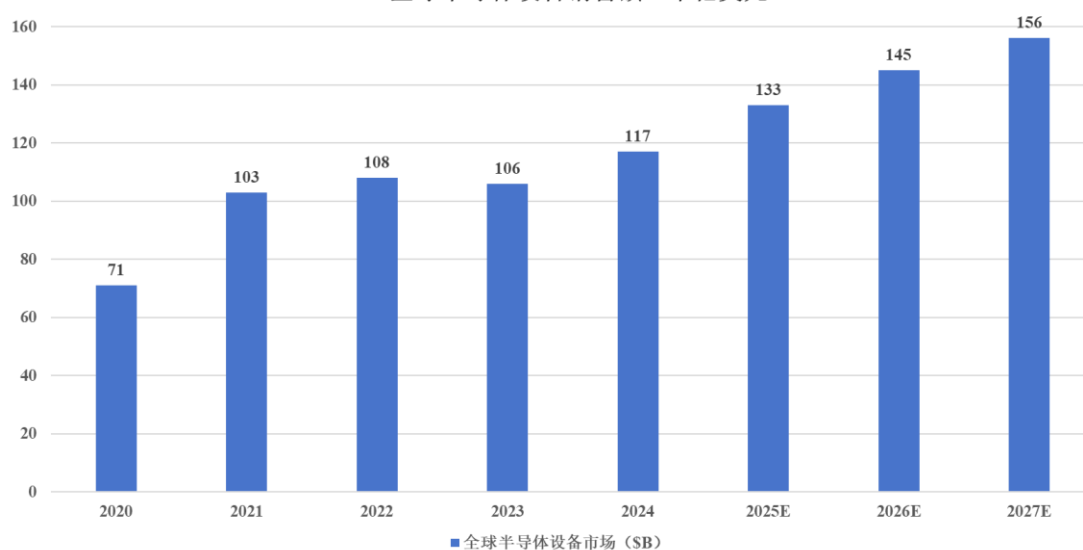


而后道工艺设备聚焦封装测试环节，核心功能是完成晶圆切割、芯片封装及性能检测，主要包括减薄设备、划切设备、测试机、分选机等细分品类，其稳定性直接影响芯片成品良率与最终性能验证效率。

半导体产业链除半导体设计领域外，其他领域均需要半导体设备厂商提供相应的设备产品以满足生产需要。除了少数公司在半导体设备产品线布局较广外，绝大部分设备厂商专注生产单一品类的半导体设备，标的公司即属于专注于研制CMP设备的专业型半导体设备企业。

根据SEMI报告显示，预计2025年全球半导体制造设备总销售额将达到1,330亿美元，同比增长13.7%。预计未来两年半导体制造设备销售额将持续增长，2026年和2027年分别达到1,450亿美元和1,560亿美元。这一增长主要得益于人工智能相关投资的推动，尤其是在尖端逻辑电路、存储器以及先进封装技术的应用方面。

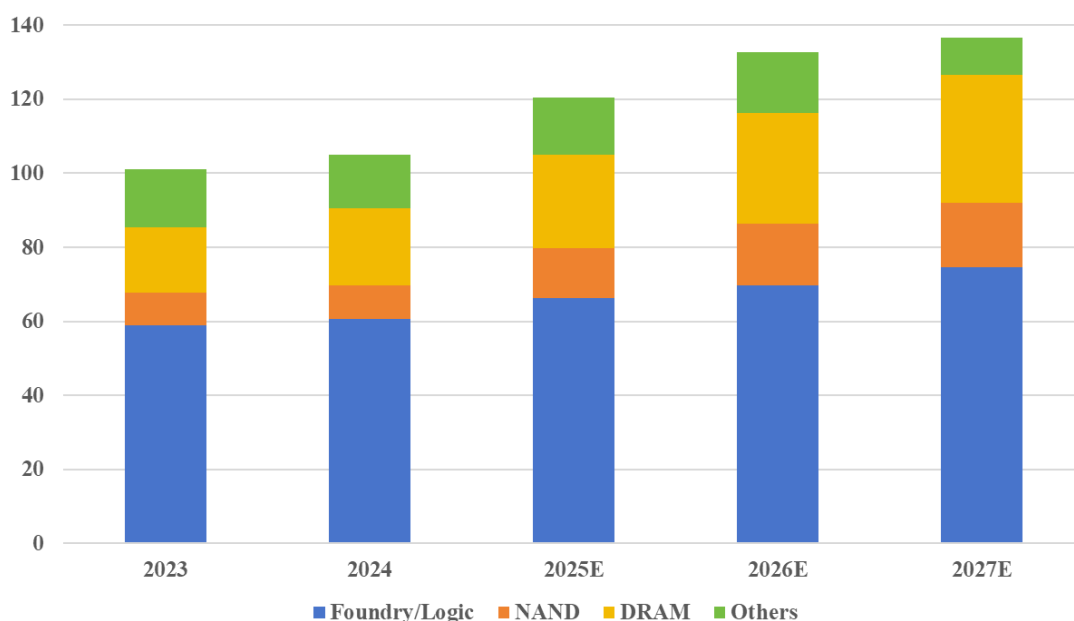
2020-2027E全球半导体设备销售额（十亿美元）



数据来源：SEMI, 2025 Year-End Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective

此外，由于先进制程节点的持续增长，预计到2025年，晶圆代工和逻辑应用领域的晶圆厂设备（WFE）销售额将同比增长9.8%，规模达666亿美元。随着芯片制造商增加人工智能加速器、高性能计算和高端移动处理器的产能，预计该领域在2026年将增长5.5%，并在2027年增长6.9%，达到752亿美元。而NAND闪存设备市场受3DNAND堆叠技术的进步以及领先层和主流层产能的扩张，预计在2025年增长45.4%至140亿美元，并在2026年进一步增长12.7%至157亿美元，2027年增长7.3%至169亿美元。DRAM设备销售额则受存储器供应商提高HBM产能并升级到更先进的工艺节点，以满足人工智能和数据中心的需求影响，预计在2025年增长15.4%至225亿美元，随后在2026年和2027年分别同比增长15.1%和7.8%。

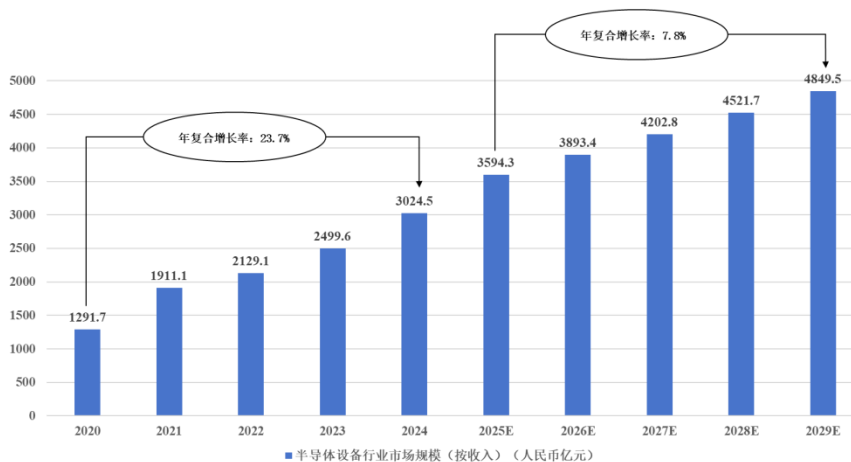
2023-2027E按应用领域划分的晶圆制造设备销售（十亿美元）



数据来源：SEMI, 2025 Year-End Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective

根据Frost & Sullivan数据显示，得益于国内晶圆厂扩产潮短期内迅速拉动市场对半导体设备的需求，2020年至2024年间中国半导体设备市场以23.7%的年复合增长率增长，于2024年达到3,024.5亿元。预计未来五年，5G、物联网、人工智能等领域的技术浪潮有望催生半导体及半导体设备产业的新一轮成长，促使中国半导体设备市场规模在2025到2029年间以7.8%的年复合增长率增长，于2029年达到4,849.5亿元。

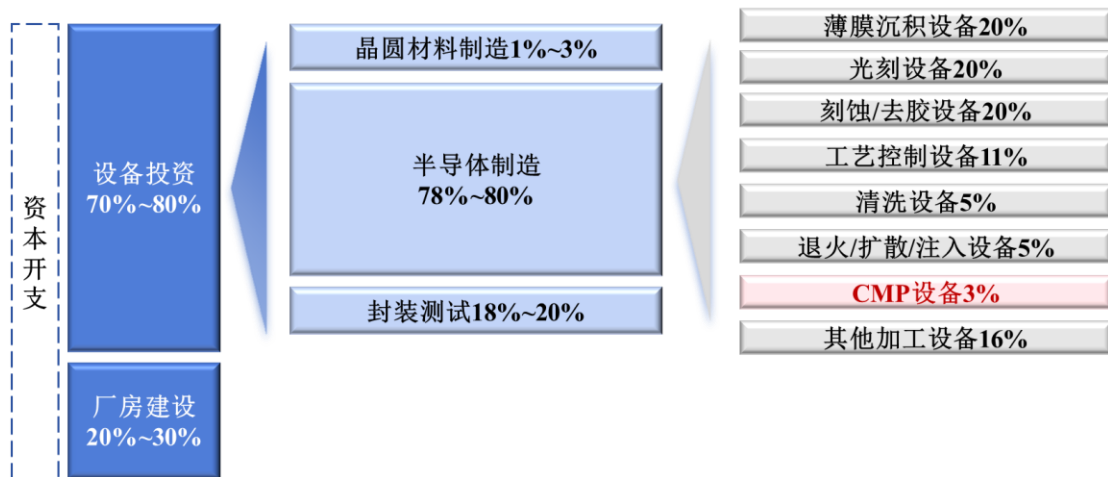
2020-2029E中国半导体设备行业市场规模（按收入）



数据来源：Frost & Sullivan

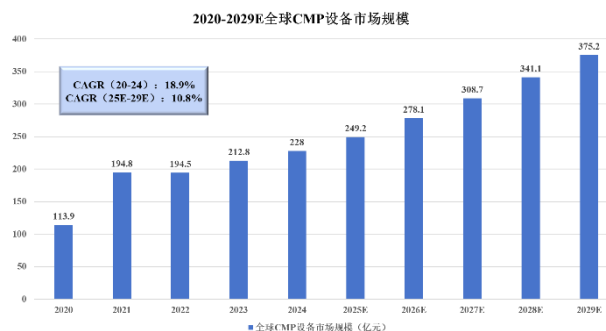
## 2、化学机械抛光（CMP）设备行业概况

化学机械抛光（CMP）是实现晶圆全局平坦化的关键工艺，指的是通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用，实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化，是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键制程工艺。根据Gartner统计数据，集成电路制造设备投资一般占集成电路制造领域资本性支出的70%-80%，且随着工艺制程的提升，设备投资占比也将相应提高，当集成电路制程达到16及14纳米时，设备投资占比可达85%。CMP设备价值量约占半导体设备投资额的3%左右，具体如下图所示：



数据来源：Gartner

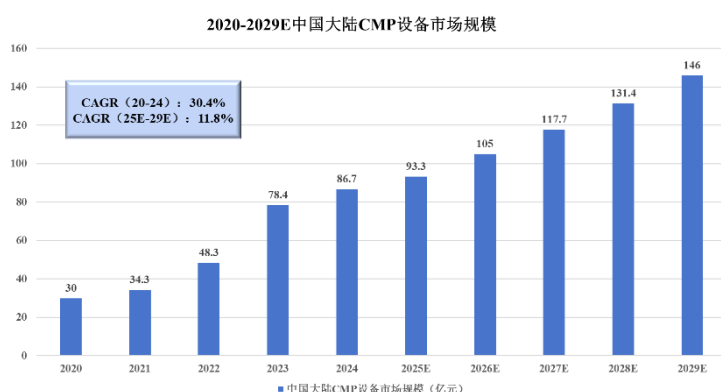
按销售额口径统计，全球CMP设备市场规模从2020年的113.9亿元增长到2024年的228.0亿元，年复合增长率18.9%。未来全球CMP设备市场规模预计将从2025年的249.2亿元增长为2029年的375.2亿元，期间年复合增长率为10.8%。



数据来源：Frost & Sullivan

全球CMP设备市场处于高度垄断状态。根据Gartner数据，全球CMP设备市场主要由美国应用材料和日本荏原占据，全球市场占有率超90%，尤其在14nm以下先进制程工艺产线上使用的CMP设备主要由美国应用材料和日本荏原两家国际巨头提供。此外国外还存在KC Tech、东京精密等规模较小的CMP设备企业。而中国大陆绝大部分高端CMP设备仍然依赖于进口，具备较为广阔的国产化空间。

中国大陆作为全球最大的半导体设备市场，CMP设备需求旺盛，增速高于全球增速。2020-2024年中国大陆CMP设备市场规模复合年增长率达30.4%。未来随着工艺技术进步，CMP设备在整体生产链条中的使用频次将进一步增加，对应市场规模有望逐步提升。据测算，到2029年中国大陆CMP设备市场规模预计将达到146亿元。



数据来源：Frost & Sullivan

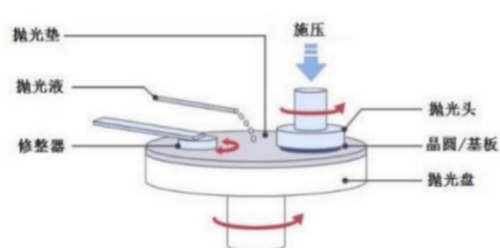
### 3、化学机械抛光（CMP）设备行业技术特征

CMP工艺水平直接决定了芯片制造的良率与性能表现。每一层电路结构的形成都需要通过CMP工艺实现表面平整化处理，这是保证后续光刻、刻蚀及薄膜沉积等工艺正常进行的基础条件。

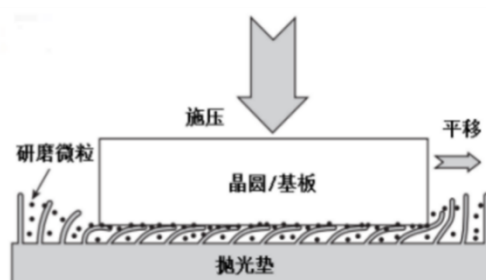
CMP抛光过程可以分为化学过程和物理过程。化学过程指：研磨液中化学成分与硅片表面材料产生化学反应，通过将不溶物转化为易溶物或软化高硬度物质，生成比较容易去除的物质。物理过程指：研

磨液中的磨粒与硅片表面材料发生机械物理摩擦，从硅片表面去除这些化学反应物，溶入流动的液体中带走。区别于传统的纯机械或纯化学的抛光方法，CMP通过化学的和机械的综合作用，最大程度减少较硬材料与较软材料在材料去除速率上的差异，也有效避免了由单纯机械抛光造成的表面损伤和由单纯化学抛光易造成的抛光速度慢、表面平整度和抛光一致性差等缺点。

CMP抛光模块示意图



CMP抛光作业原理图



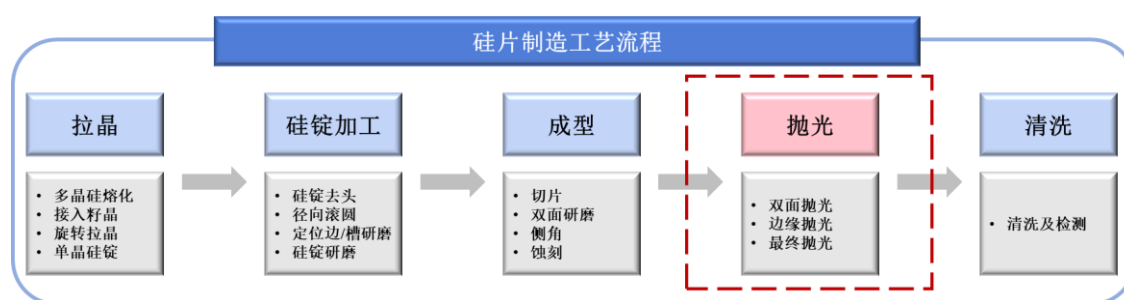
数据来源：华海清科招股书，方正证券研究所

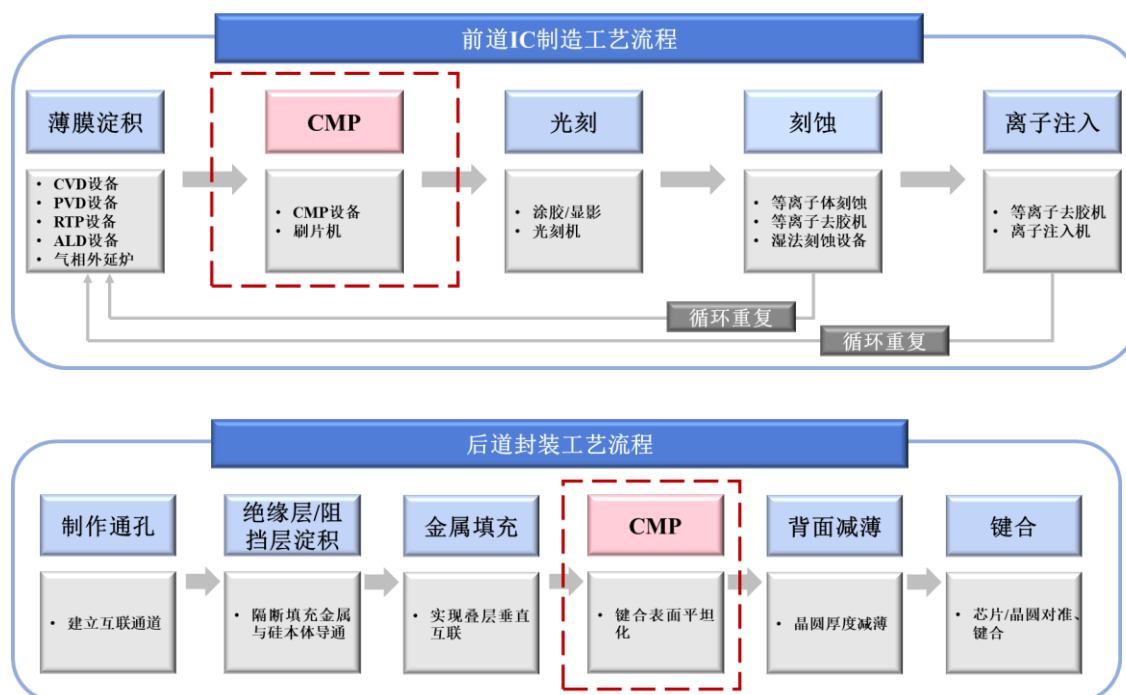
CMP设备主要由抛光单元、清洗单元和晶圆传输单元三大模块组成，其中，（1）抛光单元包括抛光头、抛光盘、抛光垫、修整器、抛光液供应系统、终点检测系统等；（2）清洗单元一般包括兆声清洗模组、刷洗模组及干燥模组等；（3）晶圆传输单元主要包括前端模组、晶圆传输手等，前端模组将晶圆搬运至机台内进行加工。CMP设备在较长时间内并不存在明显技术迭代周期，相比成熟制程，先进制程对应设备并无明显结构差异，仅是特定模块技术的不断优化。

半导体CMP设备分类方式多样，按被抛光材料及晶圆尺寸分类示意如下图所示：

按被抛光材料分类				按晶圆尺寸分类		
衬底抛光	金属层抛光	介质层抛光	其他材料抛光	8英寸CMP设备	12英寸CMP设备	6/8英寸兼容CMP设备
包括硅材料、蓝宝石、化合物半导体（如砷化镓、氮化镓）等	包括铝（Al）、铜（Cu）金属互连层，以及钽（Ta）、钛（Ti）、氮化钛（TiN）等扩散阻挡层、粘附层	包括二氧化硅（SiO <sub>2</sub> ）、硼磷硅玻璃（BPSG）、磷硅玻璃（PSG）等层间介质（ILD），以及氮化硅（Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ）、氮氧化硅（SiO <sub>x</sub> N <sub>y</sub> ）等钝化层、阻挡层	包括ITO（铟锡氧化物）等透明导电薄膜材料	适用于成熟制程（如28nm及以上）的晶圆加工	面向先进制程（如14nm及以下）的大尺寸晶圆，技术门槛更高，目前主要由AMAT、EBARA垄断	灵活支持多种尺寸晶圆，满足多元化生产需求

在应用领域方面，CMP工艺是实现晶圆表面平坦化的关键工艺，贯穿硅片制造、IC制造、封测等环节。（1）硅片制造环节：在抛光工艺流程中，在完成拉晶、硅锭加工、切片成型环节后，在抛光环节，为最终得到平整洁净的抛光片需要通过CMP设备及工艺实现；（2）前道IC制造环节：芯片制造过程按照技术分工主要可分为薄膜淀积、CMP、光刻、刻蚀、离子注入等工艺环节，CMP设备在其中承担了晶圆抛光的作用，并且循环重复多次。当前IC元件普遍采用多层立体布线，在IC前道制造中，只有CMP工艺才能实现晶圆纳米级全局平坦化，并且可以兼顾局部平坦化；（3）后道封装环节：在先进封装领域，CMP工艺也被越来越多使用，其中硅通孔（TSV）、扇出（Fan-Out）、2.5D转接板（Interposer）、3D IC等均需要用到CMP工艺。

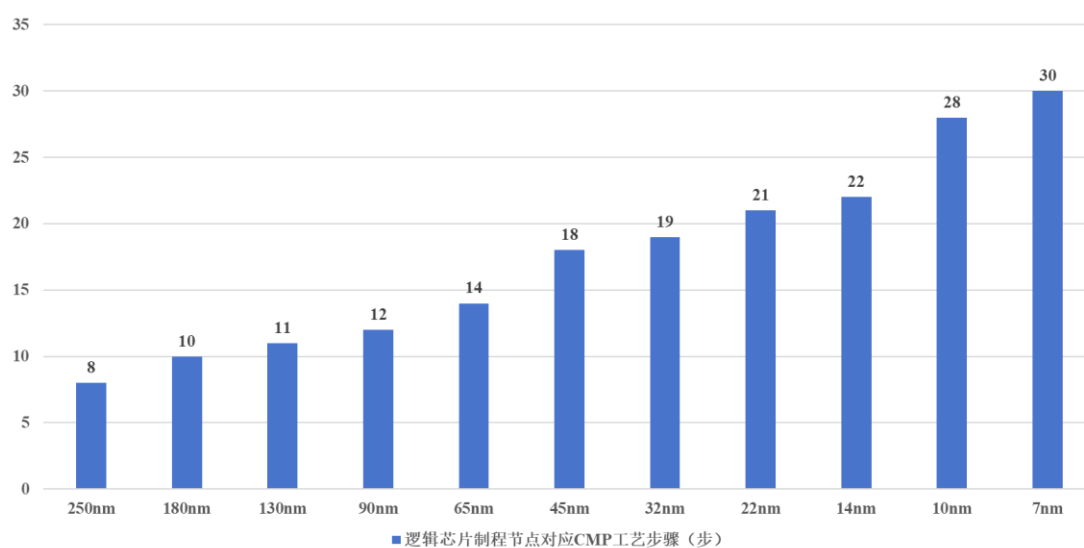




#### 4、化学机械抛光和化学机械平坦化（CMP）设备行业发展趋势

CMP设备需求量随产线工艺的进步而增大。随着超大规模集成电路制造的线宽不断细小化而产生对平坦化的更高要求，CMP在先进工艺制程中具有不可替代且愈发重要的作用。随着摩尔定律的延续，当制造工艺不断向先进制程节点发展时对CMP技术的要求相应提高、步骤也会不断增加，以逻辑芯片为例，65nm制程芯片需经历约12道CMP步骤，而制程节点发展至7nm以下时，芯片制造过程中CMP的应用在最初的氧化硅CMP和钨CMP基础上新增了包含氮化硅CMP、鳍式多晶硅CMP、钨金属栅极CMP等先进CMP技术，所需的抛光步骤也增加至30余步。随着CMP设备在整体生产链条中的使用频次增加，投资规模在半导体设备行业的占比也将逐步提升。同时，12英寸晶圆产线所需CMP设备数量也高于8英寸产线。根据Cabot Microelectronics数据，制程从180nm进步到7nm过程中，所需CMP工艺步骤从10步提升至30步。

逻辑芯片制程节点对应CMP工艺步骤



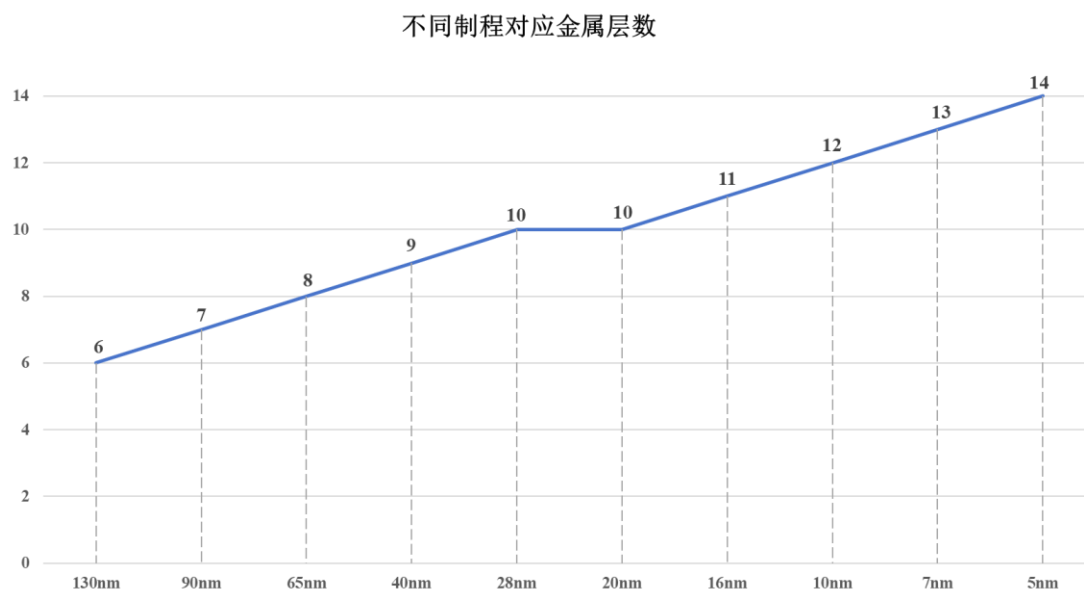
数据来源：Cabot Microelectronics

随着芯片制程向3nm以下演进，CMP设备需满足超低压力抛光（ $<0.5\text{psi}$ ）、原子级平坦化（ $\text{TTV}<0.5\text{nm}$ ）等需求，推动企业加大研发投入。

此外，为实现芯片垂直空间的有效利用，多层金属化技术被应用到集成电路制造工艺中。随着各种工艺层被刻蚀成图形，晶圆表面变得高低起伏，导致晶圆表面呈现出不同的反射性质，难以达到良好的解析度同时电路电阻值增高，稳定性下降。因此，在多层布线的立体结构集成电路中，如何实现整片平坦化成为重要技术发展方向之一。化学机械抛光（CMP）技术依靠其优秀的全局平坦化能力、广泛的适用性、以及低成本特点逐渐成为晶圆制造和加工过程中的主流平坦化技术。随着集成电路技术发展，芯片集成度增加，CMP设备的重要性和在产业链条中的投资占比也逐步增加，从而带动CMP设备市场的发展。

随着各电路层中薄膜厚度逐渐减薄，在同样空间内能够沉积的薄膜层数也相应增多，需要的CMP抛光次数也增多。以TSMC为例，90nm需要7层金属层，28nm需要10层金属层，在5nm节点，金属层数提高

到14层。



数据来源：IC Knowledge，招商证券

另外，随着芯片制程的缩减、晶圆尺寸的增长以及芯片内部结构的日趋复杂，半导体制造环节对于CMP设备的平坦化效果、控制精度、系统集成度要求越来越高，CMP设备将向高精密化与高集成化方向发展。且随着半导体工业对芯片性能要求的不断提高，对晶圆表面的平整度、均匀性和缺陷控制的要求也越来越严格。CMP技术将不断向抛光头分区精细化、工艺控制智能化、清洗单元多能量组合化、预防性维护精益化等方向发展。

### （1）抛光头分区精细化

为提高集成度，逻辑芯片特征线宽已经降到10nm以下；存储芯片的堆叠层数也从64层发展到128层以上。芯片集成度的提升对抛光的均匀性提出更高要求，全局均匀性的控制要求从几十纳米提高到几纳米。为满足抛光均匀性的要求，需要将抛光头设置更加合理、精细的分区，并配合智能算法解决多分区相互耦合的问题，大幅提升抛光头压力控制精度。

### （2）工艺控制智能化

智能化CMP是一个受多因素影响的工艺过程，抛光盘的转动、承载头的转动、修整器的摆动、承载头各分区的载荷、保持环压力、抛光垫磨损、抛光液供给、抛光液温度等因素的微小变化都会影响抛光结果。在人工智能和大数据的助推下，CMP设备可以引入智能算法，构建智能控制模型，提升CMP设备的智能化工艺控制水平，减少耗材等因素的影响，提高工艺一致性与产品良率。同时，智能化还有助于实现远程监控和操作，为设备管理和维护提供便利。CMP设备智能化是行业发展的重要方向，也是行业内企业提升核心竞争力的关键所在。

### （3）清洗单元多能量组合化

当特征尺寸降至14nm以下后，线宽不断接近物理基础尺寸，纳米级的颗粒污染都有可能对芯片的性能和可靠性产生重要影响。随着互连线宽特征尺寸的不断减小，对表面污染物残留的控制更加严苛。CMP设备中的清洗单元需综合考虑兆声震动、机械柔性刷洗、表面张力等多种能量，并采取科学合理组合，同时借助科学的化学清洗剂形成有效的保护和辅助，提高清洗效果。

### （4）预防性维护精益化

CMP设备通过配置部件状态监测装置，可以实时监控易损易耗部件，如保持环、抛光垫、清洗刷等的使用状态。根据人工智能和大数据技术，智能预测易损易耗部件的更换周期。在保证部件使用性能的前提下，尽可能延长其使用寿命，控制设备的预防性维护成本。另一方面，通过结构设计或引入新材料，实现更换后的易损易耗部件快速进入良好的工作状态，即缩短耗材部件的磨合时间，降低生产成本。

## 被评估单位经营情况分析

杭州众硅电子科技有限公司是一家高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备公司，为半导体行业及其他高科技领域提供优质技术和

高效服务。公司的使命是促进全球芯片生产制造工艺技术的发展，集聚了国内外高端人才，拥有强大的专业技术研发团队，旨在为全世界芯片生产厂商提供一流的化学机械平坦化抛光（CMP）设备，为他们提供先进技术和高效的服务，帮助芯片生产厂商解决技术难题。

公司主要从事高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备及周边产品的研发与生产，主要产品包括众硅TTAIS®150CMP、TTAIS®200CMP、众硅TTAIS®300 CMP、单模组CMP系统、抛光液供液系统（SDS）、ECMP等产品，以及相关产品的技术服务。公司的核心竞争力如下：

### 1、聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，在CMP后清洗技术、终点检测控制技术、APC智能控制技术、CMP工艺应用等核心领域实现重大创新突破并完全自主可控。公司是国内少数能够自主创新制造12英寸CMP设备的企业，其设备采用6抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备4盘或3盘的架构模式。6抛光盘的设计不仅可同时支持3盘工艺或2盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅大幅降低设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了公司在CMP设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

### 2、汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

公司创始团队来自浙江大学、南京大学等国内外知名高校，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，公司组建了一支兼具国际视野与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

### 3、公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，公司自主研发并生产的 CMP 设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

### 4、设备核心模块自研实现自主可控

CMP设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。公司已实现了诸如抛光头、旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研大幅降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产CMP设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂

降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

## 四、市场法评估过程

### 选取可比企业

#### 1、可比企业的选择过程

被评估单位主营业务是抛光设备，根据证监会行业分类属于半导体设备。经WIND金融数据终端查询，半导体设备与材料行业A股上市公司共计49家。本次评估以该行业上市公司作为可比公司筛选基础，首先剔除股价异动及ST案例，其次剔除规模差异较大的公司，再次分析可比公司与标的业务的可比性，剔除如半导体材料等非半导体设备生产的上市公司，最后剔除近期存在并购重组等重大事项的上市公司。

经筛选后，对初步筛选的5家上市公司进一步核查其上市历史、近期股票价格异动情况、经营可比性及初步规模可比性，经核查，筛选剩余的近期股票价格没有异动、经营情况与被评估单位近似且规模与被评估单位相对可比。故将其作为本次市场法评估的可比公司。如下表：

可比上市公司一览表

金额单位：人民币万元

序号	证券代码	可比公司	企业价值
1	688037.SH	芯源微	2,980,686.29
2	688729.SH	屹唐股份	7,123,919.35
3	688072.SH	拓荆科技	9,413,998.69
4	688082.SH	盛美上海	8,041,312.97
5	688120.SH	华海清科	5,094,730.39

企业价值EV=区间日均总市值（区间日均总市值2025-12-31前一周）+少数股东权益+付息债务- 现金及流动性金融资产

#### 2、可比公司简介

可比上市公司主要产品及业务、主营产品名称以及近年主要财务

情况如下：

(1) 公司简介

序号	证券代码	可比公司	主要产品及业务	主营产品名称
1	688082.SH	盛美上海	主要从事半导体专用设备的研发,生产和销售,主要产品包括半导体清洗设备,半导体电镀设备和先进封装湿法设备等.	SAPS 单片清洗设备、TEBO 单片清洗设备、半导体电镀设备、半导体清洗设备、槽式清洗设备、单片背面清洗设备、单片槽式组合清洗设备、单片清洗设备、后道先进封装电镀设备、立式炉管设备、前道刷洗设备、前道铜互连电镀设备、去胶设备、湿法刻蚀设备、涂胶设备、无应力抛光设备、先进封装湿法设备、先进封装刷洗设备、显影设备
2	688072.SH	拓荆科技	主要产品为半导体薄膜沉积设备包括 PECVD 设备,ALD 设备及 SACVD 设备三个系列.主要从事高端半导体专用设备的研发,生产,销售和技术服务.	12 英寸 HTM PECVD 设备 NF-300H、12 英寸 ALD 设备 FT-300H、12 英寸 PEALD 设备 FT-300T、12 英寸 PECVD 设备 PF-300T、12 英寸 PECVD 设备 PF-300T eX、12 英寸 SACVD 设备 SA-300T、12 英寸 Thermal-ALD 设备 FT-300T、8 英寸 PECVD 设备 PF-200T、8 英寸 SACVD 设备 SA-200T、HDPCVD 系列产品、PE-ALD（等离子体增强原子层沉积）产品、PECVD 产品、SACVD 系列产品、TFLITE、Thermal-ALD（热处理原子层沉积）产品、UV Cure 产品、超高深宽比沟槽填充 CVD 系列产品、键合套准精度量测产品（Bonding Metrology）、晶圆对晶圆键合（Wafer to Wafer Bonding）产品、芯片对晶圆键合表面预处理（Die to Wafer Bonding Preparation and Activation）产品
3	688037.SH	芯源微	半导体专用设备的研发,生产和销售	喷胶机、清洗机（集成电路制造后道先进封装）、清洗机（集成电路制造前道晶圆加工）、去胶机、湿法刻蚀机、涂胶/显影机、涂胶/显影机（集成电路制造后道先进封装）、涂胶/显影机（集成电路制造前道晶圆加工）
4	688729.SH	屹唐股份	主营业务是集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发,生产和销售;主要产品是为集成电路制造企业提供干法去胶设备,快速热处理设备,干法刻蚀设备,并提供备品备件及相关服务	Helios®系列快速热处理设备、Hydrilis®HMR 高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备、Millios®闪光毫秒级退火设备、Novyka®系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备、paradigmE®系列等离子体刻蚀设备、Suprema®系列干法去胶设备
5	688120.SH	华海清科	主要从事半导体专用设备的研发,生产,销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备.	CMP 设备、Universal-200、Universal-200Plus、Universal-300、Universal-300Dual、Universal-300Plus、Universal-300T、Universal-300X、Versatile-GP300、配套材料及技术服务

(2) 财务数据（单位：人民币万元）

截至本次评估报告日，盛美上海已披露2025年年报，其余可比公司最新披露的财务数据为2025年三季报，具体如下：

1) 芯源微（688037.SH）

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	430,155.56	559,687.32	625,898.70
总负债	191,858.93	277,709.68	342,798.11
归母净资产	238,044.03	269,112.74	270,633.47
净资产	238,296.63	281,977.65	283,100.59
项目	2023年度	2024年度	2025年1-9月
收入	171,696.99	175,360.60	99,026.65
利润总额	28,243.12	22,506.25	-2,354.12
归母净利润	25,062.62	20,281.20	-1,004.92
净利润	25,015.23	20,142.63	-2,621.03

2) 屹唐股份（688729.SH）

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	834,107.59	995,291.53	1,164,136.61
总负债	299,793.34	403,819.21	284,976.44
归母净资产	534,314.25	591,472.32	879,160.17
净资产	534,314.25	591,472.32	879,160.17
项目	2023年度	2024年度	2025年1-9月
收入	393,142.70	463,297.78	379,634.30
利润总额	26,482.29	51,235.02	51,497.57
归母净利润	30,941.93	54,080.21	51,562.93
净利润	30,941.93	54,080.21	51,562.93

3) 拓荆科技（688072.SH）

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	996,934.53	1,531,416.61	1,890,718.79
总负债	537,770.24	1,001,509.58	1,280,462.68
归母净资产	459,386.04	528,015.44	609,713.86
净资产	459,164.29	529,907.03	610,256.11
项目	2023年度	2024年度	2025年1-9月
收入	270,497.40	410,345.39	422,010.94
利润总额	72,891.26	67,859.92	53,376.56
归母净利润	66,258.38	68,815.47	55,650.54
净利润	66,387.45	68,742.19	53,552.48

#### 4) 盛美上海 (688082.SH)

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日
总资产	975,379.77	1,212,845.24	1,889,489.47
总负债	329,553.20	446,281.66	542,404.92
归母净资产	645,826.57	766,563.51	1,346,959.03
净资产	645,826.57	766,563.58	1,347,084.55
项目	2023年度	2024年度	2025年度
收入	388,834.27	561,774.04	678,617.02
利润总额	96,381.48	130,066.90	145,667.90
归母净利润	91,052.20	115,318.81	139,592.95
净利润	91,052.20	115,318.87	139,544.21

#### 5) 华海清科 (688120.SH)

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	911,735.96	1,175,082.16	1,251,333.35
总负债	359,962.37	527,051.15	531,117.70
归母净资产	551,773.60	647,307.33	720,215.66
净资产	551,773.60	648,031.01	720,215.66
项目	2023年度	2024年度	2025年1-9月
收入	250,799.11	340,622.86	319,379.55
利润总额	78,983.47	111,828.80	86,879.78
归母净利润	72,374.66	102,340.79	79,142.28
净利润	72,374.66	102,340.79	79,142.28

### 计算价值比率

#### 1、选择价值比率

价值比率是指以价值或价格作为分子，以与其密切相关的指标（财务数据或非财务指标）作为分母的比率。价值比率通常包括盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率。

常用的价值比率包括：市净率（P/B），指股权价值与净资产的比值。该指标在一定程度上反映了企业既往的投资规模、资本积累与估值的相关性，对于资产量较大的企业，该指标更为适用；市盈率（P/E），指每股市价与每股盈利的比值。一般较适用于盈利相对稳定、周期性较弱的行业；市销率（EV/S）是企业价值与营业收入的比。

该比率适用于投资者更注重收入的行业以及部分新兴的行业。

为进一步判断不同价值比率对被评估单位所属行业的适用性，我们对该行业上市公司（不包含 ST 股票、北交所上市股票及 B 股）市价与净利润、净资产、营业收入、息税折旧摊销前利润之间的相关性进行回归分析。回归分析结果如下表所示：

线性回归分析结果表

因变量	P			EV	
	B	E	S	S	EBITDA
自变量					
相关系数	0.6619	0.7134	0.9633	0.9438	0.2854
拟合优度 R <sup>2</sup>	0.4381	0.5090	0.9279	0.8908	0.0815
观测值	5	5	5	5	5
价值比率	P/B	P/E	P/S	EV/S	EV/EBITDA

由上表可知，自变量 S 与因变量企业价值 EV 以及市值的相关系数较高，拟合优度较高。

同时根据杭州众硅目前经营现状，公司在基准日时点处于亏损状态，因此无法采用盈利价值比率，且由于公司属于轻资产企业，采用资产指标难以衡量企业真实价值。

随着近几年的发展，杭州众硅营业收入已初具规模，部分细分领域市场份额已形成竞争优势。考虑到我国半导体行业整体发展尚处于追赶状态，营业收入更能反映企业在行业内的影响力，也更能体现企业价值。

被评估单位属于 CMP 设备设计生产行业，企业价值指标(EV)，属于整体价值，不仅仅包括股权价值，还包括债权价值，能充分反映企业经营性核心资产的价值。此外，考虑到本次选取的可比上市公司以及被评估单位资产负债率差异较大，P/S 指标难以衡量不同债务结构对估值的影响。因此，本次评估采用企业价值与营业收入比率 (EV/S)，有助于分析标的公司价值基础的稳定性和可靠性，又能合

理反映标的公司的市场价值。

综上，本次评估采用 EV/S 作为价值比率。

## 2、计算价值比率

可比公司的企业价值如下表所示：

可比公司企业价值一览表

金额单位：人民币万元

序号	证券代码	可比标的简称	企业价值
1	688037.SH	芯源微	2,980,686.29
2	688729.SH	屹唐股份	7,123,919.35
4	688072.SH	拓荆科技	9,413,998.69
5	688082.SH	盛美上海	8,041,312.97
6	688120.SH	华海清科	5,094,730.39

### （1）流动性折扣及控制权溢价

本次评估，评估人员采用非上市公司并购市盈率与上市公司市盈率对比方式估算流动性折扣率，根据产权交易所、Wind 资讯、CVSource 发布的《非上市公司并购市盈率与上市公司市盈率比较计算非流动性折扣比率表（2025）》中计算机、通信和电子设备制造业数据，本次评估流动性折扣率为 30.76%。

控制权溢价系利用 Wind 资讯、CVSource 数据库和产权交易所网站发布的数据，分析对比少数股权交易并购案例市盈率和控股权交易并购案例市盈率，本次评估选取的控制权溢价为 14.60%。

### （2）差异修正

#### 1) 差异评价

对比分析被评估单位与可比公司在业务结构、企业规模、企业生命周期、成长能力、财务风险、盈利能力、营运能力等方面存在的差异，进行差异评价与调整。

#### ① 业务结构评价

评估单位与可比公司同属于半导体设备制造行业，主营业务均为半导体设备产品设计生产，其业务结构相同，因此评价分均为 100 分。

### ② 生命周期评价

企业的生命周期主要分为四个阶段：初创期、成长期、成熟期和衰退期，由于初创期企业处于争得占有率的地位，存在较大的风险，成长期企业处于保持地位、保持占有率的阶段，成熟期企业处于稳定阶段，衰退期企业处于耗用潜力逐步退出阶段。

被评估单位杭州众硅已完成从技术研发到产品验证的跨越，正处于规模化量产与市场扩张的关键转折点，这是半导体设备企业成长的核心阶段，也是亏损幅度最大但未来增长潜力最强的时期。故本次定义杭州众硅的企业阶段为成长期向成熟期过渡，考虑生命周期评价分为 98 分。

本次可比公司核心产品全球、国内市场份额领先，持续稳定盈利，经营现金流正向，客户覆盖全球头部晶圆厂，平台化布局或多产品线协同效应显现，因此生命周期评价分均为最高分 100 分。

### ③ 企业规模评价

经相关性分析，半导体设备行业可比公司的企业规模与 EV/S 无必然联系，故未对企业规模进行修正。

### ④ 盈利能力评价

根据被评估单位与可比公司盈利能力指标水平，参考评价标准，判断其所属等级，以该等级分值作为评价分。盈利能力评价结果如下表：

盈利能力评价表

序号	公司简称	销售净利率	评价分	净资产收益率	评价分
标的	众硅	-37.89%	96	-12.29%	96
1	芯源微	-2.65%	96	-0.50%	96

2	屹唐股份	13.58%	98	9.35%	98
3	拓荆科技	12.69%	98	13.04%	99
4	盛美上海	24.59%	100	16.12%	100
5	华海清科	24.78%	100	15.43%	99

### ⑤ 营运能力评价

根据被评估单位与可比公司的营运能力指标水平，参考评价标准，判断其所属等级，以该等级分值作为评价分。企业规模评估结果如下表：

营运能力评价表

序号	公司简称	流动资产周转率	评价分	总资产周转率	评价分
标的	众硅	0.27	96	0.25	96
1	芯源微	0.22	96	0.17	96
2	屹唐股份	0.49	100	0.35	100
3	拓荆科技	0.30	96	0.25	96
4	盛美上海	0.41	99	0.34	100
5	华海清科	0.35	98	0.26	97

### ⑥ 财务风险评价

根据被评估单位与可比公司的财务风险指标水平，参考评价标准，判断其所属等级，以该等级分值作为评价分。财务风险评价结果如下表：

财务风险评价表

序号	公司简称	流动比率	评价分	速动比率	评价分
标的	众硅	3.75	99	1.65	98
1	芯源微	1.80	96	0.85	96
2	屹唐股份	4.57	100	2.54	99
3	拓荆科技	1.53	96	0.75	96
4	盛美上海	4.21	99	2.94	100
5	华海清科	2.19	96	1.27	97

### ⑦ 成长性评价

根据被评估单位与可比公司成长性具体指标水平，参考评价标准表，判断其所属等级，以该等级分值作为评价分。成长性评价结果如下表：

成长性评价表

序号	公司简称	净利润增长率	评价分	营业收入增长率	评价分
标的	众硅	39.72%	98	361.59%	100
1	芯源微	-124.96%	96	-10.35%	96
2	屹唐股份	22.73%	97	14.01%	96
3	拓荆科技	106.04%	100	85.27%	99
4	盛美上海	66.93%	99	29.42%	97
5	华海清科	9.81%	96	30.28%	98

2) 差异调整系数

根据上述评价标准及打分规则，对可比公司与被评估单位就业务结构、企业规模、企业生命周期、成长能力、盈利能力进行打分。将被评估单位差异因素分值分别除以可比公司分值，得到各因素调整系数，并将各因素的调整系数相乘即得到各可比公司调整系数，如下表所示：

差异调整系数

序号	公司简称	企业生命周期	企业规模	盈利能力	营运能力	财务风险	成长性	差异调整系数
1	芯源微	0.98	1.00	1.00	1.00	1.03	1.03	1.04
2	屹唐股份	0.98	1.00	0.98	0.96	0.99	1.03	0.94
3	拓荆科技	0.98	1.00	0.97	1.00	1.03	1.00	0.98
4	盛美上海	0.98	1.00	0.96	0.96	0.99	1.01	0.91
5	华海清科	0.98	1.00	0.96	0.98	1.02	1.02	0.97

(4) 企业价值调整

根据可比公司市值，考虑流动性折扣调整，扣除现金及流动性金融资产、加回付息债务及少数股东权益，得到调整后企业价值。

可比公司调整后企业价值

金额单位：人民币万元

序号	可比公司	市值	流动性及控制权溢价调整系数	调整后市值	少数股权调整	付息债务	现金及流动性金融资产	EV	财务修正	调整后 EV
1	芯源微	2,962,409.05	0.7935	2,350,643.14	12,467.12	149,121.84	143,311.72	2,368,920.39	1.04	2,456,570.44

2	屹唐股份	7,395,796.31	0.7935	5,868,493.37	-	104,469.94	376,346.89	5,596,616.42	0.94	5,238,432.97
3	拓荆科技	9,618,899.21	0.7935	7,632,504.18	542.25	356,892.04	562,334.80	7,427,603.66	0.98	7,241,913.57
4	盛美上海	8,589,187.75	0.7935	6,815,438.02	132.72	175,513.46	723,520.95	6,267,563.24	0.91	5,690,947.42
5	华海清科	5,467,872.37	0.7935	4,338,704.24	-	41,953.98	415,095.97	3,965,562.26	0.97	3,846,595.39

### (5) 计算价值比率

截至本次评估报告日，可比公司采用 2025 年已公告的业绩快报或年度报告 2025 年收入金额。综上，根据可比公司的市值以及收入计算得出各可比公司的价值比率，如下表所示：

#### 可比公司价值比率

金额单位：人民币万元

序号	可比公司	证券代码	企业价值 EV(万元)	业绩快报/审计报告	计算可比 EV/S	收入取值来源
			A	B	C=A/B	
1	芯源微	688037.SH	2,456,570.44	194,848.83	12.61	业绩快报
2	屹唐股份	688729.SH	5,238,432.97	507,631.79	10.32	业绩快报
3	拓荆科技	688072.SH	7,241,913.57	651,909.49	11.11	业绩快报
4	盛美上海	688082.SH	5,690,947.42	678,617.02	8.39	年度报告
5	华海清科	688120.SH	3,846,595.39	464,822.77	8.28	业绩快报

#### 计算评估价值

1、根据财务报表，被评估单位 2025 年度总收入为 24,411.88 万元，依照下列公式计算得出各可比公司比准价值，作为被评估单位经营性资产价值计算依据。

$$P = \frac{\sum (\text{可比公司比准价值比率} \times \text{被评估单位价值因子})}{\text{可比公司数量}}$$

#### 可比公司比准价值

金额单位：人民币万元

序号	可比公司	比准 EV/S	比准价值
1	芯源微	12.61	307,784.97
2	屹唐股份	10.32	251,906.18
3	拓荆科技	11.11	271,191.56
4	盛美上海	8.39	204,718.02
5	华海清科	8.28	202,008.30
均值			<b>247,521.81</b>

据此，可得到被评估单位企业整体价值 EV 为 247,521.81 万元。

## 2、现金及现金等价物

评估基准日，标的公司账面现金等价物包括货币资金 12,495.00 万元，交易性金融资产 5,136.06 万元，合计 17,631.06 万元。

## 3、付息债务

根据财务报表，被评估单位于基准日的付息债务主要包括短期借款，合计金额为 15,011.93 万元。

## 4、少数股东权益价值

评估单位基准日少数股东权益占股东权益比重极低（-0.0000017%），本次评估未考虑少数股东权益价值。

## 5、股东全部权益价值

根据公式： $E=EV+C-D-M$

$$=247,521.81+17,631.06-15,011.93$$

$$=250,140.00 \text{（万元，取整）}$$

即，被评估单位归属于母公司股东权益的评估值为 250,140.00 万元。

## 第六部分 评估结论及其分析

### 一、评估结论

我们根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、科学、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用资产基础法、市场法进行评估，对杭州众硅电子科技有限公司纳入评估范围的资产实施了实地勘察、市场调查、询证和评估计算，得出如下结论：

#### 资产基础法评估结论

资产账面价值 104,275.53 万元，评估值 139,641.94 万元，评估增值 35,366.41 万元，增值率 33.92%。

负债账面价值 26,755.27 万元，评估值 26,755.27 万元，无评估增减值。

所有者权益账面价值 77,520.26 万元，评估值 112,886.67 万元，评估增值 35,366.41 万元，增值率 45.62%。详见下表：

#### 资产评估结果汇总表

评估基准日：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
<b>流动资产</b>	<b>98,014.37</b>	<b>101,069.60</b>	<b>3,055.23</b>	<b>3.12</b>
<b>非流动资产</b>	6,261.16	38,572.34	32,311.18	516.06
其中：长期股权投资	500.00	500.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,437.87	1,872.78	434.92	30.25
在建工程	-	-	-	-
无形资产	29.09	31,905.36	31,876.26	109,562.39
其中：土地使用权	-	-	-	-
其他非流动资产	3,059.67	3,059.67	-	-

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
<b>资产总计</b>	<b>104,275.53</b>	<b>139,641.94</b>	<b>35,366.41</b>	<b>33.92</b>
流动负债	25,537.84	25,537.84	-	-
非流动负债	1,217.44	1,217.44	-	-
<b>负债总计</b>	<b>26,755.27</b>	<b>26,755.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>77,520.26</b>	<b>112,886.67</b>	<b>35,366.41</b>	<b>45.62</b>

评估结果与账面所有者权益比较增值 35,366.41 万元，增值率 45.62%，主要原因为存货、无形资产、固定资产增值，具体如下：

1、存货账面值为 53,898.75 万元，评估值为 56,953.98 万元，评估增值 3,055.23 万元，增值率 5.67%，增值主要原因是由于产品市场行情较好，发出商品评估值中考虑了部分利润所致。

2、无形资产账面值为 29.09 万元，评估值 31,905.36 万元，评估增值 31,876.26 万元，增值率 109,562.39%，增值原因主要为账外的专利及软著等资产具有使用价值。

3、固定资产账面值为 1,437.87 万元，评估值为 1,872.78 万元，评估增值 434.92 万元，增值率 30.25%，增值原因主要为：本次评估采用的经济使用年限和企业采用的会计折旧年限不同，故造成评估增值。

### 市场法评估结论

采用市场法估值，合并报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益账面值 75,280.39 万元，评估值 250,140.00 万元，评估增值 174,859.61 万元，增值率 232.28%。

被评估单位在行业中技术领先，具有技术密集、高技能人才密集的特点，市场法评估中结合评估对象行业发展、收入类型、市场需求等因素变化对未来获利能力的影响，评估结果包含了资源优势、技术优势、管理优势等账外的无形资源，故导致评估结果增值。

## 二、评估结果的差异分析

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 250,140.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 112,886.67 万元，高 137,253.33 万元，差异率 121.59%。两种评估方法差异的原因主要是：

1、资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；

2、上市公司比较法反映了在正常公平交易的条件下公开市场对于评估对象价值的测算，通过选取合适价值比率，模拟估算出评估对象的公开市场交易性的市场价值。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

### 三、评估结果的选取

杭州众硅电子科技有限公司是一家高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备公司，为半导体行业及其他高科技领域提供优质技术和高效服务。公司的使命是促进全球芯片生产制造工艺技术的发展，集聚了国内外高端人才，拥有强大的专业技术研发团队，旨在为全世界芯片生产厂商提供一流的化学机械平坦化抛光（CMP）设备，为他们提供先进技术和高效的服务，帮助芯片生产厂商解决技术难题。

公司主要从事高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备及周边产品的研发与生产，主要产品包括众硅 TTAIS®150CMP、TTAIS®200CMP、众硅 TTAIS®300 CMP、单模组 CMP 系统、抛光液供液系统（SDS）、ECMP 等产品，以及相关产品的技术服务。

公司的核心竞争力如下：

1、聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

标的公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，

在 CMP 后清洗技术、终点检测控制技术、APC 智能控制技术、CMP 工艺应用等核心领域均实现创新突破并自主可控。如在终点检测控制技术上，开发了多样化多用途终点检测技术，包含了光谱终点检测系统，以及可融合的多频涡流终点检测系统和激光终点检测系统，适应不同材料不同膜厚检测需求，实现高精度实时反馈，确保抛光工艺的精准控制。其中白光终点检测技术，可在极短采集时间内对高转速抛光过程中大量白光光谱数据进行稳定且准确的实时提取。此外，标的公司已围绕核心技术构建起全方位知识产权保护矩阵，核心技术自主可控。

标的公司是国内少数能够自主创新制造 12 英寸 CMP 设备的企业，其设备采用 6 抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备 4 盘或 3 盘的架构模式。6 抛光盘的设计不仅可同时支持 3 盘工艺或 2 盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅降低了设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了标的公司在 CMP 设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

## 2、汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

标的公司创始团队来自浙江大学、南京大学、美国哥伦比亚大学、美国密苏里大学罗拉分校、美国加州大学伯克利分校劳伦斯-伯克利国家实验室等国内外知名高校/科研院所，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，标的公司组建了一支兼具国际视野

与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，标的公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

### 3、公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，标的公司自主研发并生产的 CMP 设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。标的公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

### 4、设备核心模块自研实现自主可控

CMP 设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。标的公司已实现了诸如抛光头、旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研可降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产 CMP 设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

由于杭州众硅电子科技有限公司主要产品为高端化学机械平坦化

抛光（CMP）设备，市场对于该类企业更多的是看重其研发和未来的发展。市场法参考与被评估单位相似的可比公司近期交易价格，通过分析并调整可比公司与被评估单位各自特点及差异，确定被评估单位评估值，从市场价格的角度测算被评估单位的整体市场价值。因此市场法能够从行业的发展前景、行业特性等方面反映公司的价值。

通过以上分析，我们选用市场法作为本次被评估单位的定价方法。由此得到杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在基准日时点的市场价值为 250,140.00 万元。

## 企业关于进行资产评估有关事项的说明

### 委托人及其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为中微半导体设备（上海）股份有限公司，被评估单位为杭州众硅电子科技有限公司。委托人为被评估单位的股东及股权拟收购方。

### 委托人概况

公司名称：中微半导体设备（上海）股份有限公司

法定代表人：尹志尧

统一社会信用代码：913101157626272806

股票代码：688012.SH

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册资本：62,614.5307 万元

成立日期：2004 年 5 月 31 日

公司地址：上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号

经营范围：研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

### 被评估单位概况

#### 1、企业基本情况

公司名称：杭州众硅电子科技有限公司

法定代表人：GU HAIYANG

统一社会信用代码：91330185MA2CC0D69L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11,562.0108 万元

成立日期：2018 年 5 月 23 日

公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 88 号 1 幢一层

经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2、历史沿革及股东结构

### （1）2018 年 5 月，杭州众硅设立

2018 年 5 月 21 日，杭州众芯硅和朱琳签订《杭州众硅电子科技有限公司章程》，约定标的公司注册资本为 3,000.00 万元，朱琳以货币方式认缴出资 30.00 万元，占注册资本的 1.00%。杭州众芯硅以货币方式认缴出资 2,970.00 万元，占注册资本的 99.00%。

2018 年 5 月 23 日，杭州众硅取得了杭州市临安区市场监督管理局核发的《营业执照》。

杭州众硅设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	99.00%	货币
2	朱琳	30.00	1.00%	货币
合 计		3,000.00	100.00%	--

### （2）2019 年 2 月，杭州众硅第一次增资

2018年5月28日，杭州众硅与朱力昂及相关方签署增资协议，约定朱力昂对标的公司增资500.00万元，认缴标的公司116.13万元注册资本。

2019年1月，杭州众硅与临安创投及相关方签署增资协议，约定临安创投以1.00元/注册资本的价格对标的公司增资600.00万元，认缴标的公司600.00万元注册资本。

2019年2月21日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至3,716.13万元，新增注册资本716.13万元由朱力昂认缴116.13万元，由临安创投认缴600.00万元，并相应修改公司章程。

2019年2月22日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	79.92%	货币
2	临安创投	600.00	16.15%	货币
3	朱力昂	116.13	3.13%	货币
4	朱琳	30.00	0.81%	货币
合 计		3,716.13	100.00%	--

### （3）2019年12月，杭州众硅第二次增资

2019年6月17日，杭州众硅与淮堃创投及相关方签署增资协议，约定淮堃创投将以5,000.00万元的价格认购标的公司663.59万元注册资本。

2019年12月11日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,379.72万元，新增注册资本663.59万元由淮堃创

投认缴。

2019年12月11日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	67.81%	货币
2	淮堃创投	663.59	15.15%	货币
3	临安创投	600.00	13.70%	货币
4	朱力昂	116.13	2.65%	货币
5	朱琳	30.00	0.69%	货币
合 计		<b>4,379.72</b>	<b>100.00%</b>	--

#### （4）2020年5月，杭州众硅第三次增资

2020年4月，杭州众硅与临安创投及相关方签署增资协议，约定临安创投将以1,000.00万元的价格认购标的公司132.72万元注册资本。

2020年5月5日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,512.44万元，新增注册资本132.72万元由临安创投认缴。

2020年5月22日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	65.82%	货币
2	临安创投	732.72	16.24%	货币
3	淮堃创投	663.59	14.71%	货币
4	朱力昂	116.13	2.57%	货币
5	朱琳	30.00	0.66%	货币
合 计		<b>4,512.44</b>	<b>100.00%</b>	--

### (5) 2021年1月，杭州众硅第一次股权转让

2021年1月12日，经杭州众硅股东会同意，杭州众芯硅与临安众芯硅（曾用名：宁波众硅企业管理合伙企业（有限合伙）（2021-01至2021-12））签订《股权转让协议》，约定将杭州众芯硅所持标的公司8.20%的股权（对应注册资本370.02万元，实缴0.00元）转让给临安众芯硅，转让价格为0.00元。后续由受让方履行实缴义务。标的公司现有股东均放弃优先购买权。

2021年2月，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,599.98	57.62%	货币
2	临安创投	732.72	16.24%	货币
3	淮堃创投	663.59	14.71%	货币
4	宁波众硅	370.02	8.20%	货币
5	朱力昂	116.13	2.57%	货币
6	朱琳	30.00	0.66%	货币
合 计		<b>4,512.44</b>	<b>100.00%</b>	--

### (6) 2021年2月，杭州众硅第四次增资

2020年12月，杭州众硅与宁波领芯及相关方签署增资协议，约定宁波领芯将以2,000.00万元的价格认购标的公司265.44万元注册资本。

2021年2月22日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,777.88万元，新增注册资本265.44万元由宁波领芯认缴，并同意通过新的公司章程。

2021年2月22日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更

后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,599.98	54.42%	货币
2	临安创投	732.72	15.34%	货币
3	淮堃创投	663.59	13.89%	货币
4	宁波众硅	370.02	7.74%	货币
5	宁波领芯	265.44	5.56%	货币
6	朱力昂	116.13	2.43%	货币
7	朱琳	30.00	0.63%	货币
合 计		<b>4,777.88</b>	<b>100.00%</b>	--

### （7）2021年3月，杭州众硅第五次增资

2021年2月，杭州众硅与炬华联昕、好奇号、寓鑫创投、吴仁德及相关方签署增资协议，约定炬华联昕、好奇号、寓鑫创投、吴仁德以5,000.00万元认购标的公司597.24万元注册资本。

2021年3月4日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至5,375.12万元，新增注册资本597.24万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
炬华联昕	1,000.00	119.45
好奇号	500.00	59.72
寓鑫创投	1,000.00	119.45
吴仁德	2,500.00	298.62
合计	<b>5,000.00</b>	<b>597.24</b>

2021年3月4日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,599.98	48.37%
2	临安创投	732.72	13.63%
3	淮堃创投	663.59	12.35%
4	宁波众硅	370.02	6.88%
5	吴仁德	298.62	5.56%
6	宁波领芯	265.44	4.94%
7	炬华联昕	119.45	2.22%
8	寓鑫创投	119.45	2.22%
9	朱力昂	116.13	2.16%
10	好奇号	59.72	1.11%
11	朱琳	30.00	0.56%
合 计		5,375.12	100.00%

#### （8）2021年8月，杭州众硅第二次股权转让

2021年6月，杭州众芯硅与长兴青鸟签订投资协议，约定杭州众芯硅将其所持标的公司2.79%的股权（对应出资额150.00万元）转让给长兴青鸟，转让价格为1,320.00万元。

2021年7月21日，杭州众硅召开股东会，全体股东均同意前述股权转让。

2021年8月2日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	45.58%
2	临安创投	732.72	13.63%
3	淮堃创投	663.59	12.35%
4	宁波众硅	370.02	6.88%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
5	吴仁德	298.62	5.56%
6	宁波领芯	265.44	4.94%
7	长兴青鸟	150.00	2.79%
8	炬华联昕	119.45	2.22%
9	寓鑫创投	119.45	2.22%
10	朱力昂	116.13	2.16%
11	好奇号	59.72	1.11%
12	朱琳	30.00	0.56%
合 计		5,375.12	100.00%

### （9）2021年10月，杭州众硅第六次增资

2021年8月，杭州众硅分别与江苏中小基金、毅达太湖、宁波毅达、嘉兴芯通、小满投资、宁波和丰、江苏建泉、浙江容腾、苏州国发、朗玛四十二号及相关方签署增资协议，约定江苏中小基金、毅达太湖、宁波毅达、嘉兴芯通、小满投资、宁波和丰、江苏建泉、浙江容腾、苏州国发、朗玛四十二号以17,000.00万元认购标的公司1,405.80万元注册资本。

2021年8月31日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至6,780.92万元，新增注册资本1,405.80万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
江苏中小基金	3,000.00	248.08
毅达太湖	1,500.00	124.04
宁波毅达	1,500.00	124.04
嘉兴芯通	3,000.00	248.08

小满投资	2,000.00	165.39
宁波和丰	3,000.00	248.08
江苏隼泉	1,000.00	82.69
浙江容腾	1,000.00	82.69
苏州国发	500.00	41.35
朗玛四十二号	500.00	41.35
<b>合计</b>	<b>17,000.00</b>	<b>1,405.80</b>

2021年10月11日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	36.13%
2	临安创投	732.72	10.81%
3	淮堃创投	663.59	9.79%
4	宁波众硅	370.02	5.46%
5	吴仁德	298.62	4.40%
6	宁波领芯	265.44	3.91%
7	江苏中小基金	248.08	3.66%
8	嘉兴芯通	248.08	3.66%
9	宁波和丰	248.08	3.66%
10	小满投资	165.39	2.44%
11	长兴青鸟	150.00	2.21%
12	毅达太湖	124.04	1.83%
13	宁波毅达	124.04	1.83%
14	炬华联昕	119.45	1.76%
15	寓鑫创投	119.45	1.76%
16	朱力昂	116.13	1.71%
17	江苏隼泉	82.69	1.22%
18	浙江容腾	82.69	1.22%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
19	好奇号	59.72	0.88%
20	苏州国发	41.35	0.61%
21	朗玛四十二号	41.35	0.61%
22	朱琳	30.00	0.44%
合计		6,780.92	100.00%

### （10）2022年7月，第三次股权转让

2022年6月27日，公司召开股东会，同意临安创投将其持有的公司股权分别向杭州众诚芯、临安众硅、杭州芯匠进行转让：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）
临安创投	杭州众诚芯	100.00	100.00
	临安众硅	289.00	289.00
	杭州芯匠	211.00	211.00

2022年6月，临安创投与杭州众诚芯、临安众硅、杭州芯匠签署《股权转让协议》，本次转让系执行回购。

2022年7月1日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	36.13%
2	淮堃创投	663.59	9.79%
3	临安众芯硅	370.02	5.46%
4	吴仁德	298.62	4.40%
5	临安众硅	289.00	4.26%
6	宁波领芯	265.44	3.91%
7	江苏中小基金	248.08	3.66%
8	嘉兴芯通	248.08	3.66%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
9	宁波和丰	248.08	3.66%
10	杭州芯匠	211.00	3.11%
11	小满投资	165.39	2.44%
12	长兴青鸟	150.00	2.21%
13	临安创投	132.72	1.96%
14	毅达太湖	124.04	1.83%
15	宁波毅达	124.04	1.83%
16	炬华联昕	119.45	1.76%
17	寓鑫创投	119.45	1.76%
18	朱力昂	116.13	1.71%
19	杭州众诚芯	100.00	1.47%
20	江苏聿泉	82.69	1.22%
21	浙江容腾	82.69	1.22%
22	好奇号	59.72	0.88%
23	苏州国发	41.35	0.61%
24	朗玛四十二号	41.35	0.61%
25	朱琳	30.00	0.44%
合 计		<b>6,780.92</b>	<b>100.00%</b>

(11) 2022年10月，第七次增资

2022年8月14日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至7,460.92万元，新增注册资本680.00万元由宁容海川认缴。针对本次增资，标的公司现有股东均放弃优先认购权和反稀释权。

2022年8月25日，杭州众硅与宁容海川及相关方签署增资协议，约定宁容海川以680.00万元认购标的公司680.00万元注册资本。标的

公司为引进拥有丰富行业经验的 MICHAEL XIAOXUAN YANG 先生，经全体股东一致同意，由 MICHAEL XIAOXUAN YANG 先生控制的企业宁容海川以 1.00 元/单位注册资本的价格向标的公司增资，并聘任 MICHAEL XIAOXUAN YANG 为标的公司董事长。

2022 年 10 月 31 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	32.84%
2	宁容海川	680.00	9.11%
3	淮堃创投	663.59	8.89%
4	临安众芯硅	370.02	4.96%
5	吴仁德	298.62	4.00%
6	临安众硅	289.00	3.87%
7	宁波领芯	265.44	3.56%
8	江苏中小基金	248.08	3.33%
9	嘉兴芯通	248.08	3.33%
10	宁波和丰	248.08	3.33%
11	杭州芯匠	211.00	2.83%
12	小满投资	165.39	2.22%
13	长兴青鸟	150.00	2.01%
14	临安创投	132.72	1.78%
15	毅达太湖	124.04	1.66%
16	宁波毅达	124.04	1.66%
17	炬华联昕	119.45	1.60%
18	寓鑫创投	119.45	1.60%
19	朱力昂	116.13	1.56%
20	杭州众诚芯	100.00	1.34%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
21	江苏隼泉	82.69	1.11%
22	浙江容腾	82.69	1.11%
23	好奇号	59.72	0.80%
24	苏州国发	41.35	0.55%
25	朗玛四十二号	41.35	0.55%
26	朱琳	30.00	0.40%
合 计		<b>7,460.92</b>	<b>100.00%</b>

### （12）2022 年 12 月，第八次增资、第四次股权转让

2022 年 11 月 6 日，淮堃创投与南京星堃签订股权转让协议，约定淮堃创投将其所持标的公司 248.14 万元注册资本转让给南京星堃，转让价格为 3,000.00 万元。

2022 年 11 月 20 日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

#### （1）增资

标的公司注册资本增加至 7,800.05 万元，新增注册资本 339.13 万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
衢州瑞唐	4,000.00	271.31
海澳芯科	500.00	33.91
杰正投资	500.00	33.91
合计	<b>5,000.00</b>	<b>339.13</b>

#### （2）股权转让

淮堃创投将其所持标的公司 248.14 万元注册资本转让给南京星堃，转让价格为 3,000.00 万元。

2022年11月23日，杭州众硅与海澳芯科、杰正投资及相关方签署增资协议，约定海澳芯科以500.00万元认购标的公司33.91万元注册资本；杰正投资以500.00万元认购标的公司33.91万元注册资本。

2022年11月25日，杭州众硅与衢州瑞唐及相关方签署增资协议，约定衢州瑞唐以4,000.00万元认购标的公司271.31万元注册资本。

2022年12月7日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	31.41%
2	宁容海川	680.00	8.72%
3	淮堃创投	415.46	5.33%
4	临安众芯硅	370.02	4.74%
5	吴仁德	298.62	3.83%
6	临安众硅	289.00	3.71%
7	衢州瑞唐	271.31	3.48%
8	宁波领芯	265.44	3.40%
9	南京星堃	248.14	3.18%
10	江苏中小基金	248.08	3.18%
11	嘉兴芯通	248.08	3.18%
12	宁波和丰	248.08	3.18%
13	杭州芯匠	211.00	2.71%
14	小满投资	165.39	2.12%
15	长兴青鸟	150.00	1.92%
16	临安创投	132.72	1.70%
17	毅达太湖	124.04	1.59%
18	宁波毅达	124.04	1.59%
19	炬华联昕	119.45	1.53%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
20	寓鑫创投	119.45	1.53%
21	朱力昂	116.13	1.49%
22	杭州众诚芯	100.00	1.28%
23	江苏聿泉	82.69	1.06%
24	浙江容腾	82.69	1.06%
25	好奇号	59.72	0.77%
26	苏州国发	41.35	0.53%
27	朗玛四十二号	41.35	0.53%
28	海澳芯科	33.91	0.43%
29	杰正投资	33.91	0.43%
30	朱琳	30.00	0.38%
合 计		<b>7,800.05</b>	<b>100.00%</b>

### （13）2023年2月，第九次增资

2022年12月，杭州众硅分别与朗玛五十九号、朗玛六十号、朗玛六十三号、星成联芯、吴仁德、毅达鼎祺、嘉兴邦拓、朱力昂及相关方签署增资协议，约定朗玛五十九号、朗玛六十号、朗玛六十三号、星成联芯、吴仁德、毅达鼎祺、嘉兴邦拓、朱力昂以12,000.00万元认购标的公司624.00万元注册资本。

2022年12月25日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至8,424.05万元，新增注册资本624.00万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
朗玛五十九号	1,500.00	78.00
朗玛六十号	1,500.00	78.00
朗玛六十三号	2,000.00	104.00

星成联芯	2,000.00	104.00
吴仁德	2,000.00	104.00
毅达鼎祺	1,500.00	78.00
嘉兴邦拓	1,000.00	52.00
朱力昂	500.00	26.00
<b>合计</b>	<b>12,000.00</b>	<b>624.00</b>

2023年2月17日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	29.08%
2	宁容海川	680.00	8.07%
3	淮堃创投	415.46	4.93%
4	吴仁德	402.62	4.78%
5	临安众芯硅	370.02	4.39%
6	临安众硅	289.00	3.43%
7	衢州瑞唐	271.31	3.22%
8	宁波领芯	265.44	3.15%
9	南京星堃	248.14	2.95%
10	江苏中小基金	248.08	2.94%
11	嘉兴芯通	248.08	2.94%
12	宁波和丰	248.08	2.94%
13	杭州芯匠	211.00	2.50%
14	小满投资	165.39	1.96%
15	长兴青鸟	150.00	1.78%
16	朱力昂	142.13	1.69%
17	临安创投	132.72	1.58%
18	毅达太湖	124.04	1.47%
19	宁波毅达	124.04	1.47%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
20	炬华联昕	119.45	1.42%
21	寓鑫创投	119.45	1.42%
22	朗玛六十三号	104.00	1.23%
23	星成联芯	104.00	1.23%
24	杭州众诚芯	100.00	1.19%
25	江苏聿泉	82.69	0.98%
26	浙江容腾	82.69	0.98%
27	朗玛五十九号	78.00	0.93%
28	朗玛六十号	78.00	0.93%
29	毅达鼎祺	78.00	0.93%
30	好奇号	59.72	0.71%
31	嘉兴邦拓	52.00	0.62%
32	苏州国发	41.35	0.49%
33	朗玛四十二号	41.35	0.49%
34	海澳芯科	33.91	0.40%
35	杰正投资	33.91	0.40%
36	朱琳	30.00	0.36%
合 计		<b>8,424.05</b>	<b>100.00%</b>

#### (14) 2023年6月，第十次增资、第五次股权转让

2023年4月25日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

##### (1) 增资

标的公司注册资本增加至9,603.42万元，新增注册资本1,179.37万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
杭州富浙	10,000.00	421.20

浙江富浙	10,000.00	421.20
宁波蓝郡	4,000.00	168.48
杭州北峰	2,000.00	84.24
温润贰号	1,975.00	83.19
温润叁号	25.00	1.05
<b>合 计</b>	<b>28,000.00</b>	<b>1,179.37</b>

## (2) 股权转让

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
临安创投	杭州赋芯	109.0913	821.9700
	朱力昂	3.5190	26.5150
	淮堃创投	20.109	151.5150

2023年4月，杭州众硅分别与温润贰号、温润叁号、杭州富浙、宁波蓝郡、杭州北峰及相关方签署增资协议，约定温润贰号、温润叁号、杭州富浙、宁波蓝郡、杭州北峰以18,000.00万元认购标的公司758.17万元注册资本。

2023年5月30日，临安创投与杭州赋芯、朱力昂、淮堃创投签订《股权转让协议》，本次转让系执行回购。

2023年6月，杭州众硅分别与浙江富浙及相关方签署增资协议，约定浙江富浙以10,000.00万元认购标的公司421.20万元注册资本。

2023年6月27日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	25.51%
2	宁容海川	680.00	7.08%
3	淮堃创投	435.56	4.54%
4	杭州富浙	421.20	4.39%

5	浙江富浙	421.20	4.39%
6	吴仁德	402.62	4.19%
7	临安众芯硅	370.02	3.85%
8	临安众硅	289.00	3.01%
9	衢州瑞唐	271.31	2.83%
10	宁波领芯	265.44	2.76%
11	南京星堃	248.14	2.58%
12	江苏中小基金	248.08	2.58%
13	嘉兴芯通	248.08	2.58%
14	宁波和丰	248.08	2.58%
15	杭州芯匠	211.00	2.20%
16	宁波蓝郡	168.48	1.75%
17	小满投资	165.39	1.72%
18	长兴青鸟	150.00	1.56%
19	朱力昂	145.65	1.52%
20	毅达太湖	124.04	1.29%
21	宁波毅达	124.04	1.29%
22	炬华联昕	119.45	1.24%
23	寓鑫创投	119.45	1.24%
24	杭州赋芯	109.09	1.14%
25	朗玛六十三号	104.00	1.08%
26	星成联芯	104.00	1.08%
27	杭州众诚芯	100.00	1.04%
28	杭州北峰	84.24	0.88%
29	温润贰号	83.19	0.87%
30	江苏聿泉	82.69	0.86%
31	浙江容腾	82.69	0.86%
32	朗玛五十九号	78.00	0.81%
33	朗玛六十号	78.00	0.81%
34	毅达鼎祺	78.00	0.81%
35	好奇号	59.72	0.62%
36	嘉兴邦拓	52.00	0.54%
37	苏州国发	41.35	0.43%

38	朗玛四十二号	41.35	0.43%
39	海澳芯科	33.91	0.35%
40	杰正投资	33.91	0.35%
41	朱琳	30.00	0.31%
42	温润叁号	1.05	0.01%
合 计		<b>9,603.42</b>	<b>100.00%</b>

### (15) 2024 年 12 月，第十一次增资、第六次股权转让

2024 年 11 月 28 日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

#### (1) 增资

同意标的公司注册资本增加至 10,487.95 万元，新增注册资本 884.53 万元，由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
中微临港	2,000.00	84.24
台州金石投资	16,000.00	673.92
中信投资	2,000.00	84.24
石溪投资	1,000.00	42.12
合计	<b>21,000.00</b>	<b>884.53</b>

#### 2) 股权转让

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
杭州赋芯	中微临港	11.44	178.66
浙江容腾		82.69	1,291.64
海澳芯科		33.91	529.71
好奇号	石溪投资	59.72	932.85
杭州众芯硅		4.30	67.15
杭州赋芯	台州金石投资	97.65	1,525.29
杭州众芯硅		30.39	474.71

温润叁号	温润安享	1.05	25.00
------	------	------	-------

本次股权转让价格对应标的公司的整体估值约为 16.38 亿元。

2024 年 12 月 31 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
43	杭州众芯硅	2,415.29	23.03%
44	台州金石投资	801.97	7.65%
45	宁容海川	680.00	6.48%
46	淮堃创投	435.56	4.15%
47	杭州富浙	421.20	4.02%
48	浙江富浙	421.20	4.02%
49	吴仁德	402.62	3.84%
50	临安众芯硅	370.02	3.53%
51	临安众硅	289.00	2.76%
52	衢州瑞唐	271.31	2.59%
53	宁波领芯	265.44	2.53%
54	南京星堃	248.14	2.37%
55	江苏中小基金	248.08	2.37%
56	嘉兴芯通	248.08	2.37%
57	宁波和丰	248.08	2.37%
58	中微临港	212.29	2.02%
59	杭州芯匠	211.00	2.01%
60	宁波蓝郡	168.48	1.61%
61	小满投资	165.39	1.58%
62	长兴青鸟	150.00	1.43%
63	朱力昂	145.65	1.39%
64	毅达太湖	124.04	1.18%
65	宁波毅达	124.04	1.18%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
66	炬华联昕	119.45	1.14%
67	寓鑫创投	119.45	1.14%
68	石溪投资	106.14	1.01%
69	朗玛六十三号	104.00	0.99%
70	星成联芯	104.00	0.99%
71	杭州众诚芯	100.00	0.95%
72	杭州北峰	84.24	0.80%
73	中信投资	84.24	0.80%
74	温润贰号	83.19	0.79%
75	江苏走泉	82.69	0.79%
76	朗玛五十九号	78.00	0.74%
77	朗玛六十号	78.00	0.74%
78	毅达鼎祺	78.00	0.74%
79	嘉兴邦拓	52.00	0.50%
80	苏州国发	41.35	0.39%
81	朗玛四十二号	41.35	0.39%
82	杰正投资	33.91	0.32%
83	朱琳	30.00	0.29%
84	温润安享	1.05	0.01%
合 计		<b>10,487.9441</b>	<b>100.0000%</b>

### （16）2025年2月，第十二次增资、第七次股权转让

2024年12月31日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

#### （1）增资

同意标的公司注册资本增加至 11,562.01 万元，新增注册资本 1,074.07 万元，由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
江苏毅达	2,500.00	105.30
安徽丰禾	5,000.00	210.60
青岛东证	3,000.00	126.36
杭州达晨	5,250.00	221.13
深圳达晨	8,750.00	368.55
达晨财智	1,000.00	42.12
<b>合计</b>	<b>25,500.00</b>	<b>1,074.07</b>

## 2) 股权转让

因标的公司 2024 年 12 月增资及股权转让事宜触发反稀释条款。经各方协商一致，杭州众芯硅同意向 2023 年 6 月入股的投资人给予股权补偿，具体如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（元）
杭州众芯硅	杭州富浙	21.16	1.00
	浙江富浙	21.16	1.00
	宁波蓝郡	8.46	1.00
	杭州北峰	4.23	1.00
	温润贰号	4.18	1.00
	温润安享	0.05	1.00

2025 年 2 月 28 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
49	杭州众芯硅	2,356.04	20.38%
50	台州金石投资	801.97	6.94%
51	宁容海川	680.00	5.88%
52	杭州富浙	442.36	3.83%
53	浙江富浙	442.36	3.83%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
54	淮堃创投	435.56	3.77%
55	吴仁德	402.62	3.48%
56	临安众芯硅	370.02	3.20%
57	深圳达晨	368.55	3.19%
58	临安众硅	289.00	2.50%
59	衢州瑞唐	271.31	2.35%
60	宁波领芯	265.44	2.30%
61	南京星堃	248.14	2.15%
62	江苏中小基金	248.08	2.15%
63	嘉兴芯通	248.08	2.15%
64	宁波和丰	248.08	2.15%
65	杭州达晨	221.13	1.91%
66	中微临港	212.29	1.84%
67	杭州芯匠	211.00	1.82%
68	安徽丰禾	210.60	1.82%
69	宁波蓝郡	176.95	1.53%
70	小满投资	165.39	1.43%
71	长兴青鸟	150.00	1.30%
72	朱力昂	145.65	1.26%
73	青岛东证	126.36	1.09%
74	毅达太湖	124.04	1.07%
75	宁波毅达	124.04	1.07%
76	炬华联昕	119.45	1.03%
77	寓鑫创投	119.45	1.03%
78	石溪投资	106.14	0.92%
79	江苏毅达	105.30	0.91%
80	朗玛六十三号	104.00	0.90%
81	星成联芯	104.00	0.90%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
82	杭州众诚芯	100.00	0.86%
83	杭州北峰	88.47	0.77%
84	温润贰号	87.37	0.76%
85	中信投资	84.24	0.73%
86	江苏惠泉	82.69	0.72%
87	朗玛五十九号	78.00	0.67%
88	朗玛六十号	78.00	0.67%
89	毅达鼎祺	78.00	0.67%
90	嘉兴邦拓	52.00	0.45%
91	达晨财智	42.12	0.36%
92	苏州国发	41.35	0.36%
93	朗玛四十二号	41.35	0.36%
94	杰正投资	33.91	0.29%
95	朱琳	30.00	0.26%
96	温润安享	1.11	0.01%
合 计		<b>11,562.01</b>	<b>100.00%</b>

### (17) 2025 年 8 月，第八次股权转让

2025 年 8 月 11 日，经杭州众硅股东会同意，以下各方分别签订股权转让协议，就股权转让事宜约定如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
衢州瑞唐	王敏文	135.99	2,005.00
	张久海	135.31	1,995.00
朱力昂	蔡刚波	55.16	1,100.00
宁波领芯		95.27	1,900.00
炬华联昕	扬州朗智	119.45	2,382.12
宁波和丰		248.08	4,947.48
苏州国发		41.35	824.58

淮堃创投		158.04	3,151.80
淮堃创投	中微临港	156.81	3,127.30
嘉兴芯通		248.08	4,947.48
寓鑫创投		119.45	2,382.12
吴仁德		402.62	8,029.37
南京星堃		248.14	4,948.61
宁波领芯		5.01	100.00
淮堃创投		国孚领航	120.71
星成联芯	104.00		2,074.07
朗玛四十二号	41.35		824.58
江苏中小基金	150.43		3,000.00
毅达太湖	75.21		1,500.00
宁波毅达	75.21		1,500.00

注1：衢州瑞唐的主要合伙人为王敏文、张久海，本次转让中，衢州瑞唐将其所持标的公司股权按其初始投资成本转让给王敏文、张久海。

2025年9月10日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
43	杭州众芯硅	2,356.04	20.38%
44	中微临港	1,392.40	12.04%
45	台州金石投资	801.97	6.94%
46	宁容海川	680.00	5.88%
47	扬州朗智	566.92	4.90%
48	国孚领航	566.92	4.90%
49	杭州富浙	442.36	3.83%
50	浙江富浙	442.36	3.83%
51	临安众芯硅	370.02	3.20%
52	深圳达晨	368.55	3.19%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
53	临安众硅	289.00	2.50%
54	杭州达晨	221.13	1.91%
55	杭州芯匠	211.00	1.82%
56	安徽丰禾	210.60	1.82%
57	宁波蓝郡	176.95	1.53%
58	小满投资	165.39	1.43%
59	宁波领芯	165.15	1.43%
60	蔡刚波	150.43	1.30%
61	长兴青鸟	150.00	1.30%
62	王敏文	135.99	1.18%
63	张久海	135.31	1.17%
64	青岛东证	126.36	1.09%
65	石溪投资	106.14	0.92%
66	江苏毅达	105.30	0.91%
67	朗玛六十三号	104.00	0.90%
68	杭州众诚芯	100.00	0.86%
69	江苏中小基金	97.65	0.84%
70	朱力昂	90.49	0.78%
71	杭州北峰	88.47	0.77%
72	温润贰号	87.37	0.76%
73	中信投资	84.24	0.73%
74	江苏隼泉	82.69	0.72%
75	朗玛五十九号	78.00	0.67%
76	朗玛六十号	78.00	0.67%
77	毅达鼎祺	78.00	0.67%
78	嘉兴邦拓	52.00	0.45%
79	毅达太湖	48.83	0.42%
80	宁波毅达	48.83	0.42%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
81	达晨财智	42.12	0.36%
82	杰正投资	33.91	0.29%
83	朱琳	30.00	0.26%
84	温润安享	1.11	0.01%
合 计		<b>11,562.01</b>	<b>100.00%</b>

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，杭州众硅电子科技有限公司股东及股权比例未发生变动。

### 3、资产、财务及经营状况

#### (1) 合并报表情况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 102,212.56 万元，负债总额为 26,932.17 万元，净资产 75,280.39 万元；2025 年营业收入 24,411.88 万元，净利润-9,250.00 万元。公司近二年资产、财务状况如下表：

#### 公司资产、负债及财务状况

金额单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	90,728.47	102,212.56
负债	27,063.65	26,932.17
净资产	63,664.82	75,280.39
	<b>2024 年度</b>	<b>2025 年度</b>
营业收入	5,288.65	24,411.88
利润总额	-15,346.30	-9,250.00
净利润	-15,346.30	-9,250.00
审计机构	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

#### (2) 母公司报表情况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 104,275.53 万元，负债总额为 26,755.27 万元，净资产为 77,520.26 万元；2025 年营

业收入 24,411.88 万元，净利润-8,531.79 万元。公司近二年资产、财务状况如下表：

#### 公司资产、负债及财务状况

金额单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	92,230.58	104,275.53
负债	26,852.48	26,755.27
净资产	65,378.09	77,520.26
	<b>2024 年度</b>	<b>2025 年度</b>
营业收入	5,288.65	24,411.88
利润总额	-14,426.64	-8,531.79
净利润	-14,426.64	-8,531.79
审计机构	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 4、经营情况介绍

杭州众硅主营业务为高端化学机械抛光和化学机械平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案。杭州众硅目前已推出多款自主创新研发的 12 英寸 CMP 设备，应用在晶圆制造、大硅片、先进封装及先进存储等领域，已发展成为半导体高端装备领域重要的厂商。

在晶圆制造抛光领域，目前国际主要设备供应商为应用材料、日本荏原。标的公司自主研发的 12 英寸化学机械平坦化设备（TTAIS®300 CMP）突破技术壁垒，已在国内主要先进存储和逻辑芯片制造厂商陆续进行认证并实现应用。该设备深度适配客户工艺需求，工艺覆盖金属、非金属等全品类抛光场景，可精准应用于先进逻辑、先进封装等核心制程环节，成为国内少数能为先进集成电路制造提供整套 CMP 设备技术解决方案的企业之一。标的公司自主创新研发的紧凑、高效 6 抛光盘设备平台设计，在单位设备产能、设备占地面积、设备性价比等核心大规模量产设备指标等方面表现突出，能有效降低客户设备综合运营成本。

同时，其工艺适配性和灵活性可以匹配不同先进集成电路制造客户的工艺制程需求和不同工艺节点的工艺迭代/产能规划需求，减少工艺切换损耗，显著提升客户的生产效率和经济效益，助力客户提升在先进集成电路制造领域的竞争优势。

在大硅片抛光领域，对于 CMP 设备的金属和颗粒污染等工艺结果要求极高。目前全球大硅片衬底抛光 CMP 设备市场处于高度垄断状态，主要由冈本工作机械株式会社（即 Okamoto Machine Tool Works, Ltd）和应用材料两家国际设备制造商占据，设备国产化率低。标的公司针对大硅片抛光专门开发了 12 英寸硅片化学机械抛光设备（TTAIS®300 Si CMP）突破了高端硅片产品加工的技术瓶颈，同时实现了核心产品自主研发与制造。与同类产品相比，抛光平坦化和清洗效果均达到国际先进水平，能够适配先进制程工艺对高端硅片的要求。同时，单位设备产能、设备占地面积、设备性价比等指标达到行业领先水平。


在第三代半导体碳化硅衬底抛光领域，标的公司以原创性技术研发并首创了碳化硅衬底用电化学机械抛光技术和设备（TNTAS®ECMP），解决了碳化硅抛光效率低、良率低、生产成本低及化学品对环境影响大等难题。与传统化学机械抛光和强氧化性抛光设备相比，具有去除率高、单片抛光综合运营成本低、工艺条件温和、晶片加工质量高、安全环保等优点，填补了量产型碳化硅衬底电化学机械抛光设备领域的空白，为碳化硅功率器件、射频器件等规模化应用提供了关键装备保障。

### （1）主营产品

公司主营产品如下：

序号	产品类别	产品型号	产品特征/应用领域	产品图示
----	------	------	-----------	------

1	CMP 装备	TTAIS <sup>®</sup> 300 CMP	面向行业前沿需求开发的集先进平坦化工艺、高效率、高兼容性于一体的12英寸CMP装备。该装备采用6个独立研磨模组和2个独立清洗模组的全新紧凑架构，配置先进的终点检测技术与独特的耗材成本降低技术解决方式，具有高灵活性、高兼容性、低运营成本等特点，满足芯片制造的加工需求。主要应用于集成电路前道制造和先进封装。	
2	CMP 装备	TTAIS <sup>®</sup> 300 Si CMP	根据行业前沿应用技术需求开发的12英寸硅片CMP装备。该装备配备性能优越的硅片化学机械抛光和化学机械平坦化单元及清洗单元，卓越的工艺稳定性、高生产效率，可实现硅片表面的高平坦度和均匀性。主要应用于大硅片抛光。	
3	CMP 装备	TNTA S <sup>®</sup> EC MP	针对快速增长的新兴市场需求开发的第三代半导体材料碳化硅专用CMP装备。该装备配备了独特的碳化硅衬底电化学机械抛光解决方案，集成先进的单片自动传输设备，具有高去除率、高产能、高效率等优点，满足第三代半导体材料工艺器件的技术需求。	
4	CMP 抛 光 模 组	DMS <sup>®</sup> 单 / 双 CMP 模 组	该装备主要服务于研发机构及实验室场景，通过定制化研磨模组设计、先进终点控制技术、自动化工艺控制和整机通用设计，实现CMP工艺结果。	
5	研 磨 液 系 统	SDS <sup>®</sup>	根据市场需求开发的2个100升研磨液供液系统，该装备配备双重泵/过滤器式设计工艺，满足持续运行需求，适用制程包括Si/Poly/STI/ILD/W/Cu CMP等。	

6	研 磨 液 供 液 系 统	SDD <sup>®</sup>	根据市场需求开发的2个200升研磨液供液系统，该装备配备全自动系统，满足无杂质和颗粒污染需求，提供高效的系统数据监控与记录，适用制程包括Si/ Poly/ STI/ ILD/ W/ Cu CMP等。	
---	------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

### (2) 采购模式

公司的研发部门根据客户订单或采购意向确定并形成 BOM 清单，生产计划部依据 BOM 清单确认原材料采购内容，依据物料采购周期形成投产计划，并依据投产计划生成请购单上传 U8 系统审核，采购部收到审核完成的请购单后进行下单。

CMP 设备是实现化学机械抛光工艺的全自动超精密装备，零部件的精度、洁净度、稳定性、可靠性和一致性对于整机的工艺性能和质量产生较大影响。为保证标的公司产品的质量和性能，标的公司制定了严格的供应商准入和审核制度，根据供应商技术能力、质量管控能力、生产能力、价格水平、交货周期、资产管理和服务等因素，选定合格的供应商纳入合格供应商名录。标的公司一般会与主要供应商签订框架协议并以订单形式具体执行采购。对于新品研发中出现的新物料需求，若现有合格供应商无法供应，则启动新供应商及相应原材料的评估和验证，验证通过后进行采购。

### (3) 生产模式

公司根据客户订单或采购意向确定具体投产计划，首先按通用产品或采购意向配置进行产品的生产和调试，后续按照客户确认的明确参数、配置等具体需求再进行产品的配置变更、软件配置、参数设置和调试，最终完成整机装配和测试验证。

### (4) 销售模式

公司主要以直销模式销售产品，通过与客户商业谈判或招投标的方

式获取订单。

公司设有市场销售部负责市场竞争分析、销售预测与规划、市场开发和产品销售。设有设备工程部及工艺工程部为客户提供驻场服务设备工程部确保标的公司产品在客户生产环境中稳定、合规、高效地运行，最大化产品对客户价值，维护并深化客户关系，保障客户价值实现与满意度。具体包括负责标的公司产品在客户端的安装、调试、质保、维修、技术咨询及服务等相关工作。工艺工程部则确保标的公司产品实现工艺价值最大化，负责标的公司产品在客户端的导入、调试、工艺优化、需求对接与技术培训等相关工作。

#### （5）研发模式

公司产品研发主要采取自主研发模式，建立了多部门协同配合的自主创新机制，研发中心（机械工程部、电气工程部、先进技术研发部、工艺工程部、工艺核心技术部、软件部）、设备工程部和技术工程部对新技术、新产品进行协同研发。

#### （6）盈利模式

公司主营业务为高端化学机械抛光（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案，即通过向下游集成电路制造商、碳化硅功率器件厂商等销售 CMP 装备、抛光模组配置方案及研磨液供液系统等产品，并提供关键耗材与维保、升级等服务来实现收入和利润。

公司的核心竞争力如下：

#### （1）聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，在 CMP 后清洗技术、终点检测控制技术、APC 智能控制技术、CMP 工艺应用等核心领域实现重大创新突破并完全自主可控。公司是国内少数能

够自主创新制造 12 英寸 CMP 设备的企业，其设备采用 6 抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备 4 盘或 3 盘的架构模式。6 抛光盘的设计不仅可同时支持 3 盘工艺或 2 盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅大幅降低设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了公司在 CMP 设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

### （2）汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

公司创始团队来自浙江大学、南京大学等国内外知名高校，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，公司组建了一支兼具国际视野与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

### （3）公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，公司自主研发并生产的 CMP 设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良

好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

#### （4）设备核心模块自研实现自主可控

CMP 设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。公司已实现了诸如抛光头、旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研大幅降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产 CMP 设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

#### 主要长期股权投资概述

截至本次评估基准日，杭州众硅电子科技有限公司长期股权投资 4 项，账面原值 5,010,521.88 元，计提减值准备 10,521.88 元，账面净值 5,000,000.00 元。具体如下：

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例	长期股权投资 账面价值
1	众硅电子科技（上海）有限公司	2022/02	100%	5,000,000.00
2	SIZONE TECHNOLOGY(HK) LIMITED	2021/08	100%	-
3	众进芯科技（福建）有限公司	2023/12	99%	-
4	众恩芯科技（青岛）有限公司	2022/12	99%	-

注：截至本报告书出具日，众恩芯科技（青岛）有限公司、众进芯科技（福建）有限公司已变更为标的公司全资子公司。

#### 1、众硅电子科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号

## 2 楼

法定代表人：HAIYANG GU

注册资本：500 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 14 日

统一社会信用代码：91310000MA7GM08053

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （1）公司简介

众硅电子科技（上海）有限公司成立于 2022 年 2 月 14 日，公司注册资本为 500.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众硅电子科技（上海）有限公司实收资本 500.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00	500.00	100.00

### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 348.62 万元，负债为 2,078.80 万元，净资产-1,730.17 万元。截至评估基准日，实现营业收入 116.10 万元，净利润-717.90 万元。

## 2、众恩芯科技（青岛）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼 102 室 2026-0562（A）

法定代表人：朱琳

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91370220MAC6AK4762

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （1）公司简介

众恩芯科技（青岛）有限公司成立于 2022 年 12 月 19 日，公司注册资本为 1,000.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司和朱琳共同发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00
2	朱琳	10.00	1.00
	合计	1,000.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众恩芯科技（青岛）有限公司实收资本 0.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	朱琳	10.00	1.00	0.00	0.00
	合计	1,000.00	100.00	0.00	0.00

#### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 0.07 万元，负债为 0.20 万元，净资产为 -0.13 万元。截至评估基准日，实现

营业收入 0.00 万元，净利润-0.03 万元。

### 3、Sizone Technology (HK) Limited

公司类型：私人股份有限公司

公司地址：RM 1002, 10/F EASEY COMM, BLDG 253-261  
HENNESSY RD, WAN CHAI, HONG KONG

成立日期：2021 年 8 月 4 日

#### (1) 公司简介

Sizone Technology (HK) Limited 成立于 2021 年 8 月 4 日，公司注册资本为 1.00 万港元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万港元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00
合计		1.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，Sizone Technology (HK) Limited 实收资本 1.00 万港元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万港元）	注册比例%	实收资本（万港元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00	1.00	100.00
合计		1.00	100.00	1.00	100.00

#### (2) 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 0.00 万元，负债为 0.00 万元，净资产为 0.00 万元。截至评估基准日，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.62 万元。

### 4、众进芯科技（福建）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：福建省晋江市福兴东路罗山段 3 号

法定代表人：刘李

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91350582MAD7GFQT8Q

经营范围：一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （1）公司简介

众进芯科技（福建）有限公司成立于 2023 年 12 月 19 日，公司注册资本为 1,000.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众进芯科技（福建）有限公司实收资本 0.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	刘李	10.00	1.00	0.00	0.00
合计		1,000.00	100.00	0.00	0.00

### （2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，该公司尚未建账，资产总额为 0.00，净资产为 0.00。

### 委托人与被评估单位之间的关系

本次资产评估的委托人为中微半导体设备（上海）股份有限公司，被评估单位为杭州众硅电子科技有限公司。委托人为被评估单位的股东及股权拟收购方。

## 公司执行的主要会计政策

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2024 年度及 2025 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、重要性标准确定方法和选择依据

本集团结合自身所处的行业情况和生产经营特点，基于事项的性质和金额两方面综合判断相关财务信息的重要性。其中，根据该事项是否属于日常活动、是否显著影响财务状况、经营成果和现金流量等因素综合判断性质的重要性；根据该事项相关的金额及其占各项目金额、资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入和净利润等关键财务指标的比重综合判断金额的重要性。

项目	重要性标准
重要的投资活动现金流项目	单项投资现金流金额占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上且大于 10,000,000.00 元

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司及下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

### 5、企业合并

#### 一) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合

并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 二) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨

认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。当相关子公司被处置并丧失控制权时，上述内部交易损益得以实现，本集团相应调整处置子公司的当期损益。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币折算

### 一) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 二) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

### 一) 金融资产

#### 1) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于

其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### I) 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### a) 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### d) 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 2) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款和合同资产外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后

信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

关联方借款组合	关联方借款
押金组合	备用押金、保证金等信用风险较低的应收款项
银行承兑汇票	信用等级较高的全国性银行
应收账款组合	以初始确认时点作为账龄的起算时点
其他组合	除以上组合以外的应收款项，以初始确认时点作为账龄的起算时点

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、划分为组合的其他应收款和长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## 二) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及长期借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该

金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 三) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

### 四) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10、存货

### 一) 分类

存货包括原材料、在产品、发出商品和产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

### 二) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### 三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货

跌价准备。其中，对于原材料，本集团根据库龄、保管状态及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

四) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

### 一) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

### 二) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### 三）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金

额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 四）长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 五）周转材料的摊销方法

周转材料、包装物按照使用一次转销法进行摊销。

### 12、固定资产

#### 一）固定资产确认及初始计量

固定资产包括机器设备、办公设备以及运输工具等。

固定资产在与其相关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产相关的后续支出，在与其相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### 二）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5 年	5%	19.00%
办公设备	3 年	0%	33.33%
运输工具	5 年	5%	19.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

三) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

#### 四) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 13、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

### 14、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 15、无形资产

无形资产主要为软件，以成本计量。

### 一) 软件

购入的软件按照实际支付的价款作为实际成本，并按预计使用年限3年平均摊销。

### 二) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### 三) 研究与开发

本集团的研究开发支出主要包括本集团研发部门职工薪酬、实施研究开发活动而耗用的材料、股份支付费用、研发测试与维护费、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销等支出。

试制样机初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予

以资本化:

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证;
- 管理层已批准生产工艺开发的预算;
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力;
- 有足够的技术和资金支持,以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产;以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

#### 四) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

#### 16、长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 17、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、及对子公司、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产

的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

### 一) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 二) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，

当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 三）辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

### 19、股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

### 20、预计负债

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 21、收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

#### 一) 销售商品

本集团生产产品并销售予各地客户。

本集团将专用设备产品运至约定交货地点，进行安装、调试及验收。根据不同专用设备产品的类型及合同安排，经客户确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，本集团于控制权转移至客户时相应确认收入。

本集团将备品备件产品按照协议合同规定运至约定交货地点，经客户确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，本集团相应确认收入。

本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

#### 二) 提供服务收入

本集团对外提供抛光服务收入，通常在服务提供完成并且获取客户的验收单后，本集团相应确认收入。

## 22、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方

式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对于同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

a) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

b) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

#### 24、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以自身股份或其他权益工具为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足

市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

## 25、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物及办公设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届

满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

## 26、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信

息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

## 27、重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### 一) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### 1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验及外部评级等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括生产价格指数、国内生产总值和行业预测等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。

#### 2) 存货的跌价准备

存货的可变现净值是根据市场售价扣减相应的销售费用、合同履约成本以及相关税费进行估计的。这些估计是基于当时市况和产品销售的历史经验，可能由于市场环境变化而发生重大变更。管理层定期对此进行重新估计并相应进行调整。

#### 3) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本公司根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

在计算股份支付相关费用时，本公司结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

#### 4) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本公司的实际情况，本集团认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

## 二) 采用会计政策的关键判断

### 1) 客户确认专用设备产品的时点

本集团根据合同安排以及专用设备产品安装调试、验收过程中是否需要不断调整产品设计规格及参数、后续发生成本是否重大、历史经验、客户确认情况等判断客户是否确认相关产品。

## 28、重要会计政策变更

财政部于 2025 年发布了若干《企业会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”), 本集团一贯采用的会计政策与上述实施问答的原则一致, 该实施问答对本集团及本公司的财务报表没有重大影响。

此外, 财政部于 2025 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 19 号》, 并自 2026 年 1 月 1 日起施行。本集团及本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

## 29、税项

本集团适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率
企业所得税(a)	应纳税所得额	详见“一) 企业所得税”
增值税(b)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%及 13%
城市维护建设税(c)	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加(d)	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加(d)	缴纳的增值税税额	2%

### 一) 企业所得税

本集团按照《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“所得税法”) 计算及缴纳企业所得税。

本公司及控股子公司适用的所得税率情况如下:

	注册地	2025 年度 适用税率
本公司(注 1)	中国杭州市	15%

众硅电子科技(上海)有限公司 (“众硅上海”)(注 2)	中国上海市	5%
众硅电子科技(淮安)有限公司 (“众硅淮安”)(注 3)	中国淮安市	5%
众硅科技(香港)有限公司 (“众 硅香港”)(注 4)	中国香港	8.25%
众恩芯科技(青岛)有限公司 (“众硅青岛”)(注 5)	中国上海市	5%
众进芯科技(福建)有限公司 (“众硅福建”)(注 6)	中国泉州市	5%
本公司(注 1)	中国杭州市	15%

注 1：本公司为设立于杭州的生产性企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号)有关规定，于 2022 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15%的优惠税率。2025 年 12 月 19 日更新了高新技术企业的证书认定，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2024 年度及 2025 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

注 2：众硅上海为注册于上海的有限责任公司，该公司于 2024 年度及 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 5%。

注 3：众硅淮安为注册于淮安的有限责任公司，该公司于 2024 年度及 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 5%。

注 4：众硅香港该公司为注册于中华人民共和国香港特别行政区的有限责任公司，根据 2018 年 3 月 29 日中国香港特别行政区政府发布的《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》，自 2018 年 4 月 1 日起香港的利得税实行两级税率，利润低于或等于 200 万港币适用税率为 8.25%，高于 200 万港币部分的利润适用税率为 16.5%，因此众硅香港于 2024 年度及 2025 年度实际适用企业所得税税率为 8.25%。

注 5：众硅青岛硅为注册于青岛的有限责任公司，该公司于 2024 年度及 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 5%。

注 6：众硅福建硅为注册于福建的有限责任公司，该公司于 2024 年度及 2025 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 5%。

## 二) 增值税

本集团的产品销售、提供应税劳务以及提供应税服务适用一般计税方法，适用税率为 13%及 6%。本集团境内子公司增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可抵扣的进项税额后的余额。

### 三）城市维护建设税

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的一定比例缴纳城市维护建设税，本公司及下属子公司税率如下：

	税率
本公司	7%
众硅上海	7%
众硅淮安	7%
众硅青岛	7%
众硅福建	7%

### 三）教育费附加和地方教育费附加

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的 3% 缴纳教育费附加。

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的 2% 缴纳地方教育费附加。

### 关于经济行为的说明

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》，中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69% 股权。为此，中微半导体设备（上海）股份有限公司需了解杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益于评估基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值。

本次资产评估的目的是反映杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考。

### 关于评估对象与评估范围的说明

评估对象是杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值。评估范围为杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债。

根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后合并报表，合并

报表口径下公司资产总额为 102,212.56 万元，负债总额为 26,932.17 万元，净资产为 75,280.39 万元。其中，流动资产 96,359.75 万元，非流动资产 5,852.82 万元；流动负债 25,714.73 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后单体报表，公司资产总额为 104,275.53 万元，负债总额为 26,755.27 万元，净资产为 77,520.26 万元。其中，流动资产 98,014.37 万元，非流动资产 6,261.16 万元；流动负债 25,537.84 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

上述资产与负债数据摘自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

### 委估主要资产情况

本次评估范围中的主要资产为应收账款、存货、固定资产、无形资产等。其中，应收账款主要为应收下游客户设备销售货款；存货主要为生产 CMP 设备相关的原材料、委托加工物资、产成品、在产品、发出商品等；固定资产主要为经营用固定资产，包括车辆、机器设备及电子设备；无形资产主要为外购软件及账面未记录的专利权、软件著作权、商标、域名等。

### 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截至评估基准日，企业申报的账面记录的无形资产为 20 项外购软件，账面未记录的无形资产共 353 项。其中已注册中国境内商标共计 68 项，已注册中国境外商标共计 53 项，注册中的商标 3 项，软件著作权

8 项，已获批准的中国境内专利权 106 项，其中 42 项为发明专利、53 项为实用新型专利、11 项为外观设计专利，已获批准的中国境外专利权 114 项，其中 89 项为发明专利、23 项为外观设计专利、2 项为实用新型专利，域名 1 项，具体情况如下：

### 1、外购软件

序号	名称	取得日期	所有权人
1	中望 3D 软件	2025/08	杭州众硅电子科技有限公司
2	杭州北山科技有限公司中望 CAD 平台软件 5 套	2023/08	杭州众硅电子科技有限公司
3	中望 CAD 软件	2024/05	杭州众硅电子科技有限公司
4	中望 CAD 平台软件 V2020(5 套)	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
5	KeyShot11Pro	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
6	MATLAB	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
7	PLM 系统	2019/01	杭州众硅电子科技有限公司
8	ERP 系统	2019/09	杭州众硅电子科技有限公司
9	6400 网络安全系统一套	2021/09	杭州众硅电子科技有限公司
10	中望 3D 平台设计软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
11	中望 CAD 平台软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
12	中望 3D 平台设计软件 V2022	2021/07	杭州众硅电子科技有限公司
13	中望 3D 平台设计软件 V2023	2022/06	杭州众硅电子科技有限公司
14	中望 CAD2023 专业版	2022/08	杭州众硅电子科技有限公司
15	中望 3D2023 标准版升级	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
16	广州中望龙腾软件股份有限公司 杭州众硅 3D 产品功能开发费	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
17	中望 3D 平台设计软件 V2022 (5 套)	2022/11	杭州众硅电子科技有限公司
18	COMSOL	2022/10	杭州众硅电子科技有限公司
19	MDK	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
20	KEIL	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司

## 2、商标

境内商标明细如下：

序号	权利人	注册号	商标标识	专用权期限	使用类别
137	杭州众硅	83471595		5-09-07 至 2035-09-06	7类 机械设备
138	杭州众硅	80450440		5-07-07 至 2035-07-06	9类 科学仪器
139	杭州众硅	79453564		5-03-28 至 2035-03-27	9类 科学仪器
140	杭州众硅	78465551		4-10-28 至 2034-10-27	9类 科学仪器
141	杭州众硅	78465536		4-10-28 至 2034-10-27	7类 机械设备
142	杭州众硅	76918083		2024-08-28 至 2034-08-27	7类 机械设备
143	杭州众硅	76541431		4-07-28 至 2034-07-27	7类 机械设备
144	杭州众硅	76532744		4-07-21 至 2034-07-20	9类 科学仪器
145	杭州众硅	76100178		4-07-14 至 2034-07-13	7类 机械设备
146	杭州众硅	76120133		4-07-14 至 2034-07-13	9类 科学仪器
147	杭州众硅	75675889		4-08-21 至 2034-08-20	9类 科学仪器

148	杭州众硅	75684558	<b>sView</b>	4-06-07 至 2034-06-06	7 类 机械设备
149	杭州众硅	75681896	<b>eView</b>	4-08-21 至 2034-08-20	7 类 机械设备
150	杭州众硅	75681934	<b>sView</b>	5-06-14 至 2035-06-13	9 类 科学仪器
151	杭州众硅	75374290	<b>mMAP</b>	4-08-21 至 2034-08-20	7 类 机械设备
152	杭州众硅	75354106	<b>mMAP</b>	4-08-14 至 2034-08-13	9 类 科学仪器
153	杭州众硅	75364792	<b>eMAP</b>	4-06-07 至 2034-06-06	9 类 科学仪器
154	杭州众硅	75354086	<b>eMAP</b>	4-06-07 至 2034-06-06	7 类 机械设备
155	杭州众硅	75285972A	<b>CMP<sup>e</sup></b>	4-06-14 至 2034-06-13	7 类 机械设备
156	杭州众硅	75285972	<b>CMP<sup>e</sup></b>	5-06-21 至 2035-06-20	7 类 机械设备
157	杭州众硅	74918117	<b>eHEAD</b>	4-05-28 至 2034-05-27	7 类 机械设备
158	杭州众硅	73335681	<b>h-CMP</b>	4-02-07 至 2034-02-06	7 类 机械设备
159	杭州众硅	73345937	<b>h-CMP</b>	4-02-14 至 2034-02-13	9 类 科学仪器
160	杭州众硅	73263142	<b>preMAP</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	9 类 科学仪器


161	杭州众硅	73266569	<b>TTAI</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	7 类 机械设备
162	杭州众硅	73247718	<b>TTAI</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	9 类 科学仪器
163	杭州众硅	73254489	<b>preMAP</b>	2024-04-07 至 2034-04-06	7 类 机械设备
164	杭州众硅	71449178		2023-10-28 至 2033-10-27	3 类 日化用品
165	杭州众硅	71453805	<b>SIZONE</b>	4-02-28 至 2034-02-27	9 类 科学仪器
166	杭州众硅	71324724	<b>SIZONE</b>	4-12-07 至 2034-12-06	42 类 设计研究
167	杭州众硅	71046046	<b>wCMP</b>	4-04-21 至 2034-04-20	9 类 科学仪器
168	杭州众硅	71043369	<b>tCMP</b>	3-10-21 至 2033-10-20	7 类 机械设备
169	杭州众硅	71054635	<b>tCMP</b>	3-10-07 至 2033-10-06	9 类 科学仪器
170	杭州众硅	71040472	<b>wCMP</b>	3-10-07 至 2033-10-06	7 类 机械设备
171	杭州众硅	69985134	<b>CMPe</b>	01-21 至 2034-01-20	9 类 科学仪器
172	杭州众硅	69474158	<b>ZHONG GUI</b>	4-03-21 至 2034-03-20	7 类 机械设备
173	杭州众硅	69130284		2023-09-21 至 2033-09-20	7 类 机械设备



174	杭州众硅	69135169	<b>TTAIS</b>	2023-09-21 至 2033-09-20	9 类 科学仪器
175	杭州众硅	69134470	 SIZONE	2023-09-21 至 2033-09-20	40 类 材料加工
176	杭州众硅	69120026	 SIZONE	2023-10-07 至 2033-10-06	1 类 化学原料
177	杭州众硅	69120069	 SIZONE	2023-09-14 至 2033-09-13	37 类 建筑修理
178	杭州众硅	69136420	<b>TTAIS</b>	2023-09-07 至 2033-09-06	7 类 机械设备
179	杭州众硅	69129658	 SIZONE	2024-11-28 至 2034-11-27	42 类 设计研究
180	杭州众硅	67125479	<b>sCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
181	杭州众硅	67129953	<b>sCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	9 类 科学仪器
182	杭州众硅	67116815	<b>xCMP</b>	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
183	杭州众硅	65713545	<b>TNTAS</b>	2023-01-21 至 2033-01-20	9 类 科学仪器
184	杭州众硅	65715828	<b>TTAIS</b>	2024-04-14 至 2034-04-13	7 类 机械设备
185	杭州众硅	65720217	<b>TMTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备
186	杭州众硅	65734434	<b>TNTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备

187	杭州众硅	65713519	<b>TTAISN</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	9 类 科学仪器
188	杭州众硅	65718889	<b>TMTAS</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	9 类 科学仪器
189	杭州众硅	65738714	<b>TTAIS</b>	2023-03-21 至 2033-03-20	9 类 科学仪器
190	杭州众硅	65738637	<b>TTAISN</b>	2023-01-14 至 2033-01-13	7 类 机械设备
191	杭州众硅	65715828A	<b>TTAIS</b>	2023-02-28 至 2033-02-27	7 类 机械设备
192	杭州众硅	65341636	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
193	杭州众硅	65352408	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
194	杭州众硅	65344838	SIZONE SDS	2022-11-28 至 2032-11-27	7 类 机械设备
195	杭州众硅	65344892	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
196	杭州众硅	65352855	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
197	杭州众硅	65352699	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
198	杭州众硅	65337973	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
199	杭州众硅	65352697	SIZONE SDS	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器

200	杭州众硅	34700114		2019-07-07 至 2029-07-06	9 类 科学仪器
201	杭州众硅	34700098		2019-07-07 至 2029-07-06	7 类 机械设备
202	杭州众硅	32274636		2019-04-07 至 2029-04-06	9 类 科学仪器
203	杭州众硅	32274633		2019-12-21 至 2029-12-20	7 类 机械设备
204	杭州众硅	32279159		2020-04-21 至 2030-04-20	9 类 科学仪器

境外商标明细如下：

序号	商标名称	国家/地区/组织	注册地	注册号	类别	注册日	有效期	权利人	取得方式	他项权利
107		马德里国际注册	日本	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
108			日本	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
109			韩国	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
110			韩国	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
111			美国	6297605	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
112			美国	6291605	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
113			欧盟	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
114			欧盟	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
115			新加坡	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
116			新加坡	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
117				中国台湾	中国台湾	02109945	7 类、	2020-12-16	2030-12-15	杭州众硅

					9类					
118		马德里国际注册	日本	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
119		日本	日本	6387275	9类	2021-05-11	2031-05-11	杭州众硅	原始取得	无
120		马德里国际注册	韩国	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
121		韩国	韩国	40-1752832	9类	2021-07-15	2031-07-15	杭州众硅	原始取得	无
122		马德里国际注册	美国	6268972	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
123		美国	美国	6444084	9类	2021-08-10	2031-08-10	杭州众硅	原始取得	无
124		马德里国际注册	欧盟	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
125		欧盟	欧盟	018224343	9类	2020-08-01	2030-04-10	杭州众硅	原始取得	无
126		马德里国际注册	新加坡	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
127		新加坡	新加坡	40202009597U	9类	2020-05-08	2030-05-08	杭州众硅	原始取得	无
128	中国台湾	中国台湾	02099392	7类、9类	2020-11-01	2030-10-31	杭州众硅	原始取得	无	
129		欧盟	欧盟	018823748	7类、9类	2023-06-14	2033-01-19	杭州众硅	原始取得	无
130		韩国	韩国	40-2270814	7类	2024-11-08	2034-11-08	杭州众硅	原始取得	无
131		韩国	韩国	40-2270830	9类	2024-11-04	2034-11-04	杭州众硅	原始取得	无
132		日本	日本	6717320	7类、9类	2023-07-13	2033-07-13	杭州众硅	原始取得	无
133		新加坡	新加坡	40202302136W	7类、9类	2023-02-07	2033-02-07	杭州众硅	原始取得	无

134		中国台湾	中国台湾	02316528	7类	2023-09-01	2033-08-31	杭州众硅	原始取得	无
135		中国台湾	中国台湾	02316740	9类	2023-09-01	2033-08-31	杭州众硅	原始取得	无
136		美国	美国	7666240	7类、9类	2025-01-28	2035-01-29	杭州众硅	原始取得	无
137	<b>TNTAS</b>	欧盟	欧盟	018865670	7类、9类	2023-09-12	2033-04-21	杭州众硅	原始取得	无
138		日本	日本	6747127	7类、9类	2023-10-20	2033-10-20	杭州众硅	原始取得	无
139		中国台湾	中国台湾	02334452	7类	2023-11-16	2033-11-15	杭州众硅	原始取得	无
140		中国台湾	中国台湾	02334712	9类	2023-11-16	2033-11-15	杭州众硅	原始取得	无
141		新加坡	新加坡	40202309676Y	7类、9类	2024-03-13	2033-05-04	杭州众硅	原始取得	无
142		美国	美国	7432079	7类、9类	2024-07-02	2034-07-03	杭州众硅	原始取得	无
143		韩国	韩国	40-2283338	7类	2024-12-02	2034-12-01	杭州众硅	原始取得	无
144		韩国	韩国	40-2283341	9类	2024-12-02	2034-12-01	杭州众硅	原始取得	无
145	<b>mCMP</b>	新加坡	新加坡	40202501796W	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
146		中国台湾	中国台湾	02484328	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
147	<b>tCMP</b>	新加坡	新加坡	40202501797R	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
148		中国台湾	中国台湾	02484327	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
149	<b>xCMP</b>	新加坡	新加坡	40202501798P	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
150		中国台湾	中国台湾	02484326	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
151		新加坡	新加坡	40202501793X	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无

152	<b>dView</b>	中国台湾	中国台湾	02474470	9类	2025-08-16	2035-08-15	杭州众硅	原始取得	无
153	<b>eView</b>	新加坡	新加坡	40202501792S	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
154		中国台湾	中国台湾	02484467	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
155	<b>sView</b>	新加坡	新加坡	40202501794V	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
156		中国台湾	中国台湾	02484466	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
157	<b>mCMP</b>	美国	美国	7982584	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
158	<b>tCMP</b>	美国	美国	7982583	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
159	<b>xCMP</b>	美国	美国	7982582	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无

注册中的商标明细如下:

序号	内容或名称	取得日期	专利号或注册号
1		2025/02	78483204
2		2025/02	83718856
3		2025/02	83708238

### 3、软件著作权

序号	权利人	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	首次发表日	他项权利
1	杭州众硅	Sizone Canaan CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第3979698号	2019SR0558941	原始取得	未发表	无
2	杭州众硅	Sizone SINAI CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第6652088号	2020SR1849086	原始取得	未发表	无
3	杭州众硅	Sizone ZION CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第7676983号	2021SR0954357	原始取得	未发表	无
4	杭州众硅	Sizone DRACO CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第9688894号	2022SR0734695	原始取得	未发表	无
5	杭州众硅	SDS 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第9639224号	2022SR0685025	原始取得	未发表	无

序号	权利人	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	首次发表日	他项权利
6	杭州众硅	Sizone SHEBA CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第11645217号	2023SR1058044	原始取得	未发表	无
7	杭州众硅	Sizone LAMB CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第11646342号	2023SR1059169	原始取得	未发表	无
8	杭州众硅	Sizone Dove 第三代半导体系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第12283993号	2023SR1696820	原始取得	未发表	无

#### 14、专利

中国境内专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得途径	法律状态	他项权利
1	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023112396583	2023-09-22	发明	原始取得	授权	无
2	杭州众硅	一种抛光垫沟槽在线修整方法及装置	2025112141085	2025-08-28	发明	原始取得	授权	无
3	杭州众硅	一种用于晶圆清洗装置的从动机构及晶圆清洗装置	2025113685359	2025-09-24	发明	原始取得	授权	无
4	杭州众硅	一种化学机械抛光在线监测方法	2025110653799	2025-07-31	发明	原始取得	授权	无
5	杭州众硅	一种用于 CMP 设备抛光垫沟槽修整的方法	2023112936007	2023-10-08	发明	原始取得	授权	无
6	杭州众硅	站立式晶圆卡座	202111533401X	2021-12-15	发明	原始取得	授权	无
7	杭州众硅	一种可调平式抛光盘及抛光系统	2024223742429	2024-09-27	实用新型	原始取得	授权	无
8	杭州众硅	一种晶圆提拉结构	2025103110213	2025-03-17	发明	原始取得	授权	无
9	杭州众硅	一种用于快速调温的化学液输送单元及化学机械平坦化设备	2024206596934	2024-04-01	实用新型	原始取得	授权	无
10	杭州众硅	抛光研磨装置	2024304771328	2024-07-30	外观设计	原始取得	授权	无
11	杭州众硅	一种电化学机械抛光及平坦化装置	2024211355783	2024-05-23	实用新型	原始取得	授权	无
12	杭州众硅	一种用于半导体湿法设备的晶圆定位检测方法	2024116930911	2024-11-25	发明	原始取得	授权	无
13	杭州众硅	一种用于电化学机械平坦化设备的电抛光头、导电	2025101877875	2025-02-20	发明	原始取得	授权	无

		系统及其装配方法						
14	杭州众硅	联动式单动力源控制间停机构、晶圆修整机构及工作方法	2024116669404	2024-11-21	发明	原始取得	授权	无
15	杭州众硅	一种晶圆搬运装置及抛光系统、抛光工艺	2024116612270	2024-11-20	发明	原始取得	授权	无
16	杭州众硅	一种抛光垫及晶圆抛光系统	2024203287163	2024-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
17	杭州众硅	一种化学机械抛光及平坦化系统	2024204236775	2024-03-05	实用新型	原始取得	授权	无
18	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2024202256223	2024-01-30	实用新型	原始取得	授权	无
19	杭州众硅	一种用于导电晶圆的传输装置	2024208760026	2024-04-25	实用新型	原始取得	授权	无
20	杭州众硅	一种带有压力检测的修整装置	2024210918589	2024-05-17	实用新型	原始取得	授权	无
21	杭州众硅	一种晶圆旋转干燥装置	2024206000894	2024-03-26	实用新型	原始取得	授权	无
22	杭州众硅	化学机械平坦化装置	2024301324801	2024-03-15	外观设计	原始取得	授权	无
23	杭州众硅	抛光研磨装置	2024300460724	2024-01-24	外观设计	原始取得	授权	无
24	杭州众硅	一种导电型晶圆化学机械抛光系统	2023233277503	2023-12-05	实用新型	原始取得	授权	无
25	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法	2019104814482	2019-06-04	发明	原始取得	授权	无
26	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023226009702	2023-09-22	实用新型	原始取得	授权	无
27	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	2021104070747	2021-04-15	发明	原始取得	授权	无
28	杭州众硅	一种晶圆传输机械手	2021102933431	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
29	杭州众硅	晶圆夹持臂夹爪	2022305192323	2022-08-10	外观设计	原始取得	授权	无
30	杭州众硅	一种可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	2020113382226	2020-11-25	发明	原始取得	授权	无
31	杭州众硅	晶圆抛光系统	2023218495446	2023-07-13	实用新型	原始取得	授权	无
32	杭州众硅	一种晶圆传输装置	2023216687244	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
33	杭州众硅	一种晶圆传输监测系统	2023218599746	2023-07-13	实用新型	原始取得	授权	无

34	杭州众硅	一种预清洗输入装置	2023216754959	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
35	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2023216722892	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
36	杭州众硅	一种 CMP 抛光垫再加工装置	2023216039222	2023-06-21	实用新型	原始取得	授权	无
37	杭州众硅	一种用于半导体清洗单元的晶圆有无检测装置	2023208720594	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
38	杭州众硅	一种拼接式工作台机构	2023209035886	2023-04-20	实用新型	原始取得	授权	无
39	杭州众硅	一种晶圆清洁干燥模组状态检测方法、装置及平坦化设备	2022105084239	2022-05-11	发明	原始取得	授权	无
40	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2023203161480	2023-02-14	实用新型	原始取得	授权	无
41	杭州众硅	一种抛光垫加工装置	2022229899063	2022-11-07	实用新型	原始取得	授权	无
42	杭州众硅	一种晶圆清洗箱	2023201723676	2023-01-13	实用新型	原始取得	授权	无
43	杭州众硅	一种排风脏污收集装置及化学机械平坦化抛光设备	2023208367028	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
44	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229651320	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
45	杭州众硅	应用于导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229771233	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
46	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械抛光及平坦化系统	2022229614336	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
47	杭州众硅	一种晶圆干燥装置	2023205456301	2023-03-14	实用新型	原始取得	授权	无
48	杭州众硅	一种用于化学机械平坦化白光终点检测的采集方法及系统	2022106070657	2022-05-31	发明	原始取得	授权	无
49	杭州众硅	一种导电型抛光头固定装置及导电型抛光头系统	2022231254625	2022-11-23	实用新型	原始取得	授权	无
50	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023201637007	2023-01-13	实用新型	原始取得	授权	无
51	杭州众硅	晶圆夹持器	2022305191918	2022-08-10	外观设计	原始取得	授权	无
52	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022234891659	2022-12-22	实用新型	原始取得	授权	无

53	杭州众硅	一种晶圆干燥抬升方法	2023102418938	2023-03-14	发明	原始取得	授权	无
54	杭州众硅	一种晶圆有无检测的提拉结构机械手	2022228546755	2022-10-26	实用新型	原始取得	授权	无
55	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	2022103161527	2022-03-29	发明	原始取得	授权	无
56	杭州众硅	一种清洗刷预清洗系统	2020101573307	2020-03-09	发明	原始取得	授权	无
57	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022112694450	2022-10-18	发明	原始取得	授权	无
58	杭州众硅	抛光研磨装置(150&300)	2022304099308	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无
59	杭州众硅	一种涡流终点检测装置及方法	2022112574529	2022-10-14	发明	原始取得	授权	无
60	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	202222128694X	2022-08-12	实用新型	原始取得	授权	无
61	杭州众硅	一种晶圆循环清洗系统	2022221015365	2022-08-10	实用新型	原始取得	授权	无
62	杭州众硅	一种晶圆夹持装置	2022220957792	2022-08-10	实用新型	原始取得	授权	无
63	杭州众硅	抛光研磨装置(300β)	2022304103360	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无
64	杭州众硅	抛光研磨装置(200s)	2022304096846	2022-06-30	外观设计	原始取得	授权	无
65	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	2022107327358	2022-06-27	发明	原始取得	授权	无
66	杭州众硅	一种晶圆搬运装置	2022214128871	2022-06-07	实用新型	原始取得	授权	无
67	杭州众硅	供液装置	2022305164982	2022-08-09	外观设计	原始取得	授权	无
68	杭州众硅	清洗装置	2022305055190	2022-08-04	外观设计	原始取得	授权	无
69	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2022216587824	2022-06-30	实用新型	原始取得	授权	无
70	杭州众硅	一种晶圆传递装置	2022207093191	2022-03-29	实用新型	原始取得	授权	无
71	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2021114452396	2021-11-30	发明	原始取得	授权	无
72	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置	2022209517117	2022-04-24	实用新型	原始取得	授权	无
73	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2021230946535	2021-12-10	实用新型	原始取得	授权	无

74	杭州众硅	一种提拉式晶圆传输机构	2022202326195	2022-01-26	实用新型	原始取得	授权	无
75	杭州众硅	一种晶圆检测系统	2022203603706	2022-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
76	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229713411	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无
77	杭州众硅	一种动态检测装置及化学机械平坦化设备	2022101643690	2022-02-23	发明	原始取得	授权	无
78	杭州众硅	晶圆驱动机构	2021230426920	2021-12-06	实用新型	原始取得	授权	无
79	杭州众硅	一种站立式晶圆卡座	2021231583806	2021-12-15	实用新型	原始取得	授权	无
80	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	2022100041307	2022-01-05	发明	原始取得	授权	无
81	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法及检测系统	2022100773979	2022-01-24	发明	原始取得	授权	无
82	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229694980	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无
83	杭州众硅	一种晶圆抛光装置	2021112182640	2021-10-20	发明	原始取得	授权	无
84	杭州众硅	一种用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	2021114722319	2021-12-06	发明	原始取得	授权	无
85	杭州众硅	一种晶圆紧固装置	2021216969237	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
86	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	2021225192769	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
87	杭州众硅	一种用于晶圆的紧固装置	2021216969256	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
88	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	2021225191535	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
89	杭州众硅	晶圆紧固装置	2021216940328	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
90	杭州众硅	抛光装置	2021304973519	2021-08-03	外观设计	原始取得	授权	无
91	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥方法及机构	2021108994674	2021-08-06	发明	原始取得	授权	无
92	杭州众硅	一种多工位夹取装置	202110770071X	2021-07-08	发明	原始取得	授权	无
93	杭州众硅	一种晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	2019104403343	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
94	杭州众硅	一种结合研磨和单晶圆清洗模组的化学机械平坦化	2019111130957	2019-11-14	发明	原始取得	授权	无

		设备						
95	杭州众硅	一种抛光装置	202011419911X	2020-12-08	发明	原始取得	授权	无
96	杭州众硅	用于化学机械平坦化设备的抛光头压力控制设备及方法	2019113033010	2019-12-17	发明	原始取得	授权	无
97	杭州众硅	抛光头检测装置、腔室气密性和传感器有效性检测方法	2021104488565	2021-04-25	发明	原始取得	授权	无
98	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	2021102490467	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
99	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	2021102490255	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
100	杭州众硅	一种晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	2019108427084	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
101	杭州众硅	一种晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	2020107204397	2020-07-24	发明	原始取得	授权	无
102	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2020102077484	2020-03-23	发明	原始取得	授权	无
103	杭州众硅	基于光谱的化学机械抛光在线终点检测方法	2019104403451	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
104	杭州众硅	一种化学机械抛光平坦化晶圆传输设备	2019208326110	2019-06-04	实用新型	原始取得	授权	无
105	杭州众硅	一种晶圆清洗装置	2019209736837	2019-06-26	实用新型	原始取得	授权	无
106	杭州众硅	内置式双重限位机构	2019202198142	2019-02-21	实用新型	原始取得	授权	无

中国境外专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	国家/地区/组织	专利号	申请日	授权日	专利类型	取得方式	他项权利
229	杭州众硅	一种抛光装卸部件模块	美国	US 12,194,592 B2	2021-03-22	2025-01-14	发明	原始取得	无
230	杭州众硅		新加坡	11202102935Q	2019-08-28	2025-08-12	发明	原始取得	无
231	杭州众硅		韩国	10-2584030	2021-04-19	2023-09-25	发明	原始取得	无
232	杭州众硅	用于 CMP 工艺的晶片装载支	美国	US 12,103,134	2019-09-04	2024-10-01	发明	原始取得	无

		架、晶片装载系统和晶片安装方法		B2					
233	杭州众硅		新加坡	11202111470X	2019-09-04	2025-01-27	发明	原始取得	无
234	杭州众硅		韩国	10-2605197	2021-09-13	2023-11-20	发明	原始取得	无
235	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法、晶圆平坦化单元	美国	US 12,251,785 B2	2019-08-20	2025-03-18	发明	原始取得	无
236	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆转移方法、晶圆平坦化装置	韩国	10-2533567	2021-04-07	2023-05-12	发明	原始取得	无
237	杭州众硅		新加坡	11202103477T	2019-08-20	2023-09-19	发明	原始取得	无
238	杭州众硅	晶圆检测装置及使用该装置的晶圆检测方法	美国	US 11,961,749 B2	2020-08-04	2024-04-16	发明	原始取得	无
239	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备、晶圆传送机器人及晶圆翻转方法	韩国	10-2709839	2021-04-27	2024-09-20	发明	原始取得	无
240	杭州众硅		新加坡	11202103852Y	2019-09-26	2024-02-08	发明	原始取得	无
241	杭州众硅		美国	US 11,908,720 B2	2021-04-09	2024-02-20	发明	原始取得	无
242	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	美国	US 12,482,674 B2	2020-09-29	2025-11-25	发明	原始取得	无
243	杭州众硅		韩国	10-2705137	2022-06-20	2024-09-05	发明	原始取得	无
244	杭州众硅	晶圆输送装置、化学机械平坦	美国	US 12,427,619	2020-08-06	2025-09-30	发明	原始取得	无

		化装置及晶圆 输送方法		B2					
245	杭州 众硅	晶圆位置检测 装置	日本	7638389	2021- 10-20	2025- 02-20	发明	原始 取得	无
246	杭州 众硅		韩国	10-2858973	2023- 09-08	2025- 09-09	发明	原始 取得	无
247	杭州 众硅	一种标定抛光 头和装卸台工 作位置的装置 和方法	日本	7714253	2022- 10-14	2025- 07-18	发明	原始 取得	无
248	杭州 众硅	晶圆抛光系统	韩国	10-2837898	2024- 02-14	2025- 07-21	发明	原始 取得	无
249	杭州 众硅		日本	7712007	2022- 08-30	2025- 07-14	发明	原始 取得	无
250	杭州 众硅	晶圆抛光装置	美国	US 11,794,304 B2	2022- 01-19	2023- 10-24	发明	原始 取得	无
251	杭州 众硅		韩国	10-2693838	2022- 02-24	2024- 08-06	发明	原始 取得	无
252	杭州 众硅		新加坡	1020220157 1V	2022- 02-18	2024- 08-21	发明	原始 取得	无
253	杭州 众硅	晶圆抛光系统	日本	7728045	2022- 08-30	2025- 08-14	发明	原始 取得	无
254	杭州 众硅		韩国	10-2837898	2024- 02-14	2025- 07-21	发明	原始 取得	无
255	杭州 众硅	抛光研磨装置	美国	US D1, 018, 612 S	2022- 10-19	2024- 03-19	外观 设计	原始 取得	无
256	杭州 众硅		韩国	DM/226149	2022- 10-19	2023- 11-28	外观 设计	原始 取得	无
257	杭州 众硅		新加坡	DM/226149	2022- 10-19	2022- 10-19	外观 设计	原始 取得	无
258	杭州 众硅		日本	1748952	2022- 10-19	2023- 07-10	外观 设计	原始 取得	无
259	杭州 众硅		欧盟	DM/226149	2022- 10-19	2022- 10-19	外观 设计	原始 取得	无
260	杭州 众硅	抛光研磨装置	美国	US D1, 018, 613 S	2022- 10-19	2024- 03-19	外观 设计	原始 取得	无
261	杭州 众硅		韩国	DM/226151	2022- 10-19	2023- 11-28	外观 设计	原始 取得	无
262	杭州		新加坡	DM/226151	2022-	2022-	外观	原始	无

	众硅				10-19	10-19	设计	取得	
263	杭州众硅		日本	1748953	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
264	杭州众硅		欧盟	DM/226151	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
265	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	美国	US 12,017,293 B2	2023-01-19	2024-06-25	发明	原始取得	无
266	杭州众硅		欧盟	EP 4364890	2023-03-15	2025-07-02	发明	原始取得	无
267	杭州众硅		韩国	10-2819458	2023-03-30	2025-06-09	发明	原始取得	无
268	杭州众硅		日本	7688074	2023-05-30	2025-05-26	发明	原始取得	无
269	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	日本	3253377	2022-11-09	2025-10-16	实用新型	原始取得	无
270	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	日本	7660959	2022-11-09	2025-04-04	发明	原始取得	无
271	杭州众硅	用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	日本	7788191	2022-11-09	2025-12-10	发明	原始取得	无
272	杭州众硅	抛光垫修整装置	日本	7773262	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
273	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	日本	7773261	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
274	杭州众硅	抛光垫表面状况在线检测方法及其检测系统	韩国	10-2904378	2024-06-13	2025-12-22	发明	原始取得	无
275	杭州众硅	晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	韩国	10-2816529	2024-07-17	2025-05-29	发明	原始取得	无
276	杭州众硅	抛光研磨装置 (ECMP 外观)	韩国	DM/237809	2024-05-23	2025-02-17	外观设计	原始取得	无
277	杭州众硅		加拿大	231357	2024-05-23	2025-04-03	外观设计	原始取得	无
278	杭州众硅		日本	1790565	2024-05-23	2025-01-27	外观设计	原始取得	无

279	杭州众硅		欧盟	DM/237809	2024-05-23	2024-07-11	外观设计	原始取得	无
280	杭州众硅	抛光研磨装置 (TANAS,EFE MT形)	韩国	DM/240665	2024-08-29	2025-07-25	外观设计	原始取得	无
281	杭州众硅		日本	1794400	2024-08-29	2025-03-17	外观设计	原始取得	无
282	杭州众硅		日本	1799656	2024-08-29	2025-05-19	外观设计	原始取得	无
283	杭州众硅		欧盟	DM/240665	2024-08-29	2024-10-28	外观设计	原始取得	无
284	杭州众硅	包含可移动装卸模组的研磨装卸构件模组及其晶圆传输方法	中国台湾	I 731281	2018-11-26	2021-06-21	发明	原始取得	无
285	杭州众硅	可挠性的抛光装卸部件模组及晶圆传输的方法	中国台湾	I 739048	2018-11-19	2021-09-11	发明	原始取得	无
286	杭州众硅	CMP 制程的晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	中国台湾	I 713141	2019-11-25	2020-12-11	发明	原始取得	无
287	杭州众硅	化学机械研磨设备	中国台湾	I 806931	2018-11-22	2023-07-01	发明	原始取得	无
288	杭州众硅	化学机械平坦化晶圆传输设备及其使用方法	中国台湾	I 717119	2019-11-22	2021-01-21	发明	原始取得	无
289	杭州众硅	晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	中国台湾	I 773943	2019-11-25	2022-08-11	发明	原始取得	无
290	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备	中国台湾	I 695422	2018-11-20	2020-06-01	发明	原始取得	无
291	杭州众硅	清洗刷预清洗系统	中国台湾	I 757924	2020-10-22	2022-03-11	发明	原始取得	无
292	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	中国台湾	I 837429	2020-10-22	2024-04-01	发明	原始取得	无
293	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无

294	杭州众硅	晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	中国台湾	I 734635	2020-10-22	2021-07-21	发明	原始取得	无
295	杭州众硅	可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	中国台湾	I 823141	2021-09-08	2023-11-21	发明	原始取得	无
296	杭州众硅	抛光装置	中国台湾	I 815179	2021-09-08	2023-09-11	发明	原始取得	无
297	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	中国台湾	I 794963	2021-09-08	2023-03-01	发明	原始取得	无
298	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	中国台湾	I 787998	2021-09-08	2022-12-21	发明	原始取得	无
299	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	中国台湾	I 834990	2021-09-08	2024-03-11	发明	原始取得	无
300	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	中国台湾	I 816394	2022-05-11	2023-09-21	发明	原始取得	无
301	杭州众硅	一种修整头旋转部件、抛光垫修整头和修整器	中国台湾	I 801997	2021-09-08	2023-05-11	发明	原始取得	无
302	杭州众硅	多工位夹取装置	中国台湾	I 816180	2021-09-08	2023-09-21	发明	原始取得	无
303	杭州众硅	晶圆清洗干燥方法及晶圆清洗干燥机构	中国台湾	I 803379	2022-07-01	2023-05-21	发明	原始取得	无
304	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 825934	2022-08-22	2023-12-11	发明	原始取得	无
305	杭州众硅	一种晶圆研磨装置	中国台湾	I 829054	2021-12-23	2024-01-11	发明	原始取得	无
306	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	中国台湾	I 839861	2022-09-26	2024-04-21	发明	原始取得	无
307	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	中国台湾	I 808023	2022-10-14	2023-07-01	发明	原始取得	无

308	杭州众硅	晶圆寻位方法	中国台湾	I 816576	2022-10-14	2023-09-21	发明	原始取得	无
309	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 818688	2022-08-23	2023-10-11	发明	原始取得	无
310	杭州众硅	晶圆驱动机构	中国台湾	I 817770	2022-10-14	2023-10-01	发明	原始取得	无
311	杭州众硅	站立式晶圆卡座	中国台湾	I 857368	2022-10-17	2024-10-01	发明	原始取得	无
312	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	中国台湾	I 820968	2022-10-17	2023-11-01	发明	原始取得	无
313	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	中国台湾	I 834448	2022-12-23	2024-03-01	发明	原始取得	无
314	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法及检测系统	中国台湾	I 829393	2022-10-17	2024-01-11	发明	原始取得	无
315	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、其装载方法及使用方法	中国台湾	I 823623	2022-10-17	2023-11-21	发明	原始取得	无
316	杭州众硅	晶圆清洁干燥模块状态检测方法、装置及平坦化设备	中国台湾	I 874908	2023-02-09	2025-03-01	发明	原始取得	无
317	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	中国台湾	I 838117	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无
318	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆传输方法	中国台湾	I 896992	2023-06-29	2025-09-11	发明	原始取得	无
319	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225666	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
320	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225667	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
321	杭州众硅	涡流终点检测装置及方法	中国台湾	I 854476	2023-02-07	2024-09-01	发明	原始取得	无
322	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	中国台湾	I 838116	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无

323	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无
324	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械研磨系统	中国台湾	I 869019	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
325	杭州众硅	研磨垫再利用加工装置	中国台湾	I 899689	2023-11-03	2025-10-01	发明	原始取得	无
326	杭州众硅	一种导电型研磨头固定装置及导电型研磨头系统	中国台湾	I 866602	2023-11-10	2024-12-11	发明	原始取得	无
327	杭州众硅	导电吸附膜及抛光头	中国台湾	I 845382	2023-07-21	2024-06-11	发明	原始取得	无
328	杭州众硅	一种用于 CMP 设备研磨垫沟槽修整的方法	中国台湾	I 869022	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
329	杭州众硅	晶圆研磨系统及晶圆处理方法	中国台湾	I 886965	2024-05-20	2025-06-11	发明	原始取得	无
330	杭州众硅	可调式晶圆装卸台	中国台湾	I 896134	2024-05-20	2025-09-01	发明	原始取得	无
331	杭州众硅	用于改善边缘研磨均匀性的研磨装置	中国台湾	I 900014	2024-05-21	2025-10-01	发明	原始取得	无
332	杭州众硅	一种用于 CMP 清洁干燥模组的检测装置及检测方法	中国台湾	I 886962	2024-05-17	2025-06-11	发明	原始取得	无
333	杭州众硅	一种化学机械研磨及平坦化系统	中国台湾	I 891372	2024-05-17	2025-07-21	发明	原始取得	无
334	杭州众硅	一种电化学机械研磨及平坦化装置	中国台湾	I 896171	2024-06-18	2025-09-01	发明	原始取得	无
335	杭州众硅	一种研磨头清洗方法及清洗装置	中国台湾	I 863868	2024-05-17	2024-11-21	发明	原始取得	无
336	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 234468	2024-05-22	2024-10-21	外观设计	原始取得	无

337	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 240377	2024-11-15	2025-09-11	外观设计	原始取得	无
338	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 241113	2024-11-15	2025-10-21	外观设计	原始取得	无
339	杭州众硅	化学机械抛光的在线监测装置	中国台湾	I 862202	2023-10-03	2024-11-11	发明	原始取得	无
340	杭州众硅	晶圆研磨系统	中国台湾	I 892653	2024-05-20	2025-08-01	发明	原始取得	无
341	杭州众硅	晶圆抛光系统、安装方法及使用方法	日本	7736360	2023-01-09	2025-09-01	发明	原始取得	无
342	杭州众硅	立式晶圆盒	日本	3253988	2022-12-30	2025-12-04	实用新型	原始取得	无

## 5、域名

序号	网站名称	许可证号	注册日期	到期日期
1	sizonetech.com	浙 ICP 备 18044783 号-2	2018/11	2032/11

## 企业申报的表外资产的类型、数量

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，除上述申报的无形资产外，企业无其他表外资产。

## 关于评估基准日的说明

本项目资产评估的基准日是 2025 年 12 月 31 日。

杭州众硅电子科技有限公司为此次收购拟定了时间表。为了加快这一工作的进程，同时考虑到评估基准日尽可能与本次评估目的的实现日接近的需要和完成评估工作的实际可能，委托人确定评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。

## 可能影响评估工作的重大事项的说明

### 产权瑕疵事项

截至评估基准日，我公司不存在产权瑕疵事项。

## 影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日,我公司不存在重大未决事项、法律纠纷等不确定因素。

## 抵(质)押及其或有负债、或有资产的性质、金额,及其对应资产负债情况

截至评估基准日,我公司不存在对外担保情况。

## 重大期后事项

截至报告出具日,我公司不存在重大期后事项。

## 资产负债清查情况的说明

根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后合并报表,合并报表口径下公司资产总额为 102,212.56 万元,负债总额为 26,932.17 万元,净资产为 75,280.39 万元。其中,流动资产 96,359.75 万元,非流动资产 5,852.82 万元;流动负债 25,714.73 万元,非流动负债 1,217.44 万元。

根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后母公司报表,公司资产总额为 104,275.53 万元,负债总额为 26,755.27 万元,净资产为 77,520.26 万元。其中,流动资产 98,014.37 万元,非流动资产 6,261.16 万元;流动负债 25,537.84 万元,非流动负债 1,217.44 万元。

1、清查盘点时间:清查基准日为 2025 年 12 月 31 日,清查盘点时间为 2026 年 1 月。

### 2、实物资产的分布情况及特点

纳入评估范围内的实物资产账面值 55,336.61 万元,占评估范围内总资产的 53.07%。这些资产具有以下特点:

(1) 实物资产主要分布在杭州众硅电子科技有限公司厂区，部分位于客户项目现场。

(2) 存货为原材料、委托加工物资、产成品、在产品及发出商品。存货分布比较集中，主要在杭州众硅电子科技有限公司及其子公司，截至基准日存货均有专人管理，现状较好。

(3) 设备类资产较为集中，均分布在被评估单位区域内。委估机器设备共 55 项，主要为膜厚仪、CDA 设备等。专用性高，有专人养护；运输设备共 2 项，为企业自用别克、奔驰等车辆，均有车辆行驶证，截至评估基准日，汽车日常维护保养正常，车辆均能正常行驶；电子设备共 550 项，主要为电脑等办公设备。截至基准日固定资产使用正常，保养情况良好。

3、实施方案：此项工作由财务部牵头，相关各部门参与。具体由财务部门、设备管理部和办公室共同负责固定资产的清查盘点。

4、清查盘点工作本着实事求是的原则，统一核对账、卡、物，力求做到准确、真实、完整。

(1) 流动资产的清查：运用实地盘点，与抽样盘点相结合，通过点数和抽取样本计算等方法，确定其实有数量。

(2) 固定资产的清查，是通过实物数量盘点和质量检验方法相结合，采取各种技术方法，检验资产的质量情况。按照具体要求做到了实事求是的评价。

### 5、清查结论

(1) 非实物资产，评估申报明细表和账面记录一致，申报明细表与实际情况吻合。

(2) 实物资产的清查情况与申报明细一一核对，账实相符。

## 资料清单

委托人和被评估单位已向评估机构提供了以下资料：

- 1、经济行为文件；
- 2、委托人和被评估单位法人营业执照；
- 3、企业基准日专项审计报告；
- 4、资产权属证明文件；
- 5、资产评估明细表；
- 6、与本次评估有关的其他资料及专项说明。

(此页无正文，为中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值评估项目《企业关于进行资产评估有关事项的说明》盖章页)

委托人：中微半导体设备（上海）股份有限公司（盖章）



法定代表人（签字或盖章）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈" followed by a stylized name.

二〇二二年一月八日

（此页无正文，为中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目《企业关于进行资产评估有关事项的说明》盖章页）

被评估单位：众硅电子科技（上海）有限公司（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：



二〇二六年一月八日

（此页无正文，为中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目《企业关于进行资产评估有关事项的说明》盖章页）

被评估单位：杭州众硅电子科技有限公司（盖章）

法人代表（签字或盖章）：



*Guo Jinyang*

二〇二六年一月八日

(此页无正文，为中微半导体设备(上海)股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目《企业关于进行资产评估有关事项的说明》盖章页)

被评估单位: Sizone Technology (HK) Limited (盖章)  
For and on behalf of  
Sizone Technology (HK) Limited  
众硅科技(香港)有限公司  
Authorized Signatory

法人代表 (签字或盖章): 

二〇二〇年一月十八日

（此页无正文，为中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目《企业关于进行资产评估有关事项的说明》盖章页）

被评估单位：众进芯科技（福建）有限公司（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：



二〇二〇年一月八日

(此页无正文，为中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目《企业关于进行资产评估有关事项的说明》盖章页)

被评估单位：众恩芯科技（青岛）有限公司（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：



二〇二〇年一月八日